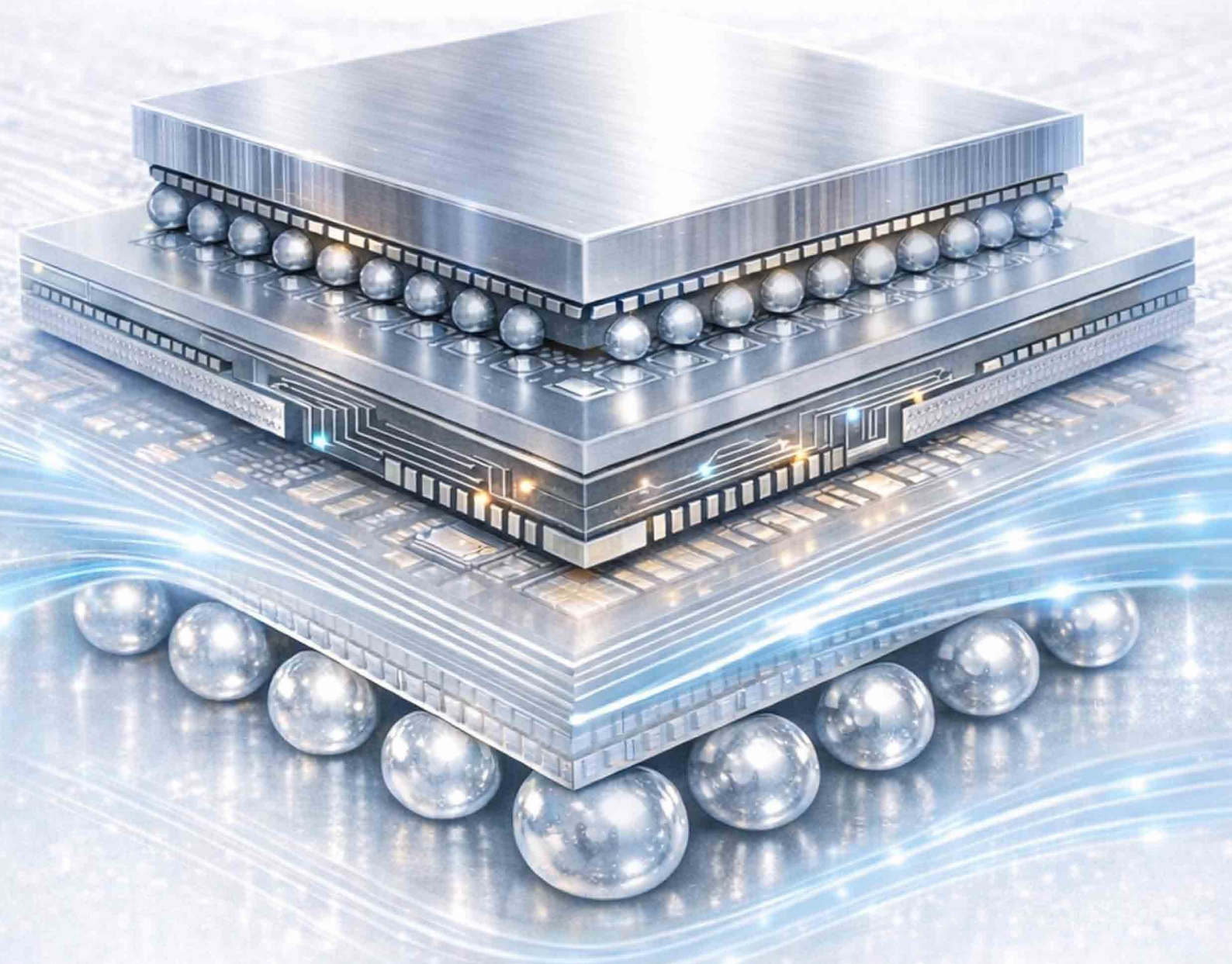


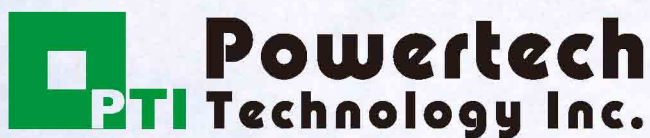
股票代號：6239



# 力成科技股份有限公司

## 中華民國114年度年報

### 2025 ANNUAL REPORT



刊印日期：中華民國115年4月28日

本年報查詢網址：

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<https://www.pti.com.tw>

## 一、公司發言人及代理發言人

### 發 言 人

姓 名：沈俊宏  
職 稱：財務長  
電 話：(03) 5980300  
電子郵件信箱：huckshen@pti.com.tw

### 代理發言人

姓 名：林宥翰  
職 稱：人力資源暨法務副總經理  
電 話：(03) 5980300  
電子郵件信箱：yohan@pti.com.tw

## 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司 地 址：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路 10 號  
電 話：(03) 5980300  
第一廠區地址：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段 879 號  
第二廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區三民路 7 號、7-1 號  
第三廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路 10、15、26 號  
                  新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16 號  
第九廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路 4 號  
第十廠區地址：新竹縣湖口鄉新興路 458-28 號  
竹科分公司地址：新竹市新竹科學園區力行三路 15 號  
竹科二廠地址：新竹市新竹科學園區力行四路 9 號  
竹科三廠地址：新竹市新竹科學園區力行四路 29 號  
竹科五廠地址：新竹市新竹科學園區力行路 23 號

## 三、股票過戶機構

名 稱：康和綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地 址：台北市信義區基隆路一段 176 號 B1  
網 址：<https://www.concords.com.tw>  
電 話：(02) 8787-1118

## 四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林政治、方蘇立會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓  
網 址：<https://www2.deloitte.com>  
電 話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用。

六、公司網址：<https://www.pti.com.tw>

# 目 錄

壹、致股東報告書 .....	1
營業報告書 .....	2
貳、公司治理報告 .....	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	19
四、簽證會計師公費資訊.....	61
五、更換會計師資訊.....	62
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊.....	62
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股 東股權移轉及股權質押變動情形.....	63
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊.....	64
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數資訊.....	65
參、募資情形 .....	66
一、資本及股份.....	66
二、公司債辦理情形.....	68
三、特別股辦理情形.....	68
四、海外存託憑證辦理情形.....	68
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	68
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	68
七、資金運用計畫執行情形.....	68
肆、營運概況 .....	69
一、業務內容.....	69
二、市場及產銷概況.....	77
三、從業員工資訊.....	81

四、環保支出資訊.....	82
五、勞資關係.....	82
六、資通安全管理.....	87
七、重要契約.....	90
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....</b>	<b>91</b>
一、財務狀況.....	91
二、財務績效.....	92
三、現金流量.....	92
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	93
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	93
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估.....	94
七、其他重要事項.....	96
<b>陸、特別記載事項 .....</b>	<b>97</b>
一、關係企業相關資料.....	97
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	97
三、其他必要補充說明.....	97
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	97

# 壹、致股東報告書

於民國 115 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

## 【前一年度營業結果】

2025 年合併營業收入新台幣 749 億元，每股盈餘為新台幣 7.48 元。獲利較 2024 年下滑的主要原因是產品組合的變動及先進技術的持續投入所致，整體而言，公司營運發展仍穩定的向上成長。

## 【受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響】

回顧 2025 年，前半年在記憶體客戶持續進行庫存調整及美國政府宣布對世界各國徵收對等關稅的壓力下，全球經濟的走向產生極大的不確定性。幸運的是下半年由於 AI 應用的蓬勃發展扭轉了半導體產業，尤其記憶體的強勁需求。力成在面對如此動盪的經貿環境，我們堅持專注本業，聚焦於公司內部的改造與營運效率的提升。

## 【本年度營業計畫概要】及【未來公司發展策略】

去年我曾向大家報告，我們在新產品、新客戶與先進技術的開發已做好準備。現在我很高興的跟大家報告，我們的努力已獲得世界級客戶的高度認可，現有 FOPLP 技術居世界領先的地位，產能遠低於客戶的需求，因此我們已積極啟動大規模的資本支出，購置竹科五廠(原友達竹科 L3C 廠)並加速竹科三廠(P11 廠)的產能擴充。

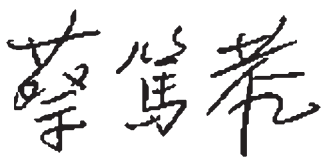
展望未來，我們將持續鞏固在記憶體領域的領先地位，並全力投入先進封測技術的開發跟製造，我們今年的目標是如期於年底前完成階段性擴廠計劃、順利通過客戶的產品認證、良率超越業界水準、為客戶提供品質最穩定及最具成本優勢的產品。

未來幾年我們將致力成為下列封測技術應用的領先者：

1. FOPLP for high performance computing AI chips;
2. Optical engine and CPO;
3. High Bandwidth Memory.

最後感謝各位股東長期以來的支持與信任。

祝大家身體健康、萬事如意！

董事長： 

蔡篤恭

# 力成科技股份有限公司

## 民國一四年度營業報告書

### 一、114 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織(IMF, International Monetary Fund) 115 年 1 月發布之「115 年世界經濟展望」報告指出，114 年全球經濟成長率為 3.3%，與原先的預測值相當，並預估 115 年及 116 年成長率分別為 3.3%及 3.2%。114 年全球平均通膨率為 4.1%，IMF 預測 115 年將降到 3.8%，116 年為 3.4%，與其他大型的經濟體相比，預期美國通膨率回歸到目標水準的速度將更為緩慢。

目前經濟前景面臨的風險仍偏向下行，包括貿易緊張局勢可能升級、地緣政治的緊張局勢可能突然加劇、財政赤字的擴大和高額的公共債務等，將導致不確定性持續更長時間，並對經濟活動造成更大拖累，並透過對金融市場、供應鏈和大宗商品價格擾動全球經濟。而若人工智慧技術的加速採用，預期會帶來生產率的增長，而相關的人工智慧技術投資將進一步提振經濟活動，最終轉化為可持續的經濟增長。

根據資訊科技研究及顧問機構顧能(Gartner)報告指出，因 AI 資料中心使用 GPU 及 HBM 的需求揚升，帶動 114 年全球半導體營收年增 21%至 7,934 億美元，其中，GPU 及 HBM 等 AI 半導體佔整體營收比重達約 1/3，並預估 115 年 AI 基礎設施投資將超過 1.3 兆美元，AI 半導體此種主導地位將進一步提升。在臺灣半導體產業表現方面，根據工研院產科國際所 114 年 10 月報告：估計 114 年台灣 IC 產業產值達新台幣 6 兆 4,825 億元，年成長率達 22%，其中 IC 封裝業產值為新台幣 4,822 億元，較 113 年成長 13.9%，IC 測試業產值為新台幣 2,282 億元，較 113 年成長 14%。

面對 114 年全球政經局勢動盪不安，力成受惠於伺服器、車用電子、高速運算及人工智慧(AI)等客戶端的需求持續成長之下，今年整體營收仍較去年小幅成長。未來仍將維持在技術研發的優勢，積極擴張先進封裝產能，以因應未來客戶及市場需求，推動公司達到永續經營的目標。

茲將本公司 114 年度的營運成果報告如下：

#### (一) 114 年度營業實施情形

本公司 114 年度合併營收為新台幣 749 億 2 仟 9 佰萬元，較 113 年度的新台幣 733 億 1 仟 5 佰萬元增加約 2.20%；在盈餘方面，114 年度合併稅後純益中歸屬於母公司股東的金額為新台幣 55 億 3 仟 6 佰萬元，較 113 年度之淨利新台幣 67 億 8 仟 8 佰萬元減少約 18.45%。

(二) 預算執行情形：本公司並未公布財務預測。

### (三) 財務收支情形

114 年度合併現金流量狀況：(單位：新台幣)

1.營業活動之現金淨流入	16,697,873 仟元
2.投資活動之現金淨流出	26,023,284 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
3.籌資活動之現金淨流入	4,197,348 仟元
主要係舉借銀行借款	

### (四) 獲利能力分析

分析項目		年度	114 年度	113 年度
獲 利 能 力	營業利益 / 實收資本比率		107.12%	123.59%
	稅前純益 / 實收資本比率		115.82%	140.65%
	資產報酬率		6.39%	7.90%
	股東權益報酬率		10.10%	12.07%
	純益率		7.39%	9.26%
	每股純益		7.48 元	9.09 元

### (五) 研究發展狀況

本公司持續投入大量資源於新技術的研發與創新，114 年度研究及發展費用約為新台幣 28 億元，約占全年合併營收的 3.74%。本公司在既有深厚的記憶體與邏輯產品封測基礎上，致力於推動先進封裝與異質產品整合技術的創新。透過全方位的封裝路徑，包含銅柱凸塊 (CPB)、晶片級覆晶封裝 (FCCSP)、大尺寸多晶片覆晶封裝 (Large MCM FCBGA) 及小晶片覆晶封裝 (Chiplet FCBGA)，為全球客戶提供高密度、高性能的解方。此外，針對微型化需求，亦深耕系統/模組級封裝 (SiP/SiM)、高頻寬封裝堆疊 (HBPOp) 以及具備散熱優勢的內嵌散熱片晶片級覆晶封裝 (Embedded Heat Sink FCCSP)。

#### 關鍵領域技術突破：

- 5G 通訊與射頻驗證：  
憑藉領先的內嵌天線封裝/天線模組 (AiP/AiM) 技術，結合專屬的 5G 射頻 (5G RF) 實驗室，我們能為客戶提供精確的 5G AiP 產品效能驗證，加速通訊設備的商用進程。
- CMOS 影像感測器 (CIS)：  
運用矽穿孔 (TSV) 連接技術，大幅提升影像讀取速率。目前正積極發展其於醫療、監控及車用領域的晶圓級晶片尺寸封裝 (CIS CSP) 應用。
- 高效能運算 (HPC) 與雲端應用：  
針對高頻寬記憶體 (HBM) 產品，透過 TSV 技術優化訊號路徑，顯著提升記憶體頻寬與運算速度，滿足 AI 伺服器與高效能運算市場的嚴苛需求。

#### 4. 次世代封裝展望：

針對後摩爾定律時代的晶片微縮化 (Chip Scaling) 挑戰，我們全力投入 2.5D/3D TSV 以及扇外型晶圓級/面板級封裝 (FOWLP/FOPLP)。透過與客戶的緊密研發協作與產品驗證，克服製程極限，奠定未來成長基石。

### 二、115 年度營業計劃概要

#### (一)經營方針

- 1.重承諾(Promise)、創新技術(Technology)及提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
- 2.專注於半導體產品專業封裝及測試領域，與客戶及協力廠商共創利潤。
- 3.致力於先進技術的研發及適時的導入新產品，以提高企業成長動能。
- 4.以穩定的品質及精湛的技術提供客戶全方位的服務。
- 5.整合資源及強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
- 6.培育人才及重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

#### (二)預期銷售數量

依據世界半導體貿易統計(WSTS, The World Semiconductor Trade Statistics)於 115 年 1 月發布的 115 年半導體銷售預測，115 年全球半導體市場將年成長 26.3%，銷售額達創紀錄的 9,750 億美元。就產品類別而言，作為電子裝置大腦的邏輯晶片預期將增加 32.1%，達 3,908 億美元；記憶體晶片將成長 39.4%，達 2,948.1 億美元。WSTS 預期，115 年全球晶片市場以美洲地區成長最快，將增加 34.4%，達 3,386 億美元；其次是亞太地區，成長 24.9%，達 5,263 億美元。

展望 115 年，隨著各類型新興應用持續發展，包含 AI 人工智慧、電動車與自駕車、資料中心、低軌道衛星、電子醫療、家用電子產品，及各式行動裝置的創新功能推陳出新，半導體將持續帶領 ICT 產業往前成長。

需要持續留意的是，全球供應鏈重組趨勢，朝向區域化，短鏈化發展，全球貿易前景不確定性依然高漲。此外，地緣政治隱憂，區域戰爭依然戰火頻仍，衝擊能源供應，影響產業民生。儘管主要歐美國家通膨壓力略有降溫，惟仍偏高，牽動經濟與金融情勢。中國大陸經濟持續停滯，通貨緊縮問題日益惡化，影響全球經濟復甦，同樣需要進一步密切觀察。

預估 115 年各式產品的生產量，邏輯晶片封測將持續成長，記憶體晶片封測則穩健中見到回升的契機，115 年各類產品的生產數量預測如下表。

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 118 億顆
測試	約 78 億顆
晶圓級封裝	約 111 萬片
晶圓測試	約 139 萬片
固態硬碟(SSD)+ 薄型固態硬碟系統整合封裝(SiP)	約 2.93 億顆

### (三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)的客戶服務以縮短交期及降低運送成本。
- 2.持續強化記憶體產品於封裝及測試領域之產業龍頭地位。
- 3.積極拓展邏輯產品(Logic)業務版圖，加速扇外型封裝(Fan-Out Package)的業務之成長動能，並同步推進覆晶封裝(FC, Flip Chip)尤其在大尺寸高階 FC\_BGA、固態硬碟(SSD)、晶圓級封裝(WLP, Wafer Level Package)、晶圓級測試(CP, Chip Probing)及系統級封裝(SiP, System in Package)等相關業務之發展。
- 4.進一步深化與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續聚焦產品的成本管控，並有效整合集團資源，以提升公司整體競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：



# 貳、公司治理報告

## 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事資料

#### 董事資料(一)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主要關係人		備註(註2)
							股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比			職稱	姓名	
董事長	中華民國	蔡薦恭	男性 71~80歲	112.05.31	三年	88.06.23	4,400,000	0.58%	3,360,000	0.44%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專工業工程科 金士頓集團亞太區總經理 遠東金士頓科技(股)公司董事長	本公司策略長 起豐電子(股)公司法人代表人 Powertech Holding (B.V.) Inc. 董事 PFI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技日本合同會社業務執行代表 Tera Probe, Inc. 取締役 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 財團法人力成科技教育基金會董事長			
董事	中華民國	呂肇祥	男性 61~70歲	112.05.31	三年	109.05.28	62,356	0.01%	62,356	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學機械系學士 力晶半導體封裝生產副處長	本公司總經理 元成科技(蘇州)有限公司董事 力成半導體(西安)有限公司董事長 起豐電子(股)公司法人代表人 PFI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事			
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男 (Shigeo Koguchi)	男性 71~80歲	112.05.31	三年	106.05.26	29,875,000	3.94%	29,875,000	3.94%	0	0.00%	0	0.00%	美國佛羅里達大學工程碩士 日本北海道大學工程碩士 Toshiba Corp. 資深執行副總經理 Toshiba Corp. 董事、資深顧問	無			
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	女性 61~70歲	112.05.31	三年	106.05.26	29,875,000	3.94%	29,875,000	3.94%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學會計系學士 遠東金士頓科技(股)公司財務長	遠東金士頓科技(股)公司財務長 金士頓電子(股)公司監察人			
董事	中華民國	起豐電子(股)公司 代表人：謝永達	男性 61~70歲	112.05.31	三年	109.5.28	11,800,000	1.55%	20,350,000	2.68%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學高階管理碩士 遠東金士頓科技(股)公司總經理 鴻海精密工業(股)公司副總經理 力成科技(股)公司集團資深副總裁 聚成科技(股)公司總經理 起豐電子(股)公司執行長	本公司執行長 起豐電子(股)公司法人代表暨董事長 晶兆成科技(股)公司法人代表暨董事長 得群科技(股)公司董事長 Tera Probe, Inc. 取締役 財團法人力成科技教育基金會董事			

115年3月29日



董事屬法人股東代表者，其法人股東之主要股東(持有股權比例占前十名之股東)：

115年3月29日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)	杜紀川 (50%)、孫大衛 (50%)
超豐電子(股)公司	力成科技股份有限公司(42.91%)、臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶(4.23%)、長庚醫療財團法人(1.71%)、吳素瑜(1.67%)、群益台灣精選強棒主動式ETF基金專戶(1.44%)、長華電材股份有限公司(1.03%)、鴻威創業投資股份有限公司(1.02%)、楊秋霞(1.01%)、許秀梅(0.77%)、鄭俊忠(0.73%)
台灣鎰依先進半導體(股)公司	Kioxia Corporation (100%)

上表中法人股東之主要股東為法人者其其主要股東：

115年3月29日

法人名稱	法人之主要股東
力成科技(股)公司	群益台灣精選高息ETF基金專戶(5.55%)、元大台灣高股息基金專戶(4.78%)、美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(3.94%)、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶(3.40%)、國泰人壽保險股份有限公司(3.25%)、新制勞工退休基金(2.84%)、超豐電子股份有限公司(2.68%)、美商摩根大通受託保管JPM摩根證券投資專戶(1.88%)、美商KTC-SUN公司(1.81%)、匯豐銀行託管荷蘭合作銀行倫敦分行投資(1.44%)
長庚醫療財團法人	南亞塑膠工業(股)公司(17.81%)、台灣化學纖維(股)公司(13.71%)、台灣塑膠工業(股)公司(13.15%)、王永在(已歿，11.13%)、王永慶(已歿，7.28%)
長華電材(股)公司	華立企業(股)公司(27.27%)、新欣投資(股)公司(7.88%)、元耀能源科技(股)公司(4.85%)、倍斯捷投資(股)公司(3.00%)、易華電子(股)公司(1.90%)、花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶(1.74%)、美商摩根台北分行託管JP摩根證券投資專戶(1.63%)、渣打託管渣打銀行(香港)一股票交易(0.93%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶(0.74%)
鴻威創業投資(股)公司	瑞昱半導體(股)公司(100%)
Kioxia Corporation	Kioxia Holdings Corporation (100%)

## 董事資料(二)

### 一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 3 月 29 日

姓 名	條 件	專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
蔡篤恭		董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事資料(一)」。  所有董事皆未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	
呂肇祥				
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)	代表人：古口榮男 (Shigeo Koguchi)			
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)	代表人：吳麗卿			
超豐電子(股)公司	代表人：謝永達			
台灣鎰俠先進半導體(股)公司	代表人：淺田順一 (Junichi Asada)			
張光瑤			為獨立董事，符合證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性之相關規定，摘錄要點如下：	2
李培瑛			1. 本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否	0
陳瑞聰			2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：於規定範圍內，請參閱本年報「董事資料(一)」	0
童兆勤			3. 最近兩年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無	1

### 二、董事會多元化及獨立性：

#### 1. 董事會多元化情形：

##### (1) 董事會成員多元化政策：

本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項及「董事選任程序」第 3 條之規定，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- |              |          |
|--------------|----------|
| 一、營運判斷能力。    | 五、產業知識。  |
| 二、會計及財務分析能力。 | 六、國際市場觀。 |
| 三、經營管理能力。    | 七、領導能力。  |
| 四、危機處理能力。    | 八、決策能力。  |

## (2) 具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
獨立董事人數至少四人	達成
獨立董事席次不少於董事席次三分之一	達成
董事會成員至少包含一位女性董事	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成

## (3) 落實情形：

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
				51至60	61至70	71至80	未逾三屆	逾三屆							
蔡篤恭	中華民國	男	√			√			√		√	√	√	√	√
呂肇祥	中華民國	男	√		√				√		√	√	√	√	√
古口榮男	日本	男				√			√		√	√	√	√	√
吳麗卿	中華民國	女			√				√	√	√	√	√	√	√
謝永達	中華民國	男	√		√				√		√	√	√	√	√
淺田順一	日本	男			√				√		√	√	√	√	√
張光瑤	中華民國	男				√	√		√		√	√	√	√	√
李培瑛	中華民國	男				√	√		√		√	√	√	√	√
陳瑞聰	中華民國	男				√	√		√		√	√	√	√	√
童兆勤	中華民國	男				√	√		√	√	√	√	√	√	√

- 本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一之原因及規劃提升董事性別多元化採行措施：  
原因：因目前本公司女性高層管理人才較為缺乏，導致女性董事性別比例未達三分之一。  
採行措施：積極推動並鼓勵女性參與高層管理培訓，以提供女性更多的領導與管理機會，進而培養董事人才。
- 董事會獨立性情形：本公司 4 名獨立董事任期均未逾三屆。全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

4. 114 年度本公司董事及經理人進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	蔡篤恭	114.7.9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	呂肇祥	114.7.9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	謝永達	114.7.9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114.7.31	臺灣證券交易所	2025 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3
獨立董事	張光瑤	114.5.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3
		114.8.22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3
獨立董事	李培瑛	114.7.23	社團法人中華公司治理協會	企業風險管理議題及實務分享	3
		114.11.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	川普 2.0 顛覆全球經濟秩序-衝擊與因應之道	3
獨立董事	陳瑞聰	114.3.29	台北市進出口商業同業公會	展望 2025 全球產經趨勢與台灣產業轉型之道	3
		114.5.14	社團法人台灣董事學會	美國關稅新風暴-供應商生存戰略	3
		114.11.12	社團法人台灣董事學會	企業數位轉型-AI 與新興科技應用案例	3
獨立董事	童兆勤	114.8.13	社團法人中華獨立董事協會	全球經貿新局的挑戰與因應	3
		114.12.16	社團法人台灣董事學會	AI 時代下的製造業轉型與董事治理責任	3
財務長暨 公司治理主 管	沈俊宏	114.7.3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-股東會、經營權及股權策略	3
		114.7.15- 114.7.16	社團法人中華公司治理協會	溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會-台北場	9
		114.8.8	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114.8.15	中華民國企業永續發展協會	CDP 對應 IFRS S2 問題解析宣導課程-強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	6
會計主管	紅立勝	114.8.13	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「永續資訊之管理」內控實務全盤檢析	6
		114.9.8- 114.9.9	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
		114.10.30- 114.10.31	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年3月29日；股

職稱(註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份(註5)		配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例		股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
策略長	中華民國	蔡篤恭	男性	107.11.02	3,360,000	0.44%	-	-	-	台北工專工業工程科 金士頓集團亞太區總經理 遠東金士頓科技(股)公司董事長	本公司董事長 超豐電子(股)公司法人代表人 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 董事 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技日本合同會社業務執行代表 Tera Probe, Inc. 取締役 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 財團法人力成科技教育基金會董事長	-	-	-	-
執行長	中華民國	謝永達	男性	109.10.01	18,000	0.00%	2,000	0.00%	-	交通大學高階管理碩士 遠東金士頓科技(股)公司總經理 鴻海精密工業(股)公司副總經理 力成科技(股)公司集團資深副總裁 聚成科技(股)公司總經理 超豐電子(股)公司執行長	本公司法人代表人 超豐電子(股)公司法人代表人暨董事長 晶兆成科技(股)公司法人代表人暨董事長 得群科技(股)公司董事長 Tera Probe, Inc. 取締役 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-
總經理	中華民國	呂肇祥	男性	109.10.01	62,356	0.01%	-	-	-	逢甲大學機械系學士 力晶半導體封装生產副處長	本公司董事 元成科技(蘇州)有限公司董事 力成半導體(西安)有限公司董事長 超豐電子(股)公司法人代表人 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事	-	-	-	-
測試暨模組營運 資深副總經理	中華民國	吳文維	男性	112.03.10	10,786	0.00%	-	-	-	中原大學工業工程碩士 力晶半導體(股)公司部經理	晶兆成科技(股)公司法人代表人 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-
財務長	中華民國	沈俊宏	男性	113.11.08	0	0.00%	-	-	-	政治大學經營管理研究所碩士 力成蘇州財務總監 龍邦國際興業(股)公司協理	Tera Probe, Inc. 取締役 力成半導體(西安)有限公司董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事	-	-	-	-
經營管理 資深副總經理	中華民國	巫勤達	男性	99.03.09	0	0.00%	-	-	-	淡江大學機械學士 美商艾克爾(上寶)處長	無	-	-	-	-
先進封裝技術 研發暨營運 資深副總經理	中華民國	林基正	男性	112.01.01	5,000	0.00%	-	-	-	清華大學動力機械研究所博士 台積電研發經理	超豐電子(股)公司法人代表人 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	註2
廠務工程 副總經理	中華民國	林賢鳳	男性	108.01.11	11,715	0.00%	-	-	-	明新工專機械工程學士 遠東金士頓科技經理	無	-	-	-	-

職稱(註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份(註5)		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
人力資源暨法務副總經理	中華民國	林宥翰	男性	108.01.11	125,000	0.02%	-	-	-	-	Golden Gate University 法學博士 普華商務法律事務所律師	力成半導體(西安)有限公司監事 晶兆成科技(股)公司監察人 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-
傳統封裝-邏輯研發副總經理	中華民國	徐宏欣	男性	112.01.01	0	0.00%	-	-	-	-	清華大學原子科學研究所碩士 美商艾克爾科技部經理	財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	註3
業務豐行銷副總經理	中華民國	許瑞益	男性	114.07.01	0	0.00%	-	-	-	-	中興大學資源管理研究所碩士 聯笙電子產品行銷副理	無	-	-	-	註3
物料管理副總經理	中華民國	林國鼎	男性	114.07.01	0	0.00%	-	-	-	-	清華大學動力機械研究所碩士 力成科技資深處長	無	-	-	-	註3
封裝營運副總經理	中華民國	徐坤基	男性	115.02.01	0	0.00%	2,000	0.00%	-	-	中原大學機械工程學系學士 美商艾克爾科技副處長	無	-	-	-	註4
晶圓級封裝營運協理	中華民國	董定鑫	男性	105.03.01	0	0.00%	-	-	-	-	元智大學工業工程碩士 美商艾克爾科技資深處長	無	-	-	-	-

註1：研發協理陳世恭先生於114年5月16日離職；副總經理喬廣文先生於115年1月5日退休；資深副總經理陳玉欽先生於115年1月31日退休。

註2：林基正先生於114年7月1日獲擢升為資深副總經理。

註3：徐宏欣先生、許瑞益先生及林國鼎先生於114年7月1日獲擢升為副總經理。

註4：徐坤基先生於115年2月1日獲擢升為副總經理。

註5：截至本次股東常會停止過戶日115年3月29日止之實際持股數。

註6：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。

二、最近年度給付董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金  
1.一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%) (註10)		領取來自子公司或轉投資事業公司酬金 (註11)	
		報酬(A) (註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C) (註3)	業務執行費用(D) (註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)	薪資、獎金及特支費等(E) (註5)	退職退休金(F)	員工酬勞(G) (註6)				
									本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司
董事長	蔡篤恭	0	0	74,736	2,188	75,456 1.36%	32,568	0	11,210	0	119,234 2.15%	149,040 2.69%	無
	呂肇祥												
	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男												
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿												
	起豐電子(股)公司 代表人：謝永達												
	台灣鎰依先進半導體(股)公司 代表人：淺田順一												
獨立董事	張光瑤	9,120	0	0	480	9,600 0.17%	0	0	0	0	9,600 0.17%	9,600 0.17%	無
	李培瑛												
	陳瑞聰												
	童兆勤												

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

依本公司章程規定，獨立董事按月支領報酬，不參與年度董事酬勞之分配。依獨立董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準後，經董事會通過議定之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

## 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
低於1,000,000元	-	-	-	-
1,000,000元(含)~ 2,000,000元(不含)	-	-	-	-
2,000,000元(含)~ 3,500,000元(不含)	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤
3,500,000元(含)~ 5,000,000元(不含)	-	-	-	-
5,000,000元(含)~ 10,000,000元(不含)	-	-	-	-
10,000,000元(含)~ 15,000,000元(不含)	呂肇祥、 起豐電子(股)公司(代表人：謝永達)、 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰俠先進半導體(代表人：淺田順一)	呂肇祥、 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰俠先進半導體(代表人：淺田順一)	呂肇祥、 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰俠先進半導體(代表人：淺田順一)	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰俠先進半導體(代表人：淺田順一)
15,000,000元(含)~ 30,000,000元(不含)	蔡篤恭	-	呂肇祥、 起豐電子(股)公司(代表人：謝永達)	呂肇祥
30,000,000元(含)~ 50,000,000元(不含)	-	蔡篤恭、 起豐電子(股)公司(代表人：謝永達)	蔡篤恭	蔡篤恭、 起豐電子(股)公司(代表人：謝永達)
50,000,000元(含)~ 100,000,000元(不含)	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	10名	10名	10名	10名

註1：董事姓名係分別列示(法人股東將法人股東名稱及代表人分別列示)，因其中有董事或代表人有兼任執行長、策略長及總經理之情形，另亦填列下表3。

註2：係指114年度董事之薪資報酬。依本公司章程規定，獨立董事為按月支領報酬，不參與年度盈餘分配之董事酬勞。

註3：係指114年度董事會通過之董事酬勞金額。

註4：係指114年度董事之相關業務執行費用，內容均為車馬費。

註5：係指114年度董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、各種獎金、獎勵金及各種津貼等。

註6：係指114年度董事兼任員工取得員工酬勞者，並經董事會通過分派員工酬勞金額；因截至目前為止，分配各員工酬勞之金額尚未擬定，故按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列下表3。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

## 2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)			A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司		財務報告內所有公司
策略長	蔡篤恭													
執行長	謝永達													
總經理	呂肇祥													
封裝營運 資深副總經理	陳玉欽(註1)													
測試暨模組營運 資深副總經理	吳文維													
財務長	沈俊宏													
業務副總經理	喬廣文(註1)	46,589	46,589	0	0	37,006	39,605	20,162	0	20,162	0	103,757	106,356	無
經營管理 資深副總經理	巫勤達													
先進封裝技術研發營運 資深副總經理	林基正													
廠務工程副總經理	林賢鳳													
人力資源暨法務 副總經理	林宥翰													
傳統封裝-邏輯研發 副總經理	徐宏欣													
業務暨行銷副總經理	許瑞益													
物料管理副總經理	林國鼎													

註1：副總經理喬廣文先生於115年1月5日退休；資深副總經理陳玉欽先生於115年1月31日退休。

總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	喬廣文(註 1)、許瑞益、林國鼎	喬廣文(註 1)、許瑞益、林國鼎
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳玉欽(註 1)、沈俊宏、巫勤達、吳文維、林賢鳳、林宥翰、林基正、徐宏欣	陳玉欽(註 1)、沈俊宏、巫勤達、吳文維、林賢鳳、林宥翰、林基正、徐宏欣
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	謝永達、呂肇祥	謝永達、呂肇祥
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	蔡篤恭	蔡篤恭
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	14 名	14 名

註 1：喬廣文先生於 115 年 1 月 5 日退休；陳玉欽先生於 115 年 1 月 31 日退休，其酬金揭露至退休日止。

註 2：係填列 114 年度經董事會通過分派之員工酬勞金額(全部以現金發放)，因目前尚無法預估，故按去年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列表 3。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### 3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日

	職 稱	姓 名	股票金額 (仟元)	現金金額 (仟元)	總計 (仟元)	總額占稅後純益之 比例 (%)
經 理	策略長	蔡篤恭	0	21,680	21,680	0.39%
	執行長	謝永達				
	總經理	呂肇祥				
	封裝營運資深副總經理	陳玉欽				
	測試暨模組營運 資深副總經理	吳文維				
	財務長	沈俊宏				
	業務副總經理	喬廣文				
	經營管理資深副總經理	巫勤達				
	先進封裝技術研發暨營運 資深副總經理	林基正				
	廠務工程副總經理	林賢鳳				
	人力資源暨法務副總經理	林宥翰				
	傳統封裝-邏輯研發 副總經理	徐宏欣				
	業務暨行銷副總經理	許瑞益				
	物料管理副總經理	林國鼎				
晶圓級封裝協理	董定鑫					
人 會計主管	紅立勝					

註 1：係填列 114 年度經董事會通過分配經理人之員工酬勞金額(全部以現金發放)，因目前尚無法預估，故按去年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 2：經理人之適用範圍，依據財政部證期會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○一三○一號函令規定，其範圍如下：

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| (1)總經理及相當等級者  | (4)財務部門主管            |
| (2)副總經理及相當等級者 | (5)會計部門主管            |
| (3)協理及相當等級者   | (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 |

註 3：測試研發協理陳世恭先生於 114 年 5 月 16 日離職。

4. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例之分析：

職稱	114 年度酬金總額 佔稅後純益之比例		113 年度酬金總額 佔稅後純益之比例	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事(含獨立董事)	1.53%	2.07%	1.50%	1.94%
總經理及副總經理	1.87%	1.92%	1.70%	1.71%

本公司及財務報告內所有公司預估發放 114 年度之董事酬金、總經理及副總經理酬金佔當年度稅後純益之比例均較 113 年度略增，主要係因 114 年度經理人異動影響配發之經理人酬金所致。

(2) 酬金給付政策、標準與組合：

A. 董事酬金：

依本公司章程所訂定之比例分配，自當年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，提撥不高於 1.5% 為董事酬勞；惟公司如尚有累積虧損，應預先保留彌補數額；獨立董事則為按月支領報酬，不參與董事酬勞之分配。

B. 經理人酬金：

經理人酬金係依其個人經歷、專業能力、管理職責及所擔任職位等因素綜合評估，並參酌同業薪酬水準訂定，以維持本公司薪酬之市場競爭力。

針對經理人 ESG（環境、社會及公司治理）績效與報酬的連結，本公司高度重視永續發展理念的落實，並將 ESG 績效指標明確納入經理人獎酬的評核架構中。根據「經理人薪資報酬與績效評估辦法」，ESG 績效指標佔整體績效評核權重的 15%，與營運管理指標（50%）、財務性指標（35%）共同構成完整的評核體系。ESG 指標涵蓋環境保護（如節能減碳、資源循環、污染防治）、社會責任（如員工關懷、社區參與、多元包容）、以及公司治理（如誠信經營、法規遵循、風險控管）等多個面向，確保經理人在追求經營成效的同時，積極推動企業永續發展，並將永續觀念融入日常管理決策。

為具體強化 ESG 與報酬的連結，本公司每年均針對經理人所管轄業務，訂定明確且可量化的 ESG 績效目標，如溫室氣體減量百分比、員工職安事件降低率、ESG 評比分數提升幅度等，並於年度考核時依實際達成狀況進行評分。經理人若能有效推動 ESG 相關專案、帶領團隊落實永續策略，不僅有助於提升公司整體形象與競爭力，亦能作為年度獎金及薪酬調整的重要依據。如此設計，有助於激勵經理人將 ESG 目標視為本職工作的一部分，促使公司整體逐步邁向永續經營。

C. 給付酬金組合：

依薪資報酬委員會組織規程所定，酬金包括現金報酬、獎金、員工酬勞、持股信託、退休福利、各項津貼及其他具獎勵性質措施，其範疇依「公開發行公司年報應行記載事項準則」辦理。

(3) 訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事及經理人之酬金訂定程序，係經薪資報酬委員會審議後，提報董事會每年定期評估及核定，酬金內容之評估，除考量個人績效達成狀況、對公司之貢獻及職務職責外，並連結公司整體經營績效與營運成果，作為酬金核發及調整之重要依據。同時，於制度設計與定期檢討時，亦納入公司長期發展方向及潛在營運風險之考量，並配合法令規定與實際經營情形適時調整，以確保酬金制度之合理性與一致性，兼顧公司穩健經營與永續發展。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形：

本公司第十屆董事會於 114 年度共開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)B/A	備註
董事長	蔡篤恭	6	0	100%	無
董事	呂肇祥	6	0	100%	無
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi	6	0	100%	無
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	6	0	100%	無
董事	超豐電子(股)公司 代表人：謝永達	6	0	100%	無
董事	台灣鎧俠先進半導體(股)公司 代表人：淺田順一 Junichi Asada	6	0	100%	無
獨立董事	李培瑛	6	0	100%	無
獨立董事	張光瑤	6	0	100%	無
獨立董事	陳瑞聰	6	0	100%	無
獨立董事	童兆勤	6	0	100%	無
全體董事之合計出席情形		60	0	100%	無

#### 其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

本公司業已設立審計委員會，證券交易法第 14 條之 3 所列事項皆經審計委員會全體成員同意後，提董事會決議。相關說明請詳第 22 頁審計委員會運作情形之其他應記載事項 1。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(1)114 年 2 月 21 日第十屆第 10 次董事會

討論事項第五案：擬分配 113 年度董事酬勞及員工酬勞案

本案經理人董事蔡篤恭、謝永達及呂肇祥因利害關係迴避並離席未參與討論，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

討論事項第六案：經理人薪資調整案

本案經理人董事蔡篤恭、謝永達及呂肇祥因利害關係迴避並離席未參與討論，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

3.董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊之評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114.01.01~114.12.31	董事會	董事會內部自評	董事會績效評估有五大面向：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 經評估與統計問卷，達成率為96.00%，評估結果為超越標準。
		個別董事	董事成員自評	董事成員績效評估有六大面向：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 經評估與統計問卷，達成率為92.17%，評估結果為超越標準。
		功能性委員會	審計委員會成員自評	審計委員會績效評估有五大面向：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等。 經評估與統計問卷，達成率為98.64%，評估結果為超越標準。
		功能性委員會	薪酬委員會成員自評	薪酬委員會績效評估有五大面向：對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、薪酬委員會決策品質、薪酬委員會組成及成員選任、內部控制等。 經評估與統計問卷，達成率為97.27%，評估結果為超越標準。
		功能性委員會	原風險管理委員會成員自評	原風險管理委員會績效評估有五大面向：對公司營運之參與程度、風險管理委員會職責認知、風險管理委員會決策品質、風險管理委員會組成及成員選任、內部控制等。 經評估與統計問卷，達成率為97.68%，評估結果為超越標準。

改善建議：

- (一) 針對董事提出之意見及視董事會議案需要，安排董事會以外之多元溝通管道，以利董事瞭解相關意見及議案之辦理情形，以提升董事對公司營運之參與程度。
  - (二) 董事會成員於會議前所提意見，均適時轉知相關單位辦理並作為未來相關決策評估參考。
- 4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
- (1)本公司於114年度召開6次董事會，於各次董事會議後，持續秉持提昇資訊透明之原則，當日即以中英文重大訊息之方式將重要決議事項之摘要公告於公開資訊觀測站。若依法令規定或實際需要，亦會依規定舉行重大訊息說明會或記者會，向投資人及記者詳細說明及回答疑問。

- (2) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於 109 年 3 月 10 日第八屆第十六次董事會通過訂定之「董事會績效評估辦法」，每年應依據該辦法之規定執行內部董事會績效評估，並於次一年度第一季結束前完成。
  - (3) 為健全董事會功能及強化管理機制，本公司陸續於 100 年 12 月 19 日、103 年 6 月 26 日、110 年 5 月 7 日成立薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會，以提升董事會運作效能。另為強化董事會永續治理職能及風險管理機制，於 114 年 11 月 7 日經董事會決議將風險管理委員會更名為永續發展暨風險管理委員會。
5. 董事長(或董事會成員)及重要管理階層之接班規劃，包含相關培育情形、接任職務預定時程等運作情形：
- 公司在規劃接班計劃中，接班人除了必須具備卓越的擬定企業策略能力、邏輯分析能力及管理能力外，接班人的價值觀更要與以人為本、誠信正直的企業文化相符，以「技術、品質及服務世界第一」為目標，以達公司永續經營，相關的接班規劃以下列幾個面向進行：
1. 組織規劃調整與職務輪調
    - (1) 經營團隊的傳承：

藉由組織職務的調整以完善接班人計劃，將董事長的經營理念及管理策略做傳承，以利於總經理更順暢的承接與掌舵公司未來管理與發展方向。
    - (2) 高階主管的職務輪調：

由高階主管擔任各子公司的董事長及加入董事會，藉由此職務輪調來提昇高階主管人員的企業策略能力及累積企業經營管理的實務經驗。
    - (3) 廠長的設置：

製造營運單位設置廠長之職務，以培養人員全方位製造營運的管理能力與實務經驗，藉此來養成製造營運單位高階主管的接班人。
  2. 理念與經驗的傳承
    - (1) 經營理念與管理經驗的制度化

由現有高階主管人員將經營理念與管理經驗制度化並文件化，同時透由建構公司的核心職能、管理職能及職務體系的重整建構，使其得以傳承及延續。
    - (2) 公司重要會議的設立與參與：

透由中高階主管參與業務會議、產銷會議及研發單位的分享會議…等，以進一步接觸管理核心，承接公司經營管理的理念及了解產業局勢與公司發展的佈局。
  3. 各層級主管接班人才提報與培訓
    - (1) 各層級主管接班人才提報：

透由年度績效管理做適切的評估後，由各層級主管提報出可培育具潛力的接班人才。
    - (2) 具潛力接班人才的培育

從公司教育訓練體系出發，透過提供一系列內、外部教育訓練資源，更導入線上學習平台，提供各階層主管根據職務所需與時俱進學習；此外，為了傳承內部好的知識與公司文化，每季辦理高階主管講座，分享其實貴的管理心法與職涯歷程，讓各階層主管都能了解公司的企業文化及經營理念，進而讓其未來能承接各層級主管職務。

(二) 審計委員會運作情形：本公司第四屆審計委員會於 114 年度開會 5 次(A)，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	張光瑤	5	0	100%	無
獨立董事	李培瑛	5	0	100%	無
獨立董事	陳瑞聰	5	0	100%	無
獨立董事	童兆勤	5	0	100%	無

**其他應記載事項：**

**1. 審計委員會年度工作重點彙整**

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會於 114 年度審議之事項主要包括：

- (1) 財務報告及會計政策與程序
- (2) 內部稽核計畫及內部控制制度有效性之考核
- (3) 修訂內部控制制度
- (4) 評估簽證會計師之獨立性、適任性及公費
- (5) 盈餘分配案
- (6) 衍生性金融商品交易情形
- (7) 私募有價證券
- (8) 公司風險管控情形
- (9) 內部稽核主管之任免
- (10) 關係人交易情形

**▲審議財務報告**

董事會造具本公司民國 114 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經審計委員會查核，認為尚無不合。

**▲評估內部控制制度之有效性**

審計委員會審查公司稽核部門、簽證會計師和管理階層的定期報告，藉以評估公司內部控制制度政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)之有效性，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

**▲委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性**

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以合理確信財務報表的可靠性。除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，自 112 年起，並參考審計品質指標(AQIs)，就會計師之獨立性、專業性及適任性予以評估。於 114 年 2 月 21 日經第四屆第九次審計委員會及 114 年 2 月 21 日第十屆第十次董事會審議通過，認為勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師及方蘇立會計師均符合獨立性評估標準，並足以擔任本公司之簽證會計師。

2. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1) 證交法第 14 條之 5 所列事項：

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	審計委員會 決議結果	董事會對審計委 員會意見之處理
<b>第四屆第 9 次(114.2.21)審計委員會</b>			
1. 審查本公司 113 年度營業報告書及財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2. 審查本公司 113 年度盈餘分配案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
3. 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核暨出具 113 年度內控聲明書案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
4. 本公司內部稽核主管任命案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
5. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
6. 評估本公司聘僱會計師之獨立性及適任性案暨審計公費案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
7. 為規避匯率波動之風險，擬申請銀行買賣遠期外匯額度案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
8. 擬不繼續辦理本公司 113 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案」。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
9. 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
<b>第四屆第 10 次(114.5.9)審計委員會</b>			
1. 審查本公司 114 年度第一季合併財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2. 擬投資能源專案公司案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
<b>第四屆第 11 次(114.8.8)審計委員會</b>			
1. 審查本公司 114 年度第二季合併財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2. 為規避匯率波動之風險，擬申請銀行買賣遠期外匯額度案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
<b>第四屆第 12 次(114.11.7)審計委員會</b>			
1. 審查本公司 114 年度第三季合併財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	審計委員會 決議結果	董事會對審計委 員會意見之處理
3.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
4.訂定本公司 115 年度內部稽核計劃。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
<b>第四屆第 13 次(114.11.14)審計委員會</b>			
1.本公司擬取得不動產案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

3.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

4.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

(1)內部稽核部門除每月將稽核報告以電子郵件方式送交各獨立董事審核外，稽核主管亦會針對稽核發現及建議事項，於每季之審計委員會會議上向各獨立董事提出報告及說明，並回應獨立董事之疑問及建議。

(2)會計師依據審計準則公報第 39 號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局 93 年 3 月 11 日發布之台財證六字第 0930105373 號函規定，於規劃階段及完成階段，每季就本公司合併財務報告(年度另包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項，彙整資訊於審計委員會會議向各獨立董事進行報告及溝通。

(3)本公司每季至少召開一次審計委員會，114 年度於審計委員會之歷次會議中，獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形良好，溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點	溝通結果
114.2.21	<p>第四屆第 9 次審計委員會議之溝通事項如下：</p> <p>1.113 年第 4 季內部稽核執行結果報告。</p> <p>2.討論 113 年度內部控制制度有效性考核及自行評估結果報告，並出具設計及執行均有效之聲明書。</p> <p>3.會計師報告 113 年度個體及合併財務報表之查核內容及結果；並針對重大會計估計問題及證管相關更新之法令進行討論與溝通。另外，會計師亦報告 114 年度之核閱/查核規劃，並針對本公司已辨認之重大審計風險項目進行陳述與溝通。</p> <p>4.本公司內部稽核主管任命。</p> <p>5.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。</p> <p>6.評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。</p> <p>7.討論不繼續辦理本公司 113 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案」。</p> <p>8.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金</p>	<p>除左列溝通外，無其他建議事項。</p> <p>113 年第 4 季內部稽核執行結果提董事會報告；113 年度內部控制制度有效性考核並出具設計及執行均有效之聲明書及 113 年度個體及合併財務報告，提請董事會審查通過後如期公告及申報主管機關。</p>

日期	溝通重點	溝通結果
	<p>增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。</p> <p>溝通及獨立董事建議：無。</p>	
114.5.9	<p>第四屆第 10 次審計委員會議之溝通事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.114 年第 1 季內部稽核執行結果報告。</li> <li>2.會計師報告 114 年第 1 季合併財務報表之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題及近期法令更新進行討論與溝通。</li> <li>3.討論投資能源專案公司案。</li> </ol> <p>溝通及獨立董事建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.獨立董事詢問會計師關於季報的核閱結論，已由會計師及財務長說明回覆。</li> <li>2.獨立董事詢問投資能源專案公司之背景及交易模式，已由執行長及財務長說明回覆。</li> </ol>	<p>除左列溝通外，無其他建議事項。</p> <p>114 年第 1 季內部稽核執行結果提董事會報告；114 年第 1 季合併財務報告提請董事會決議通過後如期公告及申報主管機關。</p>
114.8.8	<p>第四屆第 11 次審計委員會議之溝通事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.114 年第 2 季內部稽核執行結果報告。</li> <li>2.會計師報告 114 年第 2 季合併財務報告之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題及近期法令更新進行討論與溝通。</li> </ol> <p>溝通及獨立董事建議：</p> <p>獨立董事詢問鑑於知名半導體產業洩密案件發生，公司相關規定及如遇此情況之處理方式為何，並提出建議予公司參考。由執行長及財務長說明，並將於下次會議向各獨立董事報告進度。</p>	<p>除左列溝通外，無其他建議事項。</p> <p>114 年第 2 季內部稽核執行結果提董事會報告；114 年第 2 季合併財務報告提請董事會決議通過後如期公告及申報主管機關。</p>
114.11.7	<p>第四屆第 12 次審計委員會議之溝通事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.上次會議追蹤事項報告。</li> <li>2.114 年第 3 季內部稽核執行結果報告。</li> <li>3.會計師報告 114 年第 3 季合併財務報告之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題及近期法令更新進行討論與溝通。</li> <li>4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>5.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。</li> <li>6.訂定本公司 115 年度內部稽核計劃。</li> <li>7.各出席委員、會計師及稽核主管並就財務報告及財務業務狀況等，進行單獨溝通會議。</li> </ol> <p>溝通及獨立董事建議：</p> <p>會計師說明會計師辨認之顯著風險及關鍵查核事項，獨立董事建議在整體性風險方面，公司可往風險量化方向發展及研究。</p>	<p>除左列溝通外，無其他建議事項。</p> <p>114 年第 3 季內部稽核執行結果提董事會報告；114 年第 3 季合併財務報告提請董事會決議通過後如期公告及申報主管機關。</p>
114.11.14	<p>第四屆第 13 次審計委員會議之溝通事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬取得不動產案。</li> </ol> <p>溝通及獨立董事建議：無。</p>	<p>除左列溝通外，無其他建議事項。</p>

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司依「上市上櫃治理實務守則」訂定公司治理守則，於103年11月5日經第七屆第三次董事會通過，期間經過董事會通過多次增修，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	符合上市上櫃 公司治理實 務守則
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司設有發言人、財務部門亦設有股務人員處理股東建議及相關問題，並於公司網站開放股東或投資人聯絡窗口蒐集相關建議。若涉及法律問題時，再委請法務部門同仁或法律顧問處理。	符合上市上櫃 公司治理實 務守則
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司股務代理機構定期提供股東名簿及相關報表，本公司亦依規定揭露相關資訊，並已設置投資關係人部門，與主要股東維繫良好的溝通管道。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業間之財務業務往來，已依據相關規定制定書面辦法並遵循之。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」，規範本公司董事、經理人、員工及其他因身分、職業或控制關係而知悉本公司內部重大資訊之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並適時對董事或員工等進行相關教育宣導。	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)本公司董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實情形請詳本年報「董事資料(二)」。	符合上市上櫃 公司治理實 務守則
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二)本公司除依法於董事會轄下設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另於110年5月7日設置風險管理委員會，並於114年11月7日更名為永續發展暨風險管理委員會，以強化董事會永續治理職能及風險管理機制；本公司亦有設置直屬於總經理之「資訊安全委員會」、「工安環保委員會」、「全面品質管理委員會」及「教育訓練委員會」，並定期向管理階層報告執行狀況。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司於109年3月10日第八屆第16次董事會通過訂定董事會績效評估辦法，每年將定期進行績效評估，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。目前董事會成員皆忠實執行業務及恪盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎的態度行使職權，以維護公司及股東權益。 114年度之董事會(含功能性委員會)之績效評估已於115年2月完成，並於115年3月11日將績效評估之結果提報第十屆第17次董事會，請參閱本報「董事會運作情形」。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司於104年初開始，每年定期評估簽證會計師之獨立性。114年評估及呈報之程序及內容如下： 1. 取具並檢視勤業眾信聯合會計師事務所林政治及方蘇立會計師簡歷資料。 2. 取具會計師出具之獨立性聲明書。內容需聲明審計小組成員及其配偶與受撫養親屬未有違反獨立性或未解決利益衝突之情形。 3. 上網搜尋簽證會計師以往是否有違反獨立性行為之紀錄。 4. 參照會計師法第47條規範之獨立性及職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」之內容制定「會計師獨立性及適任性評估表」，請詳本表下方說明一，逐項評估其是否有影響會計師獨立性之行為。 5. 本公司於112年經董事會決議通過修訂「公司治理實務守則」，並規範應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估所聘任會計師之獨立性、專業性及適任性，並將結果提報審計委員會及董事會審議後通過。114年度經參考及評估AQI指標資訊，確認會計師及事務所查核投入時數優於同業平均水準，並具備優於同業的品質控管能力，事務所近3年並導入審計創新工具，以提升審計品質，足堪擔任本公司簽證會計師。 6. 會計師獨立性及適任性之評估結果，於115年3月11日經第四屆第15次審計委員會及第十屆第17次董事會討論通過。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		<p>本公司目前負責公司治理相關事務之單位係由財務部門兼任，負責之相關事務如下。而公司治理主管已於109年11月6日第九屆第3次董事會通過設置，由財務長兼任之。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.研擬並規劃年度董事會及股東會之時程及初步議案內容。</li> <li>2.於各次董事會議前，規劃並擬定各議案之細部內容，於董事會前與公司內部董事確認議案內容，並於會議日七日前通知所有董事出席並提供所有議程相關資料，以利董事有足夠時間瞭解議案內容；若有董事對利害關係議案需迴避之情形，將於事前及會議前提醒。</li> <li>3.不定期更新證管法令供董事參考。於每次發出董事會開會通知時，亦會提醒董事善盡保密義務，避免違反證券交易法之相關規定。</li> <li>4.各次董事會議後製作議事錄，依法詳實記載議決之事項，由會議主席及記錄人員蓋章，於會後二十日內分送各董事，並於公司存續期間妥善保存於檔案室。</li> <li>5.每年依主管機關規定事先登記股東會日期，於公司治理評鑑規定之期限內完成製作及申報開會通知、議事手冊、年報及議事錄等會議相關資料，會議決議內容若涉及公司變更登記事項，將於會議結束後15日內向經濟部商業發展署申請辦理。</li> <li>6.負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保內容之適法性、正確性及即時性等符合資訊對等之精神，以保障投資人權益。</li> <li>7.提供董事進修之課程資訊，並協助安排課程及報名。</li> <li>8.定期向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</li> </ol>	符合上市上櫃公司 治理實務守則
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	✓		<p>本公司尊重利害關係人權益，透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.股東／投資人 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 關注議題：公司治理、經營績效、勞資溝通、人權維護。</li> <li>◆ 溝通管道：召開股東會(每年)、公開發佈財務報告(每季)、召開法人說明會(每季)、發言人及投資人關係部門(不定期)及公司網站(不定期)。</li> </ul> </li> </ol>	符合上市上櫃公司 治理實務守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>2.員工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 關注議題：職業健康與安全、勞資溝通、人權維護。</li> <li>◆ 溝通管道：職工福利委員會（每季）、電子平台及公司公告（不定期）、提案改善制度（不定期）、勞資會議（每季）、員工電子信箱（常設）、職業安全衛生委員會（每季）、員工心理諮商與輔導（不定期）、力成園地季刊（每季）及員工滿意度（每月抽樣）。</li> </ul> <p>3.客戶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 關注議題：職業健康與安全、人權維護、人才吸引與留任。</li> <li>◆ 溝通管道：業務會議(不定期)、客戶滿意度調查(每年)、客訴管理制度(不定期)及客戶稽核(不定期)。</li> </ul> <p>4.供應商／承攬商</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 關注議題：資訊安全與隱私權、職業健康與安全、人權維護。</li> <li>◆ 溝通管道：供應商／承攬商業務會議(不定期)、供應商評比(每季)、供應商／承攬商稽核(每年)及供應商／承攬商宣導會(每年)。</li> </ul> <p>5.政府機關</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 關注議題：能源與氣候變遷、污染防制、綠色產品、職業健康與安全、人權維護、人才發展與培育、社會參與。</li> <li>◆ 溝通管道：公文／電子郵件及會議(不定期)、宣導會／公聽會(不定期)及發佈函令(不定期)。</li> </ul> <p>6.社區團體</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 關注議題：水資源管理、污染防制、社區參與。</li> <li>◆ 溝通管道：公司網站(不定期)、廠務部門對外窗口及課程與參訪(不定期)。</li> </ul> <p>除了上述利害關係人溝通管道外，本公司網站另有設置企業永續發展及利害關係人專區，方便利害關係人及社會大眾閱覽，並設有利害關係人之聯絡管道，有利本公司瞭解利害關係人所關切的議題並能適時回應。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任康和綜合證券股務代理部辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司已架設公司網站，定期或不定期揭露公司財務業務及公司治理相關資訊。	除(三)未符合外，其餘皆符合上市上櫃公司 治理實務守則
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二)本公司設有專責人員負責公司資訊之揭露，除依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況及各項財務業務資訊外，亦於公司網站於投資人關係專頁中揭露中英文資訊。另設有發言人及代理發言人以落實發言人制度。 本公司按季自行召開法人說明會，定期說明公司財務業務狀況，並提供會議過程網路直播和會後置於本公司網站供投資人觀看，相關訊息亦公告於公開資訊觀測站。	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	(三)本公司114年度已於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，惟因本公司之簽證會計師事務所較為忙碌而未能配合，因此尚未於會計年度終了後兩個月內公告申報年度財務報告。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		<p>1. 員工權益及僱員關懷：請詳(五)推動永續發展執行之推動項目四、(一)~(四)之內容。</p> <p>2. 本公司每年提醒董事及經理人依規定持續進修。114年進修情形請參考本年年報「董事資料(二)」。</p> <p>3. 本公司制定「永續發展執行委員會組織章程」並成立「永續發展執行委員會」，每季召開一次會議，針對企業永續發展執行狀況及議題進行改善及討論。</p> <p>4. 本公司自97年起每年皆為董事(含獨立董事)及經理人購買責任保險。最近一期責任險於114年8月26日到期。本次投保以堆疊方式向美商安達產物保險(股)公司(基層保險部分)及富邦產物保險(股)公司(超額保險部分)辦理續保，保險期間114年8月26日至</p>	符合上市上櫃公司 治理實務守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>115年9月30日止，保險金額為US\$30,000,000，相關保險範圍及內容已於114年11月7日第十屆第14次之董事會中報告。</p> <p>5. 本公司已設置「永續發展暨風險管理委員會」及「營運持續管理推行委員會」，依循重大性原則識別與公司營運相關之環境、社會與公司治理議題之風險，並審視可能面臨的各種緊急狀況或影響維運之衝擊，以強化風險管理與應變能力。永續發展暨風險管理委員會之成員、職權及運作情形請參考本表下方之說明二。</p> <p>6. 每年度定期發行年報、財務資訊及永續報告書等，揭露公司治理相關資訊。</p> <p>7. 本公司為有效保護公司及客戶之智慧財產和資產，積極建構穩固的資訊安全管理系統，並於114年完成ISO/IEC 27001:2022轉版認證，證書有效期至117年10月2日，以維持ISO27001標準認證之有效性。</p>	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

本公司於第十一屆公司治理評鑑(評鑑113年度)之未得分項目，於第十二屆公司治理評鑑(評鑑114年度)時之改善情形說明如下：

指標類別	指標內容	是否改善	尚未改善及加強措施說明
維護股東權益及平等對待股東	1.1 公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？	否	因涉及董事個人隱私，尚未取得全體董事同意前暫不揭露。
	1.2 公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告？	否	本公司已訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，未來將視狀況提股東會同意或報告。
	1.15 公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，與說明執行情形？	是	

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
強化董事會結構與運作	2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並已於受評年度或過去兩年度執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？		否	本公司訂定之董事會績效評估辦法尚未明訂至少每三年執行外部評估一次，未來將視狀況加以修訂。
提升資訊透明度	3.13	公司年報是否自願揭露董事之個別酬金？		否	因涉及董事個人隱私，尚未取得全體董事同意前暫不揭露。
	3.14	公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結？		否	本公司已訂定經理人薪資報酬與績效評估之書面規範，未來將揭露重要績效評核項目。
	3.21	公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？		否	因涉及總經理及副總經理個人隱私，尚未取得全體經理人同意前暫不揭露。
推動永續發展	4.22	公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書？		否	本公司已成立教育基金會，將資源投入偏鄉教育，以落實企業社會責任。

說明一：本公司 114 年度會計師獨立性及適任性評估表如下：

評估項目	是	否
1. 簽證會計師任期未逾七年。	√	
2. 簽證會計師與本公司無直接或重大間接財務利益關係。	√	
3. 簽證會計師與本公司無融資或保證行為。	√	
4. 簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係。	√	
5. 簽證會計師與本公司無潛在之僱傭關係。	√	
6. 簽證會計師無收取與查核案件有關之或有公費。	√	
7. 簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近兩年內無擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。	√	
8. 簽證會計師及審計服務小組成員與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員無親屬關係。	√	
9. 簽證會計師及審計服務小組成員無收受本公司或董事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	√	
10. 簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目。	√	
11. 簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	√	

說明二：本公司 110 年 5 月 7 日經董事會決議設置「風險管理委員會」，並於 114 年 11 月 7 日經董事會決議更名為「永續發展暨風險管理委員會」，以強化董事會永續治理職能及風險管理機制。其職權包括：

1. 審議本公司永續發展暨風險管理相關政策、策略及管理方針。
2. 監督永續資訊暨風險管理揭露事項。
3. 監督本公司永續發展暨風險管理相關工作之執行。
4. 審查公司整體之永續發展暨風險管理政策、架構、組織及機制。
5. 執行董事會永續發展暨風險管理決策。
6. 審查並整合永續發展暨風險管理報告，適時向董事會報告。

原風險管理委員會成員及出席情形如下：

職稱	姓名	主要專長	114 年度出席率
董事	呂肇祥	註 1	100%
獨立董事	張光瑤	註 1	100%
獨立董事	童兆勤	註 1	100%

註 1：請參閱本年報「董事資料(一)及(二)」。

114 年度原風險管理委員會之運作情形如下：

原風險管理委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
第二屆 第 2 次 (114.5.9)	1.報告本公司 113 年度風險管理業務執行情形。 2.報告本公司 114 年度風險管理業務預計執行計畫。	全體出席委員 無異議通過	提董事會由全體 出席董事同意通過

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

**(1)薪資報酬委員會成員資料**

115 年 3 月 31 日

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事 召集人	張光瑤	註 1	註 1	無
獨立董事	李培瑛	註 1	註 1	無
獨立董事	童兆勤	註 1	註 1	無

註 1：請參閱本年報「董事資料(一)及(二)」。

## (2)薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- 二、本屆委員任期：第五屆委員任期為 112 年 6 月 8 日至 115 年 5 月 31 日。
- 114 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	張光瑤	3	0	100%	-
委員	李培瑛	3	0	100%	-
委員	童兆勤	3	0	100%	-

應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

薪酬委員會	議案內容及後續處理	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 4 次 (114.2.21)	1. 審查本公司修訂公司章程第 18 條與第 21 條第 2 項、暨增訂『員工酬勞分派原則管理辦法』，明定「經理人」與「基層員工」範圍及提撥一定比例員工酬勞分派予基層員工條文增訂案。 2. 審查本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 3. 審查本公司員工持股信託章程修訂案。 4. 審查本公司 114 年經理人薪資調整方案。 5. 審查經理人職務晉升薪酬案。	全體出席 委員無異 議通過	提董事會 由全體出席董事 同意通過
第 5 屆 第 5 次 (114.6.27)	1. 審查新委任經理人薪酬案。 2. 審查經理人職務晉升薪酬案。 3. 審查經理人職稱調整案。	全體出席 委員無異 議通過	提董事會 由全體出席董事 同意通過
第 5 屆 第 6 次 (114.11.7)	1. 本公司 113 年度董事酬勞分配執行說明。 2. 本公司 113 年度董事酬金與業界比較說明。 3. 本公司 113 年度經理人與基層員工之員工酬勞分配執行說明。 4. 本公司 113 年度經理人酬金與業界比較說明。 5. 審查新委任經理人薪酬案。 6. 審查本公司「經理人薪資報酬與績效評估辦法」。	全體出席 委員無異 議通過	提董事會 由全體出席董事 同意通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>1. 本公司為健全企業永續發展之管理，103年8月1日設置「企業社會責任室」為專職單位，並於104年2月9日經董事會通過，隸屬於董事會，該組織於111年3月更名為「永續發展管理室」，負責企業永續發展政策、制度、相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每季召開「永續發展執行委員會」向高階主管說明執行情況，以及每年定期向董事會提報，相關內容已於114年8月8日第十屆第13次之董事會中討論並通過。</p> <p>2. 為確保企業永續發展，本公司董事會於110年5月通過於其轄下設置「風險管理委員會」，並於114年11月更名為「永續發展暨風險管理委員會」，由獨立董事2人及董事1人所組成，每年至少召開一次會議，職責為協助審查風險管理政策、方針、風險承受度及督導各項風險管理制度之執行，落實企業永續發展。為順利運作相關業務，於永續發展暨風險管理委員會下另設立「永續發展暨風險管理推動小組」，採任務編組方式，由總經理擔任組長、指定一名副組長、公司治理主管擔任執行秘書、組員包括各部門一級主管若干名，召開會議討論風險議題，並每年定期將相關內容提報於永續發展暨風險管理委員會中討論，落實風險管理的有效性。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<p>1. 本公司秉持嚴謹的風險管理來確保公司的正常運作，正視風險的存在，設置有「永續發展暨風險管理委員會」隸屬於董事會之下，執行風險監控並每年定期向董事會報告，以積極的態度轉化風險為機會，定期透過風險的監控、辨識、衝擊評估與擬訂因應對策來降低風險。</p> <p>2. 114年依重大性原則及營運持續管理目標，鑑別出與公司營運相關之環境、社會與公司治理議題之風險有環境類：「公共服務中斷」、「環境及氣候變遷」；治理類風險：「IT資通訊」、「供應鏈管理」、「區域衝突」等五項議題，以及新興風險：「低碳化及再生能源使用提升」與「人力短缺」，彙報於董事會，並且針對各種不同風險項目規劃專人專責之管理方法與危機因應步驟，建立起預警、應變、危機管理、營運持續計畫，以及復原行動等營運永續防護網，為利害關係人創造永續價值而努力；相關風險內容亦會於董事會中報告與說明。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		<p>(一)為善盡環境保護及照顧員工安全健康之企業責任，本公司依所屬產業特性建立相關之環境管理制度，分別於92年通過ISO 14001環境管理系統、93年通過OHSAS 18001(現已改為ISO 45001)職業安全衛生管理系統；響應全球節能減碳及綠色環境，力成科技自2018年開始進行ISO 50001能源管理系統的建置與導入，並據以實施環境暨安全衛生管理措施，訂定環境安全永續目標及定期檢討之。本公司於108年12月通過SGS台灣檢驗認證取得證書，最新有效期間為114年12月04日至117年12月04日。藉由國際標準管理系統的運作，有效落實廠內生產過程中所衍生之空污、水污及廢棄物等管控；除此之外，於97年通過IECQ QC080000有害物質管理系統驗證，以確保公司的產品不含危害人體及環境重大衝擊之物質、無有害材料，符合國際法令規章及客戶要求，降低產品對環境之衝擊。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。
<p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	✓		<p>(二)請參考本表下方說明一。</p>	
<p>(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p>	✓		<p>面對氣候變遷對營運可能產生的衝擊，本公司積極面對並承諾持續減少溫室氣體、廢棄物、廢水排放，積極投入能源效率最佳化之規劃與配置，研究低碳或節能之製程、服務開發；並根據氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構執行氣候相關風險與機會鑑別，跨組織評估氣候變遷風險與因應措施，鑑別之結果提供經營團隊於營運決策之考量，將危機轉化為轉機，並且同步將此正向影響力推動到供應商，建構因應氣候變遷的韌實力，114年力成科技TCFD鑑別結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 風險因子：極端氣候影響(如颱風、水災)、再生能源使用要求上升。</li> <li>2. 機會效益：透過研發和創新發展新產品或服務、資源替代/多樣化。</li> <li>3. 因應作為：依據TCFD的框架，透過治理、策略、風險管理、指標和目標等四項核心要素，進行氣候風險與機會鑑別，並根據鑑別結果制定出因應措施、營運持續計劃等，藉以降低氣候風險的衝擊，並掌握氣候機會帶來的效益，強化營運體質與韌性。</li> </ol>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			有關本公司的氣候風險與機會分析與說明，登載於本公司永續報告書與年度「氣候相關財務與機會」主題報告，並揭露於公司官網。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四)請參考本表下方說明二。	
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>(一) 本公司承諾尊重人權、維護人性尊嚴，並將人權視為企業核心價值，於所有營運活動中，遵循營運所在地之適用勞動法規，參考與支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國工商企業與人權指導原則》、《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》、《國際勞工組織公約》及《經濟合作暨發展組織(OECD)跨國企業準則》等國際人權指引，並依循責任商業聯盟(RBA)行為準則，推動人權管理與實踐。</p> <p>本公司人權管理措施適用於全球各營運據點之員工、供應商、承攬商及合作夥伴。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定人權管理措施及勞工政策，落實多元、平等、共融(DEI)的友善職場。</li> <li>2. 禁止任何形式之強迫勞動與人口販運；禁止僱用童工及杜絕任何形式之歧視、騷擾或非人道待遇。</li> <li>3. 本公司於 98 年導入「責任商業聯盟行為準則」，並於 104 年 4 月 20 日正式加入「責任商業聯盟(RBA)」，成為其會員，遵循至今。</li> <li>4. 本公司每年度執行人權風險評估及盡職調查作業，監控、減緩人權風險，依循制定企業人權政策、執行風險評估、施行因應管理、效益追蹤、救濟措施，以及溝通與揭露等程序，出具「人權盡職調查報告(HRDD)」並揭露於公司官網。</li> <li>5. 表達與參與：本公司尊重所有人員的表達與參與自由，承諾不以任何干擾或限制妨礙其權利合法行使，並以隱私保障為基礎，提供內外部利害關係人多元、開放、雙向的溝通管道。</li> <li>6. 每年度執行全體員工之勞工人權及相關培訓課程，持續提升人員對人權保障的意識。</li> <li>7. 本公司承諾提供員工安全健康及得以充分發揮才能的工作環境，為落實該項承諾，我們遵守當地法規，並根據上述國際勞工及人權標準，制定相關之管理政策與程序。</li> </ol>	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			為實踐人權治理，本公司建立以董事會為最高層級的人權治理架構，由「永續發展推行委員會」轄下之「員工關懷與社會參與」工作小組，有系統且有效地推動人權管理作為；除每季定期向「永續發展推行委員會」報告推動進展，同時每年向董事會轄下的「永續發展暨風險管理委員會」報告人權管理作為與執行成果。	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二)請參考本表下方說明三。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三)請參考本表下方說明四。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司透過教育訓練體系的規劃，促進經營理念與訓練投入的一致性，展開各項訓練機制交互運作，提供員工全面性的訓練與職涯發展藍圖，針對不同職級、職務進行不同的訓練，確保人才培育與職能發展符合公司營運成長所需。 有關本公司人才發展相關說明，揭露於本公司永續報告書及公司官網。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，公司就研發、採購、生產、作業及服務流程制定相關政策，如：防範產品或服務損害利害關係人、禁止洩露機密資訊、禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平競爭之行為等政策。有關本公司智慧財產之管理，請參考本表下方說明五。 本公司已建立相關檢舉申訴程序，檢舉申訴管道除公司內部公告外，亦揭露於公司網頁，以確保內、外部利害關係人之權益。	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六)本公司將供應商／承攬商視為合作夥伴，致力於共同建立穩定發展及永續經營的供應鏈管理。 1. 依據本公司「誠信經營及從業道德守則」及「供應商行為準則」規定，本公司與供應商建立商業關係前，須先行評估商業往來交易對象，採行適當查核程序，檢視商業往來對象，以瞭解過去有無影響環境與社會之紀錄。 2. 要求供應商遵循RBA行為準則，並制定有	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>勞工人權、環境保護及商業道德等供應商行為準則；其中，商業道德包含誠信廉潔守則、誠信經營及從業道德、反競爭及反賄賂政策等。</p> <p>3. 持續性的針對品質、交期、成本、技術及社會責任合規度等，制定供應鏈管理目標與評比項目，並每年按年度計劃進行現場稽核，其稽核系統包括有：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 品質管理系統</li> <li>◆ 原物料有害物質禁用的綠色產品管理系統</li> <li>◆ 勞工人權、環境、道德等之RBA行為準則管理系統</li> <li>◆ 環境安全衛生風險管理</li> <li>◆ 營運持續管理</li> </ul> <p>有關本公司供應鏈管理之具體作法，請參考本表下方說明六。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		<p>本公司每年度定期發行永續報告書，114年永續報告書依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)所出版的GRI準則、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構、永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)之SASB準則(半導體業)、自然相關財務揭露(Task Force on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)架構等進行編製、撰寫，並通過獨立第三方公正單位英國標準協會(BSI)依據GRI準則、AA1000 AS Type II高度保證、SASB 準則Type I中度保證等級進行查證。針對「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，則委由勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)查核確認，取得查證及薪資查核等證明。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司參酌『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』及相關法令制定「企業社會責任實務守則」，於102年11月8日經董事會決議通過實施，因應臺灣證券交易所於110年12月7日公告將『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』修訂為『上市上櫃公司企業永續發展實務守則』，本公司於111年3月10日經董事會決議通過第三次修訂，並更名為「企業永續發展實務守則」，以提升履行企業永續發展成效，落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續發展資訊之揭露，其運作與所訂守則並無差異情形。本守則適用於本公司及其轄下各子公司之整體營運活動。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>請參考本表下方說明七。</p>				

說明：一、本公司為提升各項資源、能源之使用效率並降低生產活動對於環境所造成之衝擊，制定相關管理措施。

1. 建立能源、資源績效管理目標

針對可回收之能源、資源建立績效管理目標，並定期檢視執行成果；此外，在不影響產品品質之前提下，評估並提倡使用對環境負荷衝擊低之再生物料。為了落實環境保護及因應現今氣候變遷與水資源枯竭的狀況，我們持續關注能源、資源使用密集度，並增加廢棄物回收成果、節電成果及提高製程回收水比例來取代自來水使用需求。

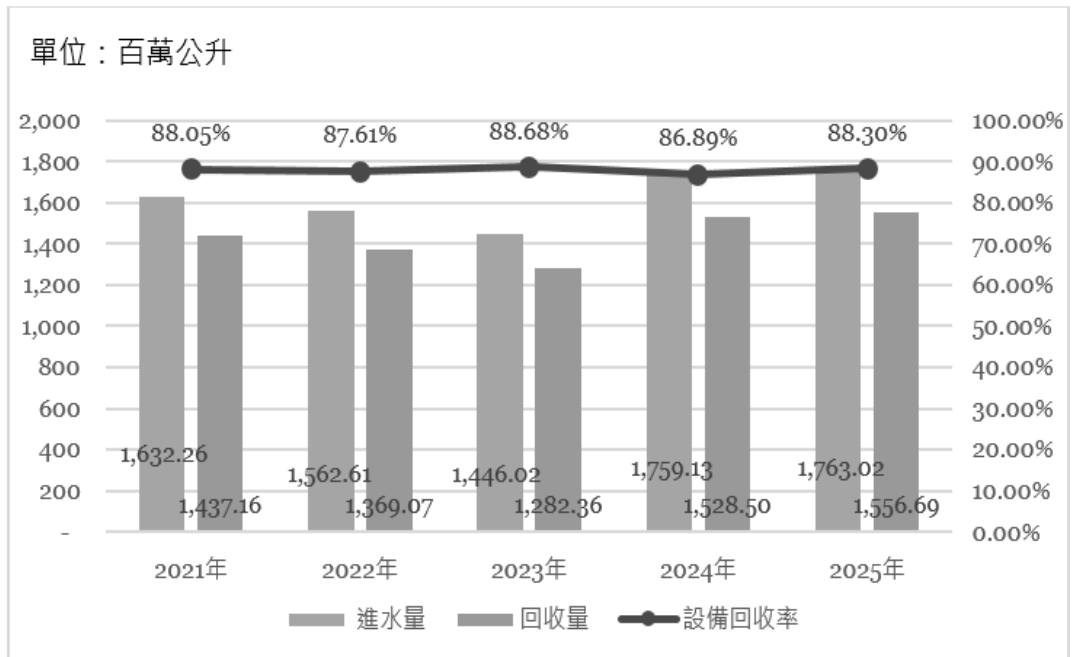
(1) 最近二年能源、資源密集度及使用情況

項目	2024年	2025年	上升/下降比例
電力密集度 用電量(kWh) / 個體營收(新台幣仟元)	15.05	14.66	下降 2.59%
用水密集度 用水量(公噸) / 個體營收(新台幣佰萬元)	63.78	75.30	上升 18.06%
廢棄物密集度 廢棄物量(公噸) / 個體營收(新台幣佰萬元)	0.15	0.16	上升 6.67%

項目	2024年	2025年
廢棄物回收總重量(公噸)	5,707	6,511
節省電力消耗量(kWh)	14,459,016	20,255,665
廢水回收處理量(公噸)	1,528,497	1,556,691

註：廢棄物回收項目擴大，包含資源回收、循環再利用、能源回收等。

(2) 2025 年力成科技之切割研磨製程回收水使用比例為 88.30%。



註：1. 具有製程回收系統之廠區為湖口廠 (2 廠)、大同廠 (3A 廠、3C 廠)、竹科一廠 (8 廠)、竹科三廠(11 廠 B)。

2. 比例 (%)=[回收水量 (m3) / 回收設備進水量 (m3)]\*100%

3. 2025 年切割研磨製程回收水系統回收率目標值為 85%。

## 2. 再生能源使用目標

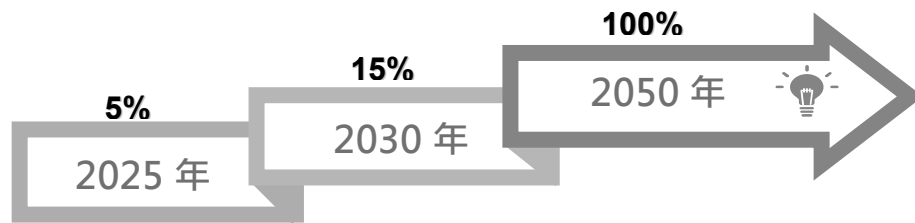
力成科技支持氣候變遷倡議，積極落實減碳措施，2021年啟動再生能源設置專案，擬訂施行計畫：

### (1) 啟動再生能源建置專案

- ◆ 2022年於廠區屋頂架設太陽能發電設備，2023年初完成掛錶作業，2025年總發電量為3,537,845 kWh。
- ◆ 向再生能源發電業者購置綠電，並於2023年起進行綠電轉供。2025年外購再生能源達35,357,147 kWh，占比達4.7%。
- ◆ 2025年度力成科技之再生能源使用量為38,894,992 kWh，占比達5.2%。

### (2) 中、長期規劃之目標：接軌國際，落實淨零

- ◆ 2025年再生能源比例達5%；2030年再生能源比例達15%
- ◆ 接軌RE100倡議，2050年達100%再生能源



二、本公司善盡企業社會責任，透過內部管理系統運作及多項污染防制設施，推動節能減碳、溫室氣體盤查與減量、減少用水及廢棄物等管理措施，以維護永續環境之目的。近兩年統計內容說明如下：

### 1. 溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量

#### (1) 溫室氣體排放量

自2007年起，即每年自發性的實施溫室氣體盤查，並將盤查結果作為減量依據。本公司2025年之溫室氣體排放量統計為各主要生產據點依據實際盤查並經第三方公正單位(SGS)查證通過之數據(註)，直接溫室氣體排放(範疇一)約佔總排放量之2.43%；間接溫室氣體排放(範疇二)主要為電力耗用，約佔總排放量之97.57%，故本公司具體的溫室氣體減量策略著重於用電管理及以減少用電量為核心之方針執行。近兩年溫室氣體排放量如下表所示：

(範疇一、二資訊涵蓋力成科技所有廠區)

溫室氣體排放量 (單位：ton CO <sub>2</sub> e/year)		
項目	2024年	2025年
範疇一	7,455.97	8,057.79
範疇二	339,416.97	325,035.49
總排放量	346,872.94	333,093.28

註1：2025年溫室氣體盤查數據為自盤結果，預計於2026年6月底前完成第三方驗證。

註2：範疇三詳細內容請見2025年永續報告書「7.1.3碳管理」章節。

#### (2) 用水量

(資訊涵蓋力成科技所有廠區，預計於2026年7月底前完成第三方驗證)

鑒於近年來氣候變遷造成水環境急遽變化，旱澇發生交替愈趨頻繁，且利害關係人對於水資源議題日益關切，為及早因應複雜之水資源問題，力成依據減量、再利用與回收三項策略進行水資源管理，提高使用效能，並持續推動各廠區節水措施。近兩年用水量如下表所示：

項目	2024年	2025年	比例
總自來水用量(公噸)	2,982,264	3,244,419	上升8.8%
地下水用量(公噸)	35,262	31,847	下降9.7%

### (3)廢棄物總重量

2025年力成產出7,827.50公噸廢棄物，均委由合格清理廠商進行妥善之處理，其中有害廢棄物產出量2,600.44公噸，主要為清洗晶圓過程產生的廢液；非有害廢棄物產出量5,227.06公噸，主要為廢水處理過程中產生的污泥。力成透過回收再利用等措施，非有害廢棄物回收量(含能源回收)計5,111.20公噸，使2025年非有害廢棄物回收率(含能源回收)達97.8%，並且透過廠內落實資源分類與循環經濟，將資源循環再利用，降低對環境之衝擊。

## 2.制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策

為了落實發展環境永續，本公司亦於「企業永續發展實務守則」中明白制定公司節能減碳及溫室氣體減量之策略，以及將綠電、再生能源憑證等取得納入公司之減碳措施規畫中，且據以推動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。為因應氣候變遷影響，本公司擬定年度目標，用具體數據管理環境保護之成效，包括有：

### (1) 2025年度環境永續管理成效

A.非有害廢棄物回收率(含能源回收)達97.8%。

B.切割研磨製程回收水系統效益達88.30%。

C.節電20,255,665 kWh，約少9,601.19公噸二氧化碳當量的排放，達成目標1.5%的節電量。

D.達成減碳1%的目標；溫室氣體減量目標從2020年起至2030年，減量達15%。

E.積極針對廠務、製程等二大類設施執行共161項節能減碳措施。

F.CDP氣候變遷成績：2025年CDP氣候變遷成績獲評B，為管理等級。

G.CDP水安全成績：2025年CDP水安全成績獲評B，為管理等級。

H.為因應氣候變遷對於企業營運的衝擊與具體呈現氣候變遷的資訊揭露，2025年本公司依據TCFD管理機制，針對氣候變遷進行業務盤點和風險辨識，包含因極端氣候造成直接或間接之衝擊、因法規、技術或市場需求的轉型影響，以及其他人文、社會面向對公司營運活動造成之風險與機會進行分析，並出具TCFD主題報告及揭露於公司官網。

### I.減廢和回收再利用：

#### a. 製程廢塑膠回收再利用

因應國際資源永續趨勢，從焚化處理的廢棄物中，將具有循環利用效益之製程廢塑膠(藍膜、捲帶盤)進行全面回收再利用，再利用回收機構將廢藍膜與捲帶盤進行拆解、分類、破碎、熱融、造粒等步驟，最終產出再生塑膠粒，可再製成塑膠製品。2025年分別清除16.53公噸廢藍膜及37.10公噸廢捲帶盤至回收再利用機構，衍生因避免焚化處理之減碳效益共16,661.70公斤CO<sub>2</sub>e。

類別	執行廠區	清除量 (ton)	減碳效益 (kgCO <sub>2</sub> e)
廢藍膜 Blue Tape	P2、3C	16.53	5,620.20
廢捲帶盤 Tape & Reel	P1、P10、P9	37.10	11,041.50

#### b. 化學空桶循環使用

化學品供應商持續實施空桶循環使用，化學品原物料使用後之空桶由原供應商回收重新填裝原物料送回力成重複使用。2025年供應力成科技化學藥液較2024年增加17%，回收約4,517個200L Drum桶，減少產出51.95公噸廢棄空桶，因降低廢空桶處理量，避免委託物理處理造成碳排放，減少廢棄物處理階段之6,389.30公斤CO<sub>2</sub>e排放。

年份	化學品種類	容器類型	供應藥數量 (噸)	回收瓶數量 (個)	回收瓶數量 (噸)	減碳效益 (kg CO <sub>2</sub> e)
2024	7類	DRUM 桶/200L	769.6	3,848	44.25	5,443.00
2025	7類	DRUM 桶/200L	903.4	4,517	51.95	6,389.30

c. 漸進式調整廢靜電袋處理流向

以往因靜電袋之塑膠與鋁箔層難剝離而多採焚化處理，2024年起委託再利用機構，顯著降低焚化處理量，且透過鋁塑分離技術產出鋁條及複合材質塑膠粒之再利用產品，創造廢靜電袋的循環經濟價值。2025年因產能上升，使廢靜電袋產出量增加約29%，再利用處理量能飽和，故部分廢靜電袋仍委託焚化處理，合計排碳量7,847.20公斤CO<sub>2</sub>e。後續評估增加多元再利用流向，避免受限後端機構量能。

d. 清潔生產評估系統評定

致力於營運過程中持續降低對環境之衝擊，耕耘綠色製造技術多年，包含原料減量/循環利用、環境友善的製程設計、去碳化/去毒化的創新作為，繼2024年大同廠取得經濟部產業發展署清潔生產評估系統合格證書，2025年3C廠亦順利通過評定，於12月取得合格證書，將持續推動全廠區通過清潔生產系統評定。

(2) 環境管理計劃

為善盡企業社會責任，透過污染防制設施妥善操作，以維護永續環境，長期執行下列環境管理計劃與措施：

- A. 廢氣處理：設置空氣污染防制設備處理VOCs，每年依法規之要求定期檢測，並配合環保局委託之檢測公司，對空氣污染防制設備排放管道之處理效率進行抽測，其檢測結果皆符合法規要求。
- B. 製程用水回收：運用廢水回收設備，減少水資源消耗，用製程回收水來取代自來水之使用需求，以達節約用水及保護水資源之目的。
- C. 廢棄物清理：生產過程產生之廢棄物清理，皆依法妥善處理，並在產生廢棄物源頭確實做好分類收集以提高廢棄物之可回收性。對於製程廢棄物之處理模式為收集、分類、減量及回收，主要管理策略是以「資源回收」來取代「掩埋處置」，讓廢棄物變為可用資源，降低對環境的衝擊，並有效管理以提高資源再利用的價值。
- D. 協力廠商稽核與輔導：定期稽核具環境污染風險之供應商與外包商，輔導協力廠商落實環境保護工作，共同履行企業社會責任及達成永續供應鏈之目標。
- E. 節能減碳：啟動再生能源建置專案，使用再生能源；成立跨部門節能組織，執行節能專案，降低能源消耗與溫室氣體排放量；並揭露碳排放資訊，以符合國際環保趨勢，為防止氣候暖化善盡企業責任。
- F. 自主環境監測：規劃涵蓋廢水水質、噪音音量、空氣品質、廢棄物性質等各類環境自主監測計劃，以有效掌控企業活動對環境品質造成之影響與衝擊。
- G. 環境許可變更：配合企業活動變化，適時提出各項環境許可之變更，使企業活動與污染排放均能符合環境法令之規範。

(3) 設置環境保護專責單位

本公司設有工安環保部門，專職負責工安環保事務之管理與推行，以及監督各項污染防制設施之正常運作。此外，亦設有「安全衛生委員會」，由高階主管、各廠廠長及勞工代表們參與會議，透過定期召開會議並研議公司安全衛生與環境保護之議案，讓環境永續議題融入經營管理中。

(4) 制定「環境安全衛生政策」

為厚植人員安全及環境保護觀念於企業營運及每一位人員的意識中，制定有「環境安全衛生政策」，將環境與安全衛生政策落實於員工、客戶、承攬商及相關利害團體上，具體政策有：

- A. 【資訊透明，全面溝通】將環境與安全衛生政策傳達予員工、客戶及相關團體。
- B. 【恪守法規，超越期待】符合環境保護、安全衛生相關法令規章及客戶之要求。
- C. 【全員參與，風險防禦】工作者及其代表諮商及參與防止傷害、疾病、職場不法侵害、事故預防及損失控制。
- D. 【綠色轉型，永續運作】順應國際環境保護趨勢及組織處境，積極推動節能減廢活動。

三、為符合公司的長期營運發展，同時兼顧員工生活水準，每年透過市場薪資調查，檢視公司薪酬條件與市場薪酬水準，並參考總體經濟指標、物價指數，針對員工薪資作出適切的調整，優化薪酬競爭力吸引優秀人才加入，以達互惠雙贏的效果。且遵守相關的勞動法令，以優於當地基本工資之薪資待遇聘僱員工。我們亦以全面性及優於法令之角度設計完善的福利制度回饋給每位同仁。

1. 力成科技的獎酬與福利項目如下，114 年福利補助達到新台幣 338,923,155 元。

類別	內容
獎金	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年終獎金：共兩次，於上、下半年度發放</li> <li>• 季獎金：依據獲利狀況、是否達成公司設定之目標</li> <li>• 員工酬勞／激勵獎金：依據獲利狀況、參考個人工作職責／貢獻度與績效評核</li> <li>• 調薪制度：每年更新調薪數據</li> </ul>
福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年節賀禮 (新年、勞動節、端午、中秋及聖誕)</li> <li>• 免費團保 (眷屬享壽險、意外險、醫療險及癌症險等)</li> <li>• 自費團保優惠方案 (員工父母及配偶父母)</li> <li>• 定期免費健檢</li> <li>• 福利補助 (結婚、生育、住院及喪儀禮金)</li> <li>• 旅遊補助</li> <li>• 餐費補助</li> <li>• 生日賀禮</li> <li>• 電影欣賞</li> <li>• 社團活動</li> <li>• 公司活動 (年度晚會、家庭日等，視年度規劃舉辦線上/線下活動)</li> <li>• 特約商店 (超過 1,000 家特約商店提供的折扣)</li> <li>• 托兒措施 (與員工居住區域之優良幼兒園、托兒機構簽訂特約優惠合約做為托兒措施，提供員工於安排子女學前教育或安親的照料時，有多元的機構可選擇)</li> </ul>

2. 113 年啟動「員工持股信託」並納入員工福利計畫，旨在藉此強化員工與公司之間的關係，進而激勵員工與公司共同努力，持續創造更好績效。員工每月可自願提存一部分薪資，公司將相對提撥具有獎勵性質的公提金，透過信託機制，委託專業受託銀行協助管理和運用信託資金，鼓勵同仁進行長期、定期定額投資並持有公司股票。

3. 職場多元化與平等

- ◆ 本公司保障女性與男性皆擁有相同的工作權。統計至 114 年底，男性員工占員工總數的 48.57%，女性員工占員工總數的 51.43%，男、女性員工比例幾乎相當，顯示了女性工作者在力成科技具有公平、客觀的工作保障與成長空間。
- ◆ 薪酬設計及核定依據員工之學經歷背景、專業知識技術、年資經驗、職務類別及個人績效表現，採用公平公正之作業程序，同工同酬對待全體同仁，依職務類別而非以性別敘薪，錄用後則視其工作表現逐年調薪及晉升，給予相對應之薪酬，不因其性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況或工會社團等而有所不同，公司薪酬制度均符合勞動相關法規的規定。本公司積極實現多元職場，支持女性員工的成長與職涯發展。於 114 年 4 月 1 日年度晉升中，女性員工晉升占比 39.6%。

四、本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，致力於提供一個安全和健康之工作場所。工作環境與員工人身安全保護措施如下：

1. 訂定「環境安全衛生政策」

為達預防職傷事故並維護安全和健康之工作場所目標，訂定「環境安全衛生政策」。

2. 依循安全衛生管理系統管控  
以 ISO 14001 及 ISO 45001 之管理系統展開與管控。
3. 作業環境測定  
本公司每半年實施一次作業環境測定來瞭解工作環境危害暴露的實際情況，經由採取之規劃、採樣、監測與分析之過程，若測量結果顯示有異常的測定值，將針對異常區域實施監測並著手進行改善。
4. 個人防護管理  
為維護員工的安全和健康，減少於操作過程中接觸有害因子，本公司建立了個人防護具管理作業規範，並要求員工在進行危害性作業操作時穿戴適當的個人防護具。
5. 健康關懷與照顧  
本公司提供完善的員工照顧與健康關懷機制，照顧每位同仁的身心健康，包含全方位的溝通管道、設置心理諮商機制、與專業醫療機構合作進行定期健康檢查、提供醫療諮詢服務、職場不法侵害/暴力防制、重視母性同仁健康保護及對於同仁因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，並適時對員工宣導疾病預防等，用以照護員工之身心健康。
6. 實施教育訓練  
為提高員工對環境與安全衛生之意識，除了新進人員的教育訓練外，本公司每年規劃各種教育訓練課程，如廢棄物儲存分類規定、溫室氣體排放盤查、危害鑑別、風險評估暨環境考量面、個人防護具管理實務、自動檢查方式、緊急應變及健康講座等，持續強化員工意識與技能。
7. 健康促進與管理  
114 年辦理了多場的健康促進活動包括：流感疫苗施打、捐血、視力保健活動等，臨場醫師服務次數達 272 次。
8. 職業傷害管理  
114 年本公司同仁無發生職業病之災害，受傷失能件數共 19 件。分析其傷害類型主要為「跌倒」居多，占傷害類型 37%，為減少這類型傷害，避免重覆發生類似職業傷害，持續透過主管巡視或例行巡檢發現所屬部門中人員作業通道暢通性，此外人員於工程作業進行時應將現場進行圍籬管制，避免非相關人員進入作業區。透過宣導行走或搬運物品時注意步伐穩定及路面狀況，且避免穿著的鞋子有明顯磨耗或破損等措施，以減少因滑倒、絆倒而發生職業傷害發生情形。
9. 工安巡檢  
為使安全衛生人員對於廠區及周遭之作業環境，能以管理系統中矯正預防做法，及早發現問題點預防事故發生，並配合由現場作業主管自主巡檢或聯合巡檢，故建立完善之巡檢制度。將巡檢缺失結果及改善率進行部門與類型統計分析，提報於每月工安月會及每季職業安全衛生委員會進行檢討審視。

項次	巡檢人員/內容	頻率
1	工安人員作業場所巡視	每日至少一次
2	工安人員作業環境安全巡檢	每週一次以上
3	工安人員作業環境專案巡檢	每月一次以上
4	工安人員主題式巡檢 (因應法規變更、事故、內外部稽核等)	不定期
5	工安績效管理交叉稽核	每季一次
6	生產製造工安現場巡檢	每週至少一次
7	現場主管走動管理	不定期
8	現場廠/處長級主管自主聯合巡檢	每月一次

10. 本公司 114 年度無發生火災之情形。

## 五、智慧財產管理計畫與執行情形相關內容

### 1、智慧財產管理

#### (1) 智慧財產管理計畫

確保公司營運自由及擴大競爭優勢，強化智慧財產布局，持續提升智財品質，並將技術、產品與智財結合，創造產業價值及提升營收；制訂與營運目標及研發策略連結之智慧財產管理計畫，深化關鍵技術，保護研發成果，並提升同仁智慧財產保護意識；同時，持續優化智財管理系統與智財權管理，確保技術領先地位並降低營運風險，落實公司治理法規遵循，實現永續經營。

#### (2) 智慧財產管理策略

本公司致力於落實公司治理法規遵循與永續經營，將智慧財產視為企業核心資產。藉由智慧財產管理系統，持續提升智財品質並落實智財保護，確保技術領先及構築堅實法律防護網。透過優質的專利佈局與技術防禦，專利與營業秘密雙軌保護機制，全面運用智慧財產強化競爭優勢，實現企業長期成長與產業領導地位。

#### (3) 智慧財產管理措施

A. 專利：訂定專利商標申請管理規範與獎勵措施，鼓勵研發同仁積極將研發成果轉成專利提案，經由內部審查機制及專利提案審查系統，提升研發同仁的提案審查效率；專利委員對於提案技術、實務應用及市場發展趨勢，全方位地審核提案價值，彈性調整專利佈局，發揮專利保護之最大效用。從初期的前案檢索、界定保護範圍、確認布局方向，乃至到後期的分析審查意見、擬定答辯策略、權利維護等，智財部門均高度掌握進度及確保執行品質，爭取較大的權利範圍。建立智慧財產權管理清單，定期盤點及維護。

B. 商標：本公司藉由註冊商標權，建立與他人技術服務的區別，達到差異化及市場辨識度。這些商標可用於行銷推廣中，以展現技術服務的核心標誌與特色。當發生第三方不當冒用或近似標記之情事時，本公司將依法主張權利，防範混淆誤認風險，確保永續營運之利益。

C. 營業秘密：營業秘密是公司保持競爭優勢的關鍵之一，透過註冊系統有效紀錄及保存公司重要的營業秘密，並且定期與不定期地舉辦智財教育訓練，不斷強化人員智財保護意識，確保公司智慧財產權獲得有效的保護。

#### (4) 有關智慧財產權之風險及因應措施

力成致力於保護智慧財產權，同時也尊重他人合法的智慧財產權，儘管本公司積極落實自主開發，但面對複雜的技術演進，無法保證公司獨立開發之技術或在不知情的狀況下不會侵害到他人智慧財產權。對於此風險，公司將策略性取得某些特定技術的授權，同時盤點公司智財作為防禦訴訟或交互授權之籌碼，此外，透過加入 LOT 聯盟，抵禦非實施專利實體(NPE)的不當侵擾，降低營運風險。

### 2、執行情形

截至 114 年 12 月 31 日，本公司歷年獲准專利累計超過 1000 件，其中 631 件台灣專利，398 件美國及其他國家專利；截至 114 年 12 月 31 日，本公司專利申請案共 79 件，其中 26 件台灣申請案，53 件美國及其他國家申請案。每年定期於第四季將智慧財產管理計畫執行情形提報至董事會報告，114 年提報日期為 11 月 7 日。本公司自 109 年起導入台灣智慧財產管理制度，114 年主要執行情形如下：

(1) 提出 TIPS 智慧財產管理制度(A 級)再驗證申請，並於 10 月 17 日通過驗證。

(2) 達成今年專利提案規劃及專利申請之設定目標，其中包含專利與 ESG 連結。

(3) 持續推動營業秘密註冊系統並完成營業秘密盤點作業，辦理金質獎等評選活動，以激勵同仁踴躍註冊並肯定同仁貢獻。

(4) 舉辦智財教育訓練，以強化同仁智財保護意識。

### 3、驗證情形

力成自 109 年導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)並通過首次驗證後，持續優化已建立的智慧財產管理制度，接連於 110 年通過 TIPS 再驗證、111 年通過 TIPS 抽驗程序、112 年通過 TIPS 再驗證，並於 114 年再度提出 TIPS 再驗證申請且通過獲證，證書有效期間至 116 年 12 月 31 日。藉由不斷深化與公司營運目標連結的系統化智慧財產管理制度，有助於公司競爭力提升，並實踐企業永續經營。

### 六、本公司供應鏈管理具體作法如下：

以永續經營為核心價值，將此理念延伸至供應鏈管理，制定永續願景與執行策略，創造共榮、雙贏的永續供應鏈。

#### 1. 推行策略與供應商行為準則

策略	做法	說明
策略一：強化 供應鏈韌性與 永續性	• 制定「供應商行為準則」遵循	以勞工人權、職場安全、環境保護、誠信道德及營運持續等構面，建立「供應商行為準則」並要求所有合作供應商遵行
	• 施行供應商篩選與管理措施	落實供應商分級制度，並制定從供應商篩選、盡職調查、品質/技術/服務/ESG 等評鑑，推行各項供應商管理措施
	• 執行供應商評核、稽核	施行供應商評鑑、稽核措施，確保供應商如實履行
	• 辦理供應商輔導與培力	定期辦理供應商宣導會，交流、分享、精進永續措施
策略二：提升 在地採購	• 逐步提高原物料/設備/承攬商、服務商之在地採購比例，落實供應鏈在地化	

力成科技參考相關國際倡議與規範，包含「責任商業聯盟行為準則」、「聯合國工商業與人權指導原則」、「社會責任標準(SA8000)」、「ISO 37001 反賄賂管理系統」及「聯合國世界人權宣言」等訂定《供應商行為準則》，並將此準則列為合作夥伴必須遵守的重要責任；其中，商業道德包含誠信廉潔守則、誠信經營及從業道德、反競爭及反賄賂政策等，亦是合作供應商所須遵循。

#### 2. 供應鏈管理目標

No.	內容	目標	114 年達成狀況
1	新供應商完成賄賂風險暨盡職調查評鑑	100%完成	達成
2	供應商社會責任風險	無違反人權之重大風險 供應商	達成
3	衝突礦產調查作業供應商合格率	100%非衝突礦產廠商	達成
4	舉辦「供應商社會責任宣導會」 供應商參加率	>85%	達成

### 3. 供應商永續管理

篩選與監控措施	內容說明
新供應商評鑑	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對新供應商執行評鑑，包括書面評鑑、工廠評鑑、樣品評鑑</li> <li>候選供應商須簽署「供應商行為準則」</li> <li>完成供應商賄賂風險暨盡職調查程序，落實社會責任及反賄賂、反貪腐</li> <li>符合力成科技評鑑要求者，方可成為合格供應商</li> </ul>
供應商評比	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對主要原物料供應商進行每季／每半年評比，評比項目包括品質、交期、成本及技術等面向</li> <li>供應商評比分數未達標準，要求限期改善，並附上相關佐證資料或安排現場稽核</li> <li>2025 年原物料供應商評比結果，皆達合格供應商分數之標準</li> </ul>
供應商稽核	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對主要原物料供應商依計畫進行年度稽核，項目包括品質系統、綠色產品系統、環境安全衛生系統、RBA 社會責任管理 (含人權、道德) 等四大面向</li> <li>發現缺失即要求供應商提出合適的改善方案，給予明確的目標和改善時間，未改善者則影響採購下單或取消供應商資格</li> </ul>
供應商輔導與訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期辦理現場輔導與 RBA 行為準則、人權等相關訓練，協助供應商共同成長</li> <li>每年舉辦「供應商社會責任宣導會」，宣導品質政策、無有害物質、環境保護、誠信道德及社會責任管理理念</li> <li>直接材料供應商須取得國際驗證，例如 ISO 9001 等品質管理系統，未取得者需提供導入計畫</li> </ul>

### 4. 供應商稽核與發展

本公司篩選出主要原物料供應商，依據品質狀況或製程要求納入評估，並以評估的結果排定稽核計畫。114 年供應商稽核家數共 43 家，包含主要原物料供應商以及勞務供應商，我們從中針對年度稽核排定或高風險的供應商，執行責任商業聯盟行為準則系統與營運持續管理系統的稽核，以便透過稽核管控，避免或降低負面的社會衝擊，總稽核達 80 次，稽核結果皆無高風險廠商。114 年供應商現場稽核發現的不符合事項主要集中於製程管制、職業安全衛生管理、消防安全、作業規範執行落實及產線 6S 管理等類別，我們要求供應商限期改善，經持續追蹤確認，不符合事項已全數完成改善，並未有供應商因稽核列為不合格供應商。根據供應商稽核結果，本公司供應鏈並無具強迫、強制勞動事件以及使用童工之重大風險供應商。

### 5. 舉辦「供應商社會責任宣導」

為建立永續供應鏈及有效傳達 ESG 永續意識，每年舉辦供應商宣導，以中、英文內容提供給國內外供應商，協助供應商共同成長並藉此與供應商維持良好互動關係。2025 年「供應商社會責任宣導」主要議題有從業道德、供應鏈碳管理、RBA 行為準則及供應鏈安全意識等，共有 151 家廠商、188 人數等供應商代表參與，透過供應鏈的溝通與合作，建立綠色永續供應鏈與創造雙贏的共享價值。

## 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

### 《社會面》

#### 1. 提供就業機會

本公司持續提供就業機會，114 年共聘用 3,066 位新進員工，在積極聘用各類人才的同時，亦提供了適合的工作機會給弱勢族群，協助他們找到合適的工作，以減緩經濟壓力，落實回饋社會與創造社會共融之精神，114 年共聘用 177 名弱勢族群，開創 DEI 多元友善職場。

## 2.身心障礙就業

本公司為秉持照顧弱勢族群，持續改善工作環境，使更多弱勢朋友能加入我們的大家庭，114年新聘用43名身心障礙員工，身心障礙員額數為129名，超過法令要求。

年度	111	112	113	114
身心障礙 聘員額	123	111	117	129

## 3.「力成科技教育基金會」公益活動

本公司於106年成立「力成科技教育基金會」，以「偏鄉教育」、「教育扶助」、「運動培育」、「青年培力」四大發展面向，致力推廣科普、環境保護與品德教育，以及關注環境生態與地球保護等議題，用具體的行動積極參與社會公益，與社會共生共榮。114年度社會投資總金額達新台幣3,190,651元，員工志工服務時數達2,208小時，受益人次達1,454人。有關本公司社會參與相關說明，揭露於本公司永續報告書及公司官網。

## 《員工面》

### 1.工作生活平衡計畫

本公司創造多元活潑的職場紓壓環境，並提供優於法令的健康檢查、健檢異常追蹤與管理，以及擁心理諮商與員工協助方案等措施，讓力成員工在工作與生活間達到身心健康。

### 2.育嬰留職停薪政策

本公司配合國家政策，提供完善的育嬰留職停薪方案，鼓勵員工生育。114年力成寶寶誕生數為255人，近4年力成寶寶誕生數共1,239人。

#### ◆ 育嬰留停：

114年度共有149名員工申請過育嬰留停，且申請人不侷限於女性同仁，其中更有21名男性員工申請育嬰留停，比率達14.1%。而生育後選擇回到本公司持續服務的員工高達80%，更有高達82%的復職同仁一年後仍持續在職。

#### ◆ 設置集乳室：

為了照顧身為母親的女性員工，各廠區均設置安全舒適且具隱密的集乳環境，讓哺乳的媽咪們可於需要時安心、放心的使用。

#### ◆ 孕婦專用車位：

我們於各廠區均設置孕婦專用車位，讓孕婦及產後媽媽享有便利及較佳的工作環境，保障孕婦優先停車之權益。

#### ◆ 托兒優惠措施：

福委會透過簽訂特約的方式，與員工居住區域之優良幼兒園、托兒機構協定優惠方案，共計17家，提供員工安排子女學前教育或安親的照料時，除了有多元的機構可選擇外，亦能有實質上的折扣優惠，減輕員工經濟負擔。

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形														
<p>1 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p><b>(1) 董事會</b></p> <p>力成重視股東權益，董事會為經營運作的核心。在推動氣候變遷與永續管理策略上，董事會亦扮演督導與指揮角色，其下設立的永續發展暨風險管理委員會、薪資報酬委員會與審計委員會，協助監督企業永續及氣候變遷相關管理作為，並由各委員會定期向董事會彙報。</p> <table border="1" data-bbox="627 533 1426 819"> <thead> <tr> <th data-bbox="627 533 799 566">組織</th> <th data-bbox="799 533 1426 566">權責</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="627 566 799 678">永續發展暨風險管理委員會</td> <td data-bbox="799 566 1426 678">審議本公司永續發展暨風險管理相關政策、策略及管理方針、監督本公司永續發展暨風險管理相關工作之執行等。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 678 799 745">薪資報酬委員會</td> <td data-bbox="799 678 1426 745">評估個人薪資發放與公司營運績效、ESG 績效結合。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 745 799 819">審計委員會</td> <td data-bbox="799 745 1426 819">督導公司整體營運風險。</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(2) 管理階層</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在推行減碳、環境永續等議題，除了高階主管的支持外，亦需要各單位的加入與合作，力成以永續目標為經度、各跨功能組織為緯度，擘劃出環境永續各面向關注的內容，並提供高階主管、管理階層可一窺全貌，提供有效的支援與協力。</li> <li>- 建置氣候風險辨識與應對程序，「由上而下指揮督導、由下而上應變與回報」，經由 TCFD 推行小組、節能小組的執行，彙報於工安環保委員會及永續發展執行委員會，並進行氣候變遷之衝擊分析與風險辨識，再彙總於永續發展暨風險管理委員會。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="627 1234 1426 1865"> <thead> <tr> <th data-bbox="627 1234 762 1267">組織</th> <th data-bbox="762 1234 1426 1267">權責</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="627 1267 762 1585">永續發展執行委員會</td> <td data-bbox="762 1267 1426 1585"> <p>討論企業永續發展管理事務，由總經理擔任召集人，永續發展管理室擔任執行秘書，協助永續發展政策目標相關業務推動，並針對利害關係人所關切之議題溝通並討論。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ TCFD 推行小組：由永續發展管理室擔任召集人，每年進行 TCFD 氣候相關風險與機會辨識，並彙整年度 TCFD 氣候相關風險與機會辨識結果於「永續發展執行委員會」報告、討論，供經營團隊決策參考。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1585 762 1865">工安環保委員會</td> <td data-bbox="762 1585 1426 1865"> <p>由總經理擔任召集人，負責工安及環保相關事務之研議，以防制職業災害與污染事件之發生、改善作業環境安全與衛生，強化環安衛管理。每季召開一次，討論包含氣候變遷與環境保護議題，如：制定環境、節能績效指標、溫室氣體盤查結果追蹤與改善。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 節能小組：由廠務部擔任召集人，每年進行各廠區節能議題、能源管理之討論與研議，並彙整提供年度節能統計於工安環保委員會報告。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	組織	權責	永續發展暨風險管理委員會	審議本公司永續發展暨風險管理相關政策、策略及管理方針、監督本公司永續發展暨風險管理相關工作之執行等。	薪資報酬委員會	評估個人薪資發放與公司營運績效、ESG 績效結合。	審計委員會	督導公司整體營運風險。	組織	權責	永續發展執行委員會	<p>討論企業永續發展管理事務，由總經理擔任召集人，永續發展管理室擔任執行秘書，協助永續發展政策目標相關業務推動，並針對利害關係人所關切之議題溝通並討論。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ TCFD 推行小組：由永續發展管理室擔任召集人，每年進行 TCFD 氣候相關風險與機會辨識，並彙整年度 TCFD 氣候相關風險與機會辨識結果於「永續發展執行委員會」報告、討論，供經營團隊決策參考。</li> </ul>	工安環保委員會	<p>由總經理擔任召集人，負責工安及環保相關事務之研議，以防制職業災害與污染事件之發生、改善作業環境安全與衛生，強化環安衛管理。每季召開一次，討論包含氣候變遷與環境保護議題，如：制定環境、節能績效指標、溫室氣體盤查結果追蹤與改善。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 節能小組：由廠務部擔任召集人，每年進行各廠區節能議題、能源管理之討論與研議，並彙整提供年度節能統計於工安環保委員會報告。</li> </ul>
組織	權責														
永續發展暨風險管理委員會	審議本公司永續發展暨風險管理相關政策、策略及管理方針、監督本公司永續發展暨風險管理相關工作之執行等。														
薪資報酬委員會	評估個人薪資發放與公司營運績效、ESG 績效結合。														
審計委員會	督導公司整體營運風險。														
組織	權責														
永續發展執行委員會	<p>討論企業永續發展管理事務，由總經理擔任召集人，永續發展管理室擔任執行秘書，協助永續發展政策目標相關業務推動，並針對利害關係人所關切之議題溝通並討論。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ TCFD 推行小組：由永續發展管理室擔任召集人，每年進行 TCFD 氣候相關風險與機會辨識，並彙整年度 TCFD 氣候相關風險與機會辨識結果於「永續發展執行委員會」報告、討論，供經營團隊決策參考。</li> </ul>														
工安環保委員會	<p>由總經理擔任召集人，負責工安及環保相關事務之研議，以防制職業災害與污染事件之發生、改善作業環境安全與衛生，強化環安衛管理。每季召開一次，討論包含氣候變遷與環境保護議題，如：制定環境、節能績效指標、溫室氣體盤查結果追蹤與改善。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 節能小組：由廠務部擔任召集人，每年進行各廠區節能議題、能源管理之討論與研議，並彙整提供年度節能統計於工安環保委員會報告。</li> </ul>														

項目		執行情形
2	敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	氣候變遷風險與機會分析請見 114 年永續報告書「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	氣候變遷財務影響分析請見 114 年永續報告書「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
4	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	風險監控與識別請見 114 年永續報告書「2.3 風險管理」、「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
5	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	氣候相關風險和機會影響力成科技的策略和財務規劃，我們使用定量與定性之氣候相關情境分析以便採取對應策略。力成科技參考 2°C 情境(2DS)、1.5°C 情境及代表濃度途徑情境(RCP) 等於專案會議中進行討論，並依據此情境中對於實體風險、轉型風險、機會來源等，進行氣候變遷風險與機會等議題評估。
6	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>力成科技制定因應氣候變遷衝擊之相關管理指標，包含提升節能效率，節約用電達 1.5%、設置再生能源使用專案，完成廠區屋頂架設太陽能發電設備及購置再生能源憑證，再生能源使用達 5%、執行 ISO 14064 溫室氣體盤查、ISO 14067 產品碳足跡等查證，了解排碳熱點並落實減少碳排放，積極實踐減碳路徑，朝 2050 淨零目標前行。</p> <p>力成科技除了依循客戶及產品特性來制定減碳措施，亦全方位施行環境管理方案，包括規劃各廠區陸續取得「清潔生產評估系統」合格證書、提升資源使用效益與目標，擴大水資源及廢棄物循環再利用，以及投入低碳、環保產品或製程之開發、攜手供應鏈合作低碳轉型專案等等，以實踐 ESG 具體行動與責任生產，為美好的社會與永續環境而努力。</p>
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	評估國際趨勢及法規要求等因素，力成科技內部尚在研議「內部碳定價」管理措施。
8	若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	各項目標及施行進度請見 114 年永續報告書「1.5 永續發展目標實踐」、「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
9	溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。(另填於 1-1 及 1-2)	請參閱 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形及 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

年度	範圍	範疇一		範疇二		範疇三		確信機構	確信準則	確信意見
		總排放量(公噸二氧化碳當量)	密集度(公噸二氧化碳當量/百萬元)	總排放量(公噸二氧化碳當量)	密集度(公噸二氧化碳當量/百萬元)	總排放量(公噸二氧化碳當量)	密集度(公噸二氧化碳當量/百萬元)			
2024	力成科技股份有限公司	7,455.97	0.16	339,416.97	7.17	263,504.04	5.57	SGS	ISO 14064-3	範疇一、範疇二 合理保證，範疇三 有限保證
	超豐電子股份有限公司	1,212.67	0.08	107,550.75	7.07	27,296.90	1.79	TUV NORD	ISO 14064-3	範疇一、範疇二 合理保證，範疇三 有限保證
	得群科技股份有限公司	106.97	0.69	1,497.98	9.65	1,096.77	7.07	-	-	-
	晶兆成科技股份有限公司	1,341.13	0.23	67,444.70	11.66	-	-	工研院	EPA	範疇一、範疇二 合理保證
	Tera Probe,Inc	618.52	0.31	27,110.89	13.40	36,283.70	17.94	BSI Group Japan	ISO 14064-3	Scope 1,2,3 limited Assurance
2025	力成科技股份有限公司	8,057.79	0.16	325,035.49	6.57	468,100.23	9.46	SGS	ISO 14064-3	範疇一、範疇二 合理保證，範疇三 有限保證
	超豐電子股份有限公司	1,562.25	0.09	109,830.81	6.55	44,288.78	2.64	TUV NORD	ISO 14064-3	範疇一、範疇二 合理保證，範疇三 有限保證
	得群科技股份有限公司	110.60	0.61	1,643.81	9.07	946.16	5.22	-	-	-
	晶兆成科技股份有限公司	1,547.11	0.23	69,912.16	10.31	175,404.51	25.88	工研院	EPA	範疇一、範疇二 合理保證
	Tera Probe,Inc	681.49	0.37	26,504.29	14.27	尚未完成盤查	尚未完成盤查	BSI Group Japan	ISO 14064-3	範疇一、二 有限保證，範疇三 尚未完成確信

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

力成科技股份有限公司	
溫室氣體減量基準年	2020 年
溫室氣體減量基準年數據	14,692.19 公噸二氧化碳當量
減碳目標	(1) 每年碳排放量較前一年減少 0.5% (註: 在不增加產能及機台之情況下, 以 2020 為基準年逐年減少 0.5%)。 (2) 設定短期 2025 年減少 5%、中期 2030 年減少 15%, 以及長期 2050 年淨零碳排之目標。
減碳策略	(1) 依循 ISO 50001 能源管理系統, 訂定節能目標及管理措施, 提升用電效率, 如老舊設備替換、優化製程改善、廠區省電照明等。 (2) 透過 E 化平台整合溫室氣體排放資訊, 追蹤溫室氣體排放熱點及減碳目標達成情形。 (3) 建置再生能源使用專案, 逐年提升再生能源使用比例。 (4) 投入潔淨科技、低碳創新技術研發。
具體行動計畫	2025 年節能減碳措施, 以及再生能源使用等執行情形, 請參閱力成科技永續報告書「7.1 氣候變遷與能源管理」章節、氣候相關財務揭露主題報告 (TCFD Report) 等內容。
減碳達成情形	力成台灣廠區落實碳管理策略, 並依溫室氣體相關法規執行自主減量計畫, 降低碳排, 2025 年已達成所設定之減碳目標; 並且相較基準年溫室氣體排放密集度降低達 18.8%(註)。 (註: 排放密集度=(範疇一+範疇二) / 個體營收)

超豐電子股份有限公司&得群科技股份有限公司	
溫室氣體減量基準年	2025 年
溫室氣體減量基準年數據	113,147.47 公噸二氧化碳當量
減量目標	年減 0.5%, 以現況不增加產能及機台。
減量策略	(1) 節電率=當年度需求電力 1%。 (2) 再生能源占總用電量 0.5%。 (3) 廢棄物循環使用。 (4) 減碳目標: 以 2025 年為基準年(範疇一+範疇二)。 短期: 2028 年減量 1.5%。 中期: 2030 年減量 10%。 長期: 2050 年, 達到淨零排放之路徑前行。
具體行動計畫	(1) 自發自用: 2026 年使用再生能源 2,479,694 度。 (2) 2026 年自發自用太陽能電廠(裝置容量 5.8MW), 預計 2026 年供應 880,000 度。 (3) 2026 年下腳料平均回收 50 萬噸, 其他回收平均 700 萬噸。 (4) 2026 年製程廢水回收率 30% 以上。 (5) 2026 年汰換 2 台 450RT 磁浮式冰水主機。 (6) 2026 年汰換 1 台乾燥機。
減量目標達成情形	不適用。

Tera Probe, Inc & 晶兆成科技股份有限公司	
溫室氣體減量基準年	2022 年
溫室氣體減量基準年數據	範疇一: 662.52 公噸二氧化碳當量 範疇二(Location-based): 25,334.94 公噸二氧化碳當量 範疇二(Market-based): 24,236.69 公噸二氧化碳當量 範疇三: 23,633.82 公噸二氧化碳當量
減量目標	(1) 範疇一+二: 到 2030 年將絕對溫室氣體排放量減少 42%(基準年: 2022 年)。 (2) 範疇三: 到 2030 年將絕對溫室氣體排放量減少 25%(基準年: 2022 年)。
減量策略	(1) 計畫性汰換生產設施。 (2) 將生產設備升級為效率較高之生產設備。 (3) 改使用節能的設施系統。 (4) 採購再生能源。 (5) 安裝太陽能發電系統。
具體行動計畫	(1) 汰換低效能之生產設施。 (2) 使用高效率生產設備。 (3) 採購再生能源。 (4) 建設太陽能發電設施。 (5) 於公司網站公開揭露溫室氣體盤查結果, 展現資訊透明度。
減量目標達成情形	(1) 範疇一+範疇二(Location-based): 排放量從 2022 年的 25,997.46 公噸二氧化碳當量增加到 2025 年的 27,185.77 公噸二氧化碳當量。 然而, 在範疇一+範疇二(Market-based)下, 數字從 2022 年的 24,899.21 公噸二氧化碳當量增加到 2025 年的 29,406.91 公噸二氧化碳當量, 扣除非化石燃料憑證後, 降至 24,824.41 公噸二氧化碳當量, 回到 2022 年的水平。 (2) 範疇三: 2022 年的排放量為 23,633.82 公噸二氧化碳當量, 2025 年為 25,166.19 公噸二氧化碳當量。 雖然比 2022 年增長了 6%, 但與 2024 年記錄的 36,283.70 公噸二氧化碳當量相比, 這是一個顯著的下降, 顯示出我們在減排努力方面取得了進展。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	✓		<p>(一)本公司為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，並基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關施行細則訂定本公司「誠信經營及從業道德守則」，經董事會於中華民國102年4月30日決議通過後實施，於104年2月9日經董事會決議通過第一次修訂，於107年11月2日經董事會決議通過第二次修訂、109年3月10日經董事會決議通過第三次修訂、111年3月10日經董事會決議通過第四次修訂，並於111年11月4日經董事會決議通過第五次修訂。</p>	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
<p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	✓		<p>(二)本公司「誠信經營及從業道德守則」中建立定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，並針對下列各類型行為制定行為指南、檢舉制度、不誠信之行為處置、獎懲及申訴制度，且落實執行：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 禁止提供或收受不當利益</li> <li>2. 禁止與處理疏通費之程序</li> <li>3. 利益衝突迴避</li> <li>4. 政治獻金、慈善捐贈或贊助辦理程序</li> <li>5. 建立商業關係程序</li> <li>6. 揭露公司誠信經營政策</li> <li>7. 禁止從事內線交易</li> <li>8. 禁止洩露機密資訊</li> <li>9. 禁止侵害智慧財產權</li> <li>10. 禁止從事不公平競爭之行為</li> <li>11. 防範產品或服務損害利害關係人</li> <li>12. 檢舉制度、不誠信之行為處置、獎懲及申訴制度</li> </ol>	
<p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	✓		<p>(三)請參考本表下方說明一。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)請參考本表下方說明二。	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)本公司為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，於103年8月1日設置「企業社會責任室」為專職單位，於104年2月9日經董事會通過，隸屬於董事會，該組織於111年3月10日經董事會通過，更名為「永續發展管理室」，負責本公司誠信經營政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年定期(至少一年一次)向董事會報告。(114年11月7日召開第十屆第14次董事會，議案：本公司113年度推動誠信經營、反賄賂管理計畫及其執行情形報告)	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)本公司依據「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司新進人員皆會簽署《聘僱合約書》，合約書內容表明員工應遵守利益規避，且自104年起，每位員工每年須簽署《利益衝突迴避同意書》；本公司自105年起，亦將遵循誠信經營制度的線上課程與年度績效考核連結，以徹底落實執行本公司誠信經營及從業道德政策。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本公司業已建立完備之會計制度及內控機制，並由內部稽核單位依年度稽核計劃執行相關查核，並作成稽核報告提報審計委員會及董事會，必要時亦得委任會計師執行查核。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)請參考本表下方說明三。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司提供暢通溝通管道與多元化申訴機制，除於同仁手冊之服務準則中宣達遵循誠信原則之規範讓同仁遵守，亦設置「員工溝通管道作業規範」，以實踐多元暢通的雙向溝通環境，以及「獎懲管理辦法」可供施行及運作，並有專責人員負責受理檢舉案件，確保檢舉者身份的機密性和匿名性及防止報復，且指派適當人員處理及回覆檢舉案件。	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)請參考本表下方說明四。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司對於檢舉人之身分均嚴格保密保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當之處置，確保檢舉者身份的機密性和匿名性及防止報復。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一)本公司「誠信經營及從業道德守則」內容及推動成效，皆揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司定期檢討並改進公司所建置之誠信經營政策，於111年3月10日經董事會決議通過「誠信經營及從業道德守則」第四次修訂，以提升履行成效；並決議通過本公司「永續發展管理室」為專責單位，隸屬於董事會，負責誠信經營政策與防範方案之修訂及監督執行，每年定期向董事會報告。				

說明：一、本公司對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款具較高不誠信行為風險之營業活動（行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益），採行下列防範措施：

- 1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 2.定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 3.規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 4.舉辦公司誠信政策教育訓練與宣導，使員工充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。
- 5.規劃檢舉制度及訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序及確保執行之有效性。
- 6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

7. 建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

8. 110 年導入「ISO 37001 反賄賂管理系統」並通過驗證稽核取得證書，且每年定期執行「ISO 37001 反賄賂管理系統」之內、外部稽核，持續提升人員之誠信經營意識與強化公司治理。

二、依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司與供應商建立商業關係前，須先行評估商業往來交易對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，避免與涉有不誠信行為者進行交易。本公司於評估商業往來交易對象時，須採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

1. 該供應商之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
2. 該供應商是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
3. 該供應商營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
4. 該供應商所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
5. 該供應商長期經營狀況及商譽。
6. 諮詢其供應商夥伴對該供應商之意見。
7. 該供應商是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

本公司人員於從事商業行為過程中，須向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

本公司與他人簽訂契約時，須充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中得明訂下列事項：

- (1) 任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償。
- (2) 任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。
- (3) 訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

三、本公司除指派相關人員參加外部誠信經營相關訓練之外，公司內部每年定期舉辦誠信經營相關教育訓練課程。114 年誠信經營教育訓練成果如下：

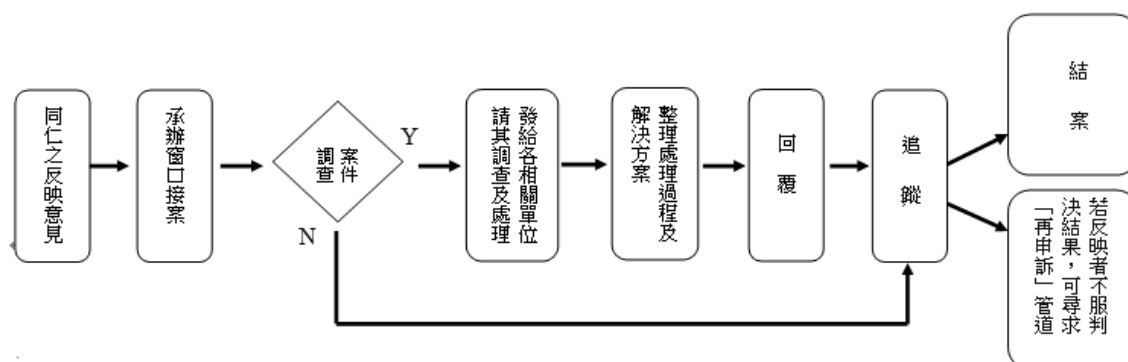
1. 114 年度內部訓練

114 年法令課程				
No.	課程名稱	時數	人次	總時數
1	TIPS 智財管理制度教育訓練	1.00	4,075	4,075.0
2	個人資料保護及管理	1.00	12,285	12,285.0
3	能源管理及節約能源認知訓練	1.00	12,285	12,285.0
4	新進員工一般教育訓練(公司資訊保密規定)	0.45	2,610	1,174.5
5	誠信經營與從業道德	1.00	12,285	12,285.0
6	資安訓練-釣魚郵件加強訓練	1.00	43	43.0
7	資訊安全教育訓練	1.00	22,243	22,243.0
8	營業秘密保護及管理	1.00	12,302	12,302.0
9	職場性騷擾防治	1.00	12,285	12,285.0
10	一般安全衛生在職訓練	1.00	11,231	11,231.0
11	危害性化學品通識訓練	1.00	12,285	12,285.0
合計		-	113,929	112,493.5

2. 114 年度供應商與承攬商訓練

- ◆ 執行 114 年「供應商社會責任宣導」，共有 151 家廠商、188 人次參與；議程內容涵蓋誠信經營與反賄賂。
- ◆ 所有承攬商、駐廠廠商等入廠前都會完成入廠須知相關訓練，包含誠信經營與反賄賂。

四、本公司訂定受理檢舉事項之調查標準及作業程序如下：



(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議事項及執行情形

日期	股東會	重要決議事項
114.5.28	股東常會	1.通過承認 113 年度營業報告書及財務報表。 2.通過承認 113 年度盈餘分配案。 執行情形：訂定 114 年 8 月 6 日為分配基準日，114 年 9 月 5 日為發放日(每股配發現金股利 7.0 元)，已如期發放完畢。 3.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案。 執行情形：該私募案即將屆滿一年，且尚未找到適合之策略性投資人，經本公司 115 年 3 月 11 日第十屆第 17 次董事會決議，不繼續辦理該私募案，並將提 115 年股東會報告。 4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.董事會重要決議事項

日期	董事會	重要決議事項
114.2.21	第十屆第 10 次	1. 通過 114 年營業計畫案。 2. 通過 113 年度營業報告書及財務報告。 3. 通過 113 年度盈餘分配案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案、暨增訂「員工酬勞分派原則管理辦法」。 5. 通過分配 113 年度董事酬勞及員工酬勞案。 6. 通過經理人薪資調整案。

日期	董事會	重要決議事項
		7. 通過經理人職務晉升案。 8. 通過本公司 113 年度內部控制制度有效性考核暨出具 113 年度內部控制制度聲明書案。 9. 通過內部稽核主管任命案。 10. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 11. 通過修訂本公司「員工持股會章程」部分條文案。 12. 通過評估聘僱會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。 13. 通過向金融機構申請授信額度案。 14. 通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。 15. 通過不繼續辦理本公司 113 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案」。 16. 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。 17. 通過 114 年度股東常會召集案。
114.5.9	第十屆第 11 次	1. 通過 114 年第 1 季財務報告。 2. 通過經理人解任案。 3. 通過能源專案公司投資案。
114.6.27	第十屆第 12 次	1. 通過訂定本公司 113 年度盈餘分配之配息基準日案。 2. 通過新委任經理人案。 3. 通過經理人職務晉升案。 4. 通過經理人職稱調整案。
114.8.8	第十屆第 13 次	1. 通過 114 年第 2 季財務報告。 2. 通過本公司 113 年度企業永續報告書編制內容。 3. 通過制訂本公司之「生物多樣性暨不毀林政策」。 4. 通過向金融機構申請授信額度案。 5. 通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
114.11.7	第十屆第 14 次	1. 通過 114 年第 3 季財務報告。 2. 通過將「風險管理委員會」更名為「永續發展暨風險管理委員會」，暨修訂「永續發展暨風險管理委員會組織規程」。 3. 通過本公司「經理人薪資報酬與績效評估辦法」。 4. 通過修訂「企業永續發展實務守則」及「永續資訊之管理作業辦法」。 5. 通過修訂「內部重大資訊處理及防範內線交易管理作業程序」。 6. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 8. 通過本公司 115 年度內部稽核計劃。 9. 通過經理人退休案。 10. 通過新委任經理人薪酬案。

日期	董事會	重要決議事項
114.11.14	第十屆第 15 次	1. 通過本公司取得不動產案。
115.1.9	第十屆第 16 次	1. 通過本公司參與廠房標售案。
115.3.11	第十屆第 17 次	1. 通過 115 年營業計畫案。 2. 通過 114 年度營業報告書及財務報告。 3. 通過 114 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 115 年「基層員工」之薪資範圍。 5. 通過分配 114 年度董事酬勞及員工酬勞案。 6. 通過 115 年經理人薪資調整案。 7. 通過本公司 114 年度內部控制制度有效性考核暨出具 114 年度內部控制制度聲明書案。 8. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 9. 通過修訂本公司「子公司監理辦法」。 10. 通過變更委任會計師、其獨立性及適任性評估暨審計公費案。 11. 通過向金融機構申請授信額度案。 12. 通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。 13. 通過不繼續辦理本公司 114 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案」。 14. 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。 15. 通過董事全面改選案。 16. 通過新任董事競業禁止限制之解除案。 17. 通過 115 年度股東常會召集案。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。

#### 四、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計之金額及非審計服務內容：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	林政治 方蘇立	114.01.01~ 114.12.31	12,090	972	13,062	非審計公費內容： 1. 移轉訂價報告 350 仟元 2. 審計及稅簽相關代墊費 352 仟元 3. 營業稅直扣法申報 170 仟元 4. XRBL 申報檔 60 仟元 5. 人力資源 40 仟元

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

#### 五、更換會計師資訊：

##### (一)關於前任會計師

更換日期	民國一一五年三月十一日		
更換原因及說明	事務所內部業務調動		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況 \ 當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	—	會計原則或實務
		—	財務報告之揭露
		—	查核範圍或步驟
		—	其他
	無	√	
說明	—		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

##### (二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	鍾鳴遠會計師、方蘇立會計師(註)
委任之日期	民國一一五年三月十一日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

註：本公司簽證會計師原為勤業眾信聯合會計師事務所林政治及方蘇立會計師，因事務所內部業務調度，變更為鍾鳴遠及方蘇立會計師。

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	114 年度		截至當年度3月31日止	
		持 有 股 數 增 ( 減 ) 數	質 押 股 數 增 ( 減 ) 數	持 有 股 數 增 ( 減 ) 數	質 押 股 數 增 ( 減 ) 數
董事長	蔡篤恭	0	—	0	—
董 事	美商金士頓科技股份有限公司 投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男、吳麗卿	0	—	0	—
董 事	超豐電子(股)公司 代表人：謝永達	7,350,000	—	0	—
董 事	台灣鎧俠先進半導體(股)公司 代表人：淺田順一	0	—	0	—
獨立董事	張光瑤	0	—	0	—
獨立董事	李培瑛	0	—	0	—
獨立董事	陳瑞聰	0	—	0	—
獨立董事	童兆勤	0	—	0	—
執行長	謝永達	0	—	0	—
董事暨總經理	呂肇祥	0	—	0	—
經理人	巫勤達	0	—	0	—
經理人	吳文維	0	—	0	—
經理人	林基正	0	—	0	—
經理人	林賢鳳	0	—	0	—
經理人	林宥翰	0	—	(25,000)	—
經理人	徐宏欣	0	—	0	—
經理人	許瑞益(註1)	0	—	0	—
經理人	林國鼎(註1)	0	—	0	—
經理人	徐坤基(註2)	0	—	0	—
經理人	董定鑫	0	—	0	—
財務長暨 公司治理主管	沈俊宏	0	—	0	—
會計主管	紅立勝	0	—	0	—
前經理人	陳世恭(註3)	0	—	0	—
前經理人	喬廣文(註3)	0	—	0	—
前經理人	陳玉欽(註3)	0	—	0	—

註1：許瑞益先生與林國鼎先生於114年7月1日獲擢升為副總經理，其持有股數揭露自就任日起。

註2：徐坤基先生於115年2月1日獲擢升為副總經理，其持有股數揭露自就任日起。

註3：陳世恭先生於114年5月16日離職；喬廣文先生於115年1月5日退休；陳玉欽先生於115年1月31日退休，其持有股數揭露至離職日或退休日止。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115年3月29日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
群益台灣精選高息ETF基金專戶	42,144,000	5.55%	—	—	—	—	無	—	—
元大台灣高股息基金專戶	36,289,912	4.78%	—	—	—	—	無	—	—
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶	29,875,000	3.94%	—	—	—	—	美商 KTC-SUN 公司	該公司之代表人與該股東之副總裁為同一人	—
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	25,827,000	3.40%	—	—	—	—	無	—	—
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：熊明河	24,643,000 0	3.25% 0.00%	—	—	—	—	無	—	—
新制勞工退休基金	21,590,690	2.84%	—	—	—	—	無	—	—
超豐電子股份有限公司 代表人：謝永達	20,350,000 18,000	2.68% 0.00%	—	—	—	—	無	—	—
美商摩根大通受託保管JP 摩根證券投資專戶	14,236,171	1.88%	—	—	—	—	無	—	—
美商 KTC-SUN 公司 代表人：孫大衛 (David Sun)	13,765,362 0	1.81% 0.00%	—	—	—	—	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶	該公司之副總裁與該股東之代表人為同一人	—
匯豐銀行託管荷蘭合作銀行倫敦分行投資	10,923,000	1.44%	—	—	—	—	無	—	—

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
晶兆成科技(股)公司	73,385,830	49%	76,381,170	51%	149,767,000	100.00%
Powertech Holding (BVI) Inc.	50,000	100%	0	0%	50,000	100.00%
超豐電子(股)公司	244,064,379	42.91%	0	0%	244,064,379	42.91%
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	69,000,000	100%	0	0%	69,000,000	100.00%
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	102,995	100%	0	0%	102,995	100%
力成科技日本合同會社	註2	100%	0	0%	註2	100.00%
得群科技(股)公司	—	—	7,796,498	97.46%	7,796,498	97.46%

註1：係公司採權益法之投資。

註2：非屬股份有限公司，無持股數。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1.股本形成經過

年 月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
86/5	10	200,000	2,000,000	60,000.0	600,000	創立、現金增資 600,000 仟元	無	無
87/4	12	200,000	2,000,000	120,000.0	1,200,000	現金增資 600,000 仟元	無	註 1
88/5	11	200,000	2,000,000	200,000.0	2,000,000	現金增資 800,000 仟元	無	註 2
90/8	10	280,000	2,800,000	221,800.0	2,218,000	盈餘、資本公積轉增資 218,000 仟元	無	註 3
91/9	10	280,000	2,800,000	235,222.9	2,352,229	盈餘轉增資 134,229 仟元	無	註 4
91/9	11.5	280,000	2,800,000	246,312.9	2,463,129	現金增資 110,900 仟元	無	註 5
92/9	10	280,000	2,800,000	261,250.0	2,612,500	盈餘轉增資 149,371 仟元	無	註 6
93/9	10	440,000	4,400,000	308,000.0	3,080,000	盈餘轉增資 467,500 仟元	無	註 7
93/9	43	440,000	4,400,000	338,000.0	3,380,000	現金增資 300,000 仟元	無	註 8
94/6	10	580,000	5,800,000	400,500.0	4,005,000	盈餘轉增資 625,000 仟元	無	註 9
95/6	10	580,000	5,800,000	471,000.0	4,710,000	盈餘轉增資 705,000 仟元	無	註 10
96/6	10	580,000	5,800,000	556,300.0	5,563,000	盈餘轉增資 853,000 仟元	無	註 11
97/6	10	750,000	7,500,000	630,800.0	6,308,000	盈餘轉增資 745,000 仟元	無	註 12
98/7	10	750,000	7,500,000	669,385.2	6,693,852	盈餘轉增資 385,852 仟元	無	註 13
99/5	60.6	750,000	7,500,000	704,236.7	7,042,367	私募可轉換公司債轉換為普通股 348,515 仟元	無	註 14
99/9	58.4	750,000	7,500,000	715,366.8	7,153,668	私募可轉換公司債轉換為普通股 111,301 仟元	無	註 15
99/12	58.4	750,000	7,500,000	726,496.9	7,264,969	私募可轉換公司債轉換為普通股 111,301 仟元	無	註 16
100/8	10	1,000,000	10,000,000	799,146.6	7,991,466	盈餘轉增資 726,497 仟元	無	註 17
101/8	10	1,000,000	10,000,000	779,146.6	7,791,466	註銷庫藏股減資 200,000 仟元	無	註 18
111/4	10	1,000,000	10,000,000	759,146.6	7,591,466	註銷庫藏股減資 200,000 仟元	無	註 19

註 1：87.02.17(87)台財證(一)第 18910 號函

註 2：88.03.02(88)台財證(一)第 22357 號函

註 3：90.06.21(90)台財證(一)第 139798 號函

註 4：91.07.10(91)台財證(一)第 0910137911 號函

註 5：91.07.10(91)台財證(一)第 0910137913 號函

註 6：92.07.08(92)台財證(一)第 0920130303 號函

註 7：93.06.25(93)台財證(一)第 0930128233 號函

註 8：93.07.06(93)證期一字第 0930128234 號函

註 9：94.06.24 金管證一字第 0940125391 號函

註 10：95.06.27 金管證一字第 0950126720 號函

註 11：96.06.28 金管證一字第 0960032903 號函

註 12：97.06.25 金管證一字第 0970031487 號函

註 13：98.07.02 金管證一字第 0980032960 號函

註 14：99.05.05 經授商字第 09901091340 號函

註 15：99.09.21 經授商字第 09901214270 號函

註 16：99.12.31 經授商字第 09901291530 號函

註 17：100.8.11 經授商字第 10001183300 號函

註 18：101.8.27 經授商字第 10101177670 號函

註 19：111.4.15 經授商字第 11101050150 號函

##### 2.股份種類

單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名普通股	759,146,634	240,853,366	1,000,000,000	上市公司股票

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

115年3月29日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
群益台灣精選高息 E T F 基金專戶		42,144,000	5.55%
元大台灣高股息基金專戶		36,289,912	4.78%
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶		29,875,000	3.94%
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶		25,827,000	3.40%
國泰人壽保險股份有限公司		24,643,000	3.25%
新制勞工退休基金		21,590,690	2.84%
超豐電子股份有限公司		20,350,000	2.68%
美商摩根大通受託保管 J P 摩根證券投資專戶		14,236,171	1.88%
美商 KTC-SUN 公司		13,765,362	1.81%
匯豐銀行託管荷蘭合作銀行倫敦分行投資		10,923,000	1.44%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司章程第 21 條之 1 第 3 項規定，本公司屬資本密集之產業，股利政策須考量公司目前及未來之投資環境、資金需求、市場競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，本公司股東紅利之發放分為現金股利及股票股利，其中現金股利以不低於股利總額之 20%。

本公司為維持穩定且可持續性的股利政策，係依據近年度實際營運狀況、考量投資機會及資金需求規劃而擬定股東股利。

2.股利政策之執行狀況說明如下：

(1)本公司於民國 92 年至 99 年間處於營運成長期，此期間各年度皆由前一年度所產生之保留盈餘中提撥約 50% 分派股東股利，而分派之股利中，現金股利約佔 80%，股票股利則約佔 20%。

(2)自民國 100 年起，本公司開始進入獲利穩定期，此期間各年度皆由前一年度所產生之保留盈餘中提撥約 60% 分派股東股利，而分派之股利中，100% 以現金股利發放。期間雖然於 102 年度因權利金和解賠償而導致虧損外，本公司仍以資本公積配發的方式，每股發放現金 2 元。

(3)本公司為延續民國 100 年後之股利政策，於 115 年 3 月 11 日經第十屆第 17 次董事會決議擬每股發放現金股利 4.5 元，預計發放金額合計約佔 114 年度所產生保留盈餘之 62%，尚符合現階段本公司之股利政策。倘若未來本公司之營運狀況未發生重大變化時，亦將延續目前之股利政策。

3.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 115 年度擬自 114 年度盈餘中分派現金股利計新台幣 3,416,159,853 元，依目前流通在外股數每股發放現金股利 4.5 元，實際股利分配情形將待 115 年股東會決議後執行之。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會擬議分派 114 年度之盈餘，未有無償配股之情形。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司之公司章程中，有關員工及董事酬勞之分派原則規定如下：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 5%~7.5% 為員工酬勞及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，且應將年度可分派總金額中，不低於 60% 分派為基層員工之酬勞。董事酬勞僅得以現金為之。本公司獨立董事按月支領報酬，不參與年度董事酬勞分配。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

114 年度員工及董事酬勞金額之估列基礎，係依上述公司章程之規定予以估列，若實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列入實際分派年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司於民國 115 年 3 月 11 日經第十屆第 17 次董事會決議，通過分派 114 年度之員工及董事酬勞如下：

(1) 員工酬勞新台幣 373,677,867 元及董事酬勞新台幣 74,735,573 元，分別佔年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利的 5.79% 及 1.16%，均以現金方式發放。上述金額與 114 年財報帳列數比較並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期並無以股票分派員工酬勞之情形，故不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

本公司於 114 年 5 月 28 日股東常會通過 113 年度盈餘分配案中，有關員工及董事酬勞之分派情形如下：

	金額(元)
員工酬勞—以現金方式發放	\$ 458,230,949
董事酬勞—以現金方式發放	91,646,190
合計	\$ 549,877,139

上述實際分派情形與原董事會決議相較並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：

自 95 年起，本公司部分已發行之股票以存託憑證(每單位存託憑證表彰母公司普通股 2 股)方式於盧森堡交易所上市，上述海外存託憑證持有人享有與本公司普通股股東相同之權利義務。為降低相關管理成本，本公司於 113 年 11 月 8 日經董事會決議，終止本公司於盧森堡交易所掛牌發行之海外存託憑證，並已於 113 年 12 月 16 日完成下市流程，截止下市日 113 年 12 月 16 日，流通在外海外存託憑證為 22 單位，前述海外存託憑證持有人於 114 年 6 月 15 日前，仍可向存託機構請求兌回。截至 114 年底已無流通在外單位。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

七、資金運用計畫執行情形：

本公司截至 115 年 3 月 31 日止，尚無前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情形。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.所營業務之主要內容：

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (3) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (4) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- (5) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (6) F119010 電子材料批發業。
- (7) F219010 電子材料零售業。
- (8) H201010 一般投資業。
- (9) I301010 資訊軟體服務業。
- (10) I501010 產品設計業。
- (11) JE01010 租賃業。

##### 2.營業比重：

本公司成立於民國 86 年 5 月，以積體電路 IC 封裝測試業務為主，114 年度合併營業比重如下：

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度營收淨額	營業比重
IC 封裝服務	46,273,182	61.76%
IC 測試服務	10,454,821	13.95%
模組加工服務	8,066,923	10.77%
晶圓級封裝服務	3,926,687	5.24%
晶圓級測試服務	6,183,959	8.25%
其他	23,748	0.03%
合 計	74,929,320	100.00%

##### 3.目前之商品(服務)項目：

- (1) 高腳數超薄小型晶粒承載積體電路(TSOP)封裝及測試服務。
- (2) 四邊扁平無腳封裝(QFN)封裝服務。
- (3) 多晶片(堆疊)封裝(MCP、S-MCP)封裝及測試服務。
- (4) 球型陣列承載積體電路(wBGA、FBGA)封裝及測試服務。
- (5) 記憶卡(SD、microSD)、USB 封裝及測試服務。
- (6) 固態硬碟(SSD)、內嵌式記憶體(eMMC、eMCP、UFS) 封裝及測試服務。
- (7) DRAM 晶片堆疊封裝及測試服務。
- (8) 行動記憶體封裝及測試服務。
- (9) 晶圓級晶片測試服務。
- (10) 晶圓凸塊(Bumping)服務。
- (11) 系統級封裝(SiP)服務。
- (12) 重佈線(RDL)服務。
- (13) 晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服務。

- (14) 封裝體堆疊(PoP、PiP)封裝及測試服務。
- (15) 封裝體堆疊(Package on Package)應用銅核心錫球等新製程與材料。
- (16) CIS 影像感測器封裝及測試服務。
- (17) 覆晶封裝(Flipchip)服務。
- (18) 大尺寸(>100mm x100mm) FCBGA。
- (19) 客製化 CPO (SiPh chip + SoC) on FCBGA 封裝。
- (20) 高散熱金屬導電膠應用於大尺寸 FCBGA 與 FCLGA。
- (21) 覆晶封裝結合超細線寬與間距重佈線製程(RDL)的 FOPLP 技術，提供高密度異質晶片封裝產品於高速網路與伺服器等應用領域。
- (22) 銅柱凸塊覆晶(Cu Pillar Bump Flip Chip)封裝服務。
- (23) EMI shield package 封裝服務。
- (24) 面板級扇外型 (Panel level Fan-Out)封裝及測試服務。
- (25) 模組(Module)與系統(System)封裝服務。
- (26) 高速 SCM (Storage Class Memory) 測試服務與硬體開發。
- (27) 車用電源模組測試服務。
- (28) PCIe 介面測試服務。
- (29) 大容量固態硬碟(High Density SSD up to 122TB): SFF / EDSFF。

#### 4. 計劃開發之新商品(服務)：

- (1) 大尺寸(>70mm x 70mm) MCM FCBGA (logic + memory)，用於汽車應用。
- (2) 先進節點晶圓應用於車用 Package 封裝。
- (3) BT+ABF 基板，應用於AI，HP與汽車等的 FCBGA。
- (4) PiFO® (Pillars in Fan-Out) with embedded bridge Fan-out on Substrate 封裝以滿足 Server, Data Center, CPO 等大尺寸封裝需求。
- (5) Fan-out 嵌入小晶片，以整合邏輯晶片或系統單晶片(SoC)與高頻寬記憶體，滿足雲端人工智能(Cloud AI)與邊緣運算(Edge Computing)之應用。
- (6) 覆晶封裝結合重佈線路技術之 Chip Last Fan-out 結構。
- (7) 晶片嵌入式製程技術(Pillars in Fan-Out, PiFO®)，提供智慧型手機、穿戴式裝置應用需求。
- (8) 應用矽穿孔(TSV)技術於高頻大容量記憶體封裝，運用在人工智慧元件(AI)等產品。
- (9) 8顆 NAND 記憶體晶片+Controller 搭配 FOPLP 扇外型面板級封裝堆疊技術，提供超薄型、高密度與高速之行動通訊應用需求。
- (10) NAND記憶體晶片搭配微控制晶片的高散熱記憶體晶片模組技術，提供超薄型、大容量、高散熱與高速之雲端儲存應用需求。
- (11) 整合矽穿孔及微凸塊之高頻寬記憶體堆疊晶片及嵌埋橋接晶片扇外型堆疊封裝，提供高頻寬、高記憶體密度、高效能運算及高速網路連結之應用。
- (12) 8顆NAND快閃記憶體晶片，搭配8顆LPDRAM內存記憶體晶片，微控制器，與6顆矽中介層之封裝堆疊技術，提供高記憶體密度、高效能、薄型封裝於行動通訊上之應用。
- (13) 3D-FOPoP結構，提供高密度、高電氣特性，及尺寸微縮之封裝解決方案。
- (14) 超小晶片尺寸，與超大晶片尺寸 CIS CSP 封裝，以滿足不同應用領域的需求。
- (15) Via middle TSV DRAM FCCSP 取代傳統 W/B BGA for Data center 應用。
- (16) 應用 Via middle TSV 技術 for Optical Engine 之 CPO 應用
- (17) 高速 3D-NAND 測試服務與硬體開發 (>3.2Gbps)。
- (18) Tester IO board 硬體開發。
- (19) High pin count O/S 測試機開發。
- (20) HBM 測試開發。
- (21) Chip-on-Wafer-on-Substrate測試開發。
- (22) CIS測試開發。

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展

2025 年全球半導體產業經歷了從「願景」轉向「實質營收」的關鍵年度。

#### (1) AI 基礎建設的發展：

2025 年是雲端服務供應商(CSP)擴張資料中心的發展期，對 AI 加速器、高性能運算(HPC)晶片的需求也持續升高，直接帶動了臺灣晶圓代工與先進封裝產能的高利用率。

#### (2) 庫存結構完全優化：

經過 2024 年的庫存去化，2025 年消費性電子(如 AI PC 與 AI 手機)雖然成長溫和，但因晶片單價(ASP)提升，整體產值仍顯著回升。

#### (3) 供應鏈多元化佈局：

臺灣業者在 2025 年成功推進了海外產能(如日、美、德)的初期量產與驗證，強化了供應鏈韌性，抵禦了地緣政治帶來的不確定性。依據國際貨幣基金(IMF)資料顯示，2025 年全球經濟成長率約 3.3%。

展望 2026 年，全球經濟可能呈現溫和復甦的態勢，但仍面臨通膨、地緣政治風險及美國關稅增加等不確定因素。依 IMF 提出的報告預測顯示，預期 2026 年全球經濟成長率將和 2025 年相仿，維持 3.3%。

就半導體產業而言，隨著庫存去化、AI 應用需求增加，半導體市場預計將重回成長軌道。依據世界半導體貿易統計協會(WSTS)公布的 2025 年市場規模達到 7,720 億美元。相較 2024 年成長 22.5%。2026 年，市場預計將延續成長趨勢，WSTS 預計市場規模將達到 9,750 億美元，年增率為 26.3%。

台灣半導體產業的表現，在全球平均值之上。根據工研院產科國際所 2025 年第四季報告：預估 2025 年臺灣 IC 產業產值達新臺幣 6 兆 5,225 億元，較 2024 年成長 22.7%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 1 兆 4,245 億元，較 2024 年成長 12.0%；IC 製造業為新臺幣 4 兆 3,869 億元，較 2024 年成長 28.3%，其中晶圓代工為新臺幣 4 兆 1,693 億元，較 2024 年成長 28.5%，記憶體與其他製造約為新臺幣 2,176 億元，較 2024 年成長 23.8%；IC 封裝業為新臺幣 4,825 億元，較 2024 年成長 14.0%；IC 測試業為新臺幣 2,286 億元，較 2024 年成長 14.2%。新臺幣對美元匯率以 32.1 計算。

長期來看，半導體產業依然將持續成長。半導體的廣大應用，人工智慧、雲端伺服器、邊緣運算、智慧型手機、電腦、AR/VR、5G、電動車與自駕車、IoT 及電子醫療等應用推陳出新，呈現百花齊放的蓬勃面貌。

2022年~2026年台灣IC產業產值

億新台幣	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025	2025 成長率	2026 (e)	2026 (e) 成長率
IC 產業產值	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	65,225	22.7%	77,150	18.3%
IC 設計業	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,245	12.0%	15,214	6.8%
IC 製造業	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	43,869	28.3%	54,339	23.9%
晶圓代工	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	41,693	28.5%	51,317	23.1%
記憶體與其他製造	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	2,176	23.8%	3,022	38.9%
IC 封裝業	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,825	14.0%	5,163	7.0%
IC 測試業	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,286	14.2%	2,434	6.5%
IC 產品產值	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,421	13.4%	18,236	11.1%

資料來源：工研院產科國際所

說明：

(e)表示預估值(estimate)。

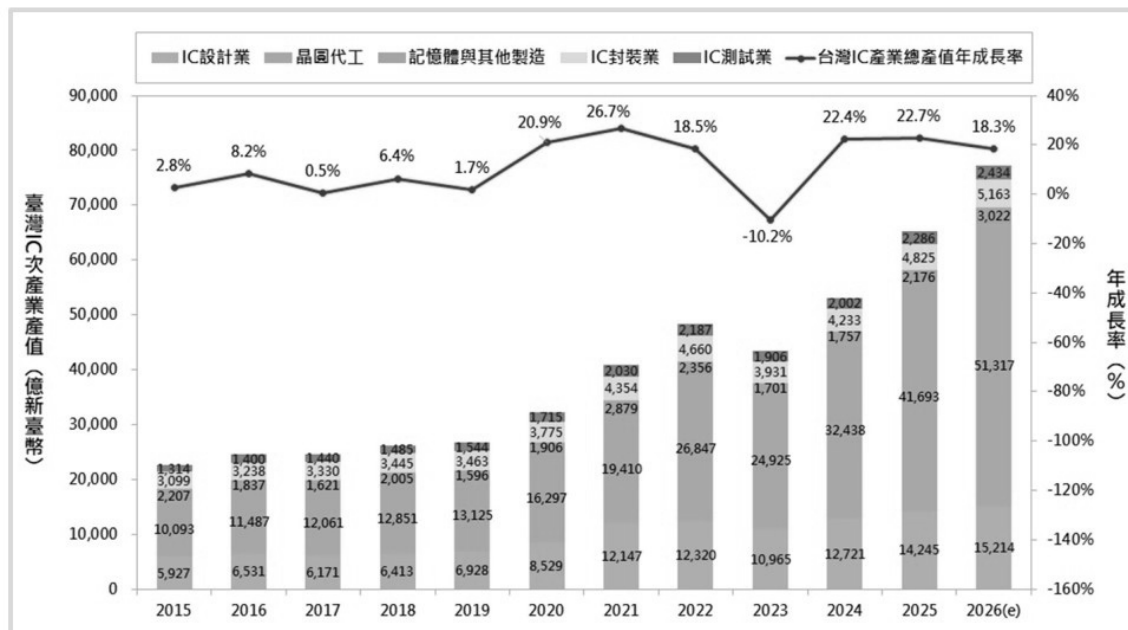
IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業。

IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造。

IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。

上述產值計算是以總部設立在臺灣的公司為基準。

## 台灣半導體各次產業產值



資料來源：工研院產科國際所

### 2. 產業上、中、下游之關聯性

半導體產業，可區分為上游的晶片設計，中游的晶圓製造，及下游的晶片封裝及測試。

#### (1) 晶片設計：

晶片設計屬於知識密集產業，此行業具有高進入障礙的特色，隨著高效能，多功能的電子產品需求，以及 5G、AI、IoT、汽車電子、工業與消費性產品的應用多元化，晶片設計產業百花齊放，是半導體供應鏈內重要的一環。晶片設計公司概分為自行設計產品銷售，或接受客戶委託設計兩大類。

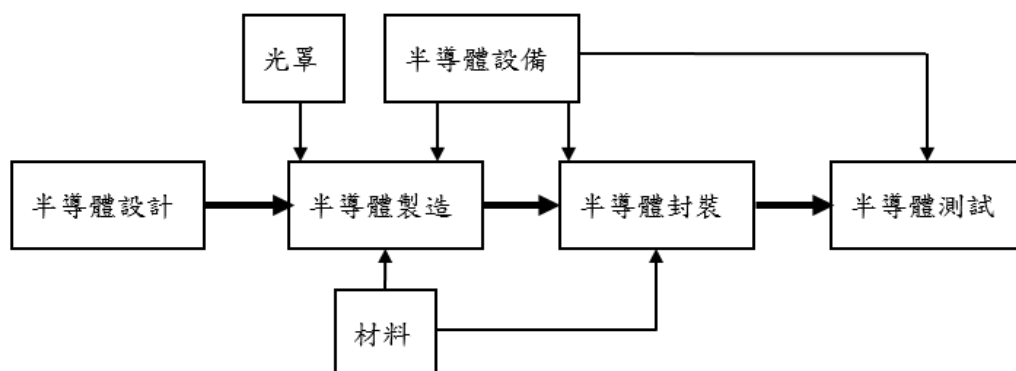
#### (2) 晶圓製造：

晶片製造屬於高資本、高技術、與高知識性的產業，負責將晶片設計，製作出半導體晶圓。隨著晶片效能的提升需求，細線路化，高集積化，晶圓製造的門檻愈來愈高，能夠投資在先進製程的廠商愈來愈集中化。晶圓製造概分為 IDM 公司(廠內自行製造)，與專業晶圓製造代工兩種。

#### (3) 晶片封裝及測試：

封測產業將製造出的晶圓，進一步作測試與封裝，以便進一步應用在主機板與系統層級上。隨著摩爾定律的進展受限，封裝的角色日益吃重，必須藉由先進封裝的作法，將不同功能的晶片進行異質整合，是封測業被半導體產業界賦予的重要責任與期待。

行業上、中、下游之關聯性，如圖所示：



### 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### (1) 產品之發展趨勢

半導體產品朝向多功能，效能強化、省電、散熱，與高整合度的發展趨勢，帶動先進封裝朝向系統級封裝 (SiP) 及異質整合封裝 (Heterogeneous Integration) 的產品需求。新型態的先進封裝技術，諸如面板級扇外型封裝 (Panel Fan-Out)、矽穿孔 (TSV)、內埋式封裝 (Embedded Package)、晶片薄化 (Thin Wafer)、晶片堆疊 (Chip Stacking)、細間距覆晶 (Fine Pitch Flipchip)、高密度模封 (High Density Encapsulation)、天線整合封裝 (AiP)、高密度表面焊接 (High Density SMT)、系統組裝 (System assembly) 及測試 (Testing) 等技術的整合，將是後摩爾時代來臨之際，半導體產業的重中之重。

未來的產品趨勢，將需要整合各種先進的封裝測試技術。本公司多年以來，強調持續不斷的技术研發，因應新型態產品的需求，對產品發展的趨勢，能精準掌握，並能夠在最正確的時間點，推出適合市場的必要技術。

面對半導體在未來數年的持續成長態勢，力成科技一如以往，持續半導體與系統級的封裝測試技術的創新，維持在全球 OSAT 的技術領導地位。同時重視品質，生產良率，期能充分提供市場與產業界在各個領域需求的不同技術，讓客戶享受最有競爭力的服務，與客戶一同成長。

#### (2) 競爭情形：

力成科技擁有完整的半導體後段封測能力，足以提供客戶從晶圓凸塊 (Bumping)、晶圓測試 (Wafer Sort)、晶圓級封裝 (WLCSP)、鋁線封裝 (Wire bond Package)、覆晶封裝 (Flip chip Package)、系統級封裝 (System in Package)、面板級扇外型封裝 (Fanout)、3 維矽穿孔 (3DIC TSV)、模組與系統級組裝 (System Assembly)、封裝與系統級測試 (Final Test) 等服務。

當晶圓從半導體製造廠產出之後，力成科技提供客戶一次滿足半導體後段所需的所有服務，客戶將無需費心逐一安排後段各個站點的生產基地與產能；本公司能夠提供完整的半導體後段服務，涵蓋傳統產品封測，以及最先進技術的量產能力與產能，這是力成科技得以持續在半導體後段競爭的的最大利基之一。

除此之外，力成科技的優勢在於，技術能力強、生產天數短、生產良率高及生產成本低。本公司願意將自身的優勢，與客戶共享，在過去超過二十年的公司歷史中，始終以客為尊，與客戶分享優勢，共同成長。

展望未來，隨著先進封測技術的需求日殷，力成科技除了持續維持記憶體封測的領導地位外，隨著 AI 晶片與伺服器晶片面積日益增大，傳統晶圓載體限制了產出。力成的 FOPLP 技術預計在 2026 年進入成熟的大規模量產期，成為次世代 AI PC 與低軌衛星傳輸晶片的關鍵封裝解決方案，藉此拉開與後進者的成本差距。

#### 2025 年全球前十大封測廠之台灣廠商排名及 2020 年~2025 年成長態勢

單位：新台幣百萬元

公司名稱	2020年 營收	20/21 成長率	2021年 營收	21/22 成長率	2022年 營收	22/23 成長率	2023年 營收	23/24 成長率	2024年 營收	24/25 成長率	2025年 營收
日月光	476,979	19.50%	569,997	17.70%	670,872	-13.26%	581,914	2.32%	595,410	8.39%	645,388
<b>力成</b>	<b>76,181</b>	<b>9.99%</b>	<b>83,794</b>	<b>0.16%</b>	<b>83,927</b>	<b>-16.07%</b>	<b>70,441</b>	<b>4.08%</b>	<b>73,315</b>	<b>2.20%</b>	<b>74,929</b>
京元電	28,959	16.58%	33,759	8.95%	36,782	-10.21%	33,025	-18.68%	26,856	30.08%	34,933
頤邦	22,275	21.58%	27,082	-11.34%	24,010	-16.47%	20,056	1.40%	20,337	5.49%	21,454
南茂	23,011	19.07%	27,400	-14.17%	23,517	-9.19%	21,356	6.27%	22,696	5.45%	23,933

資料來源：公開資訊觀測站/各公司財報，力成公司整理

### (三)技術及研發概況

#### 1.研發費用

本公司最近年度研發費用支出情形詳如下表：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2025 年度
研發費用	2,807,250

#### 2.開發成功之技術或產品：

##### (1) 封裝產品方面的成果：

- A. 持續量產深具成本競爭優勢的無凸塊扇外型 (Bump-Free Fan-Out, BF<sup>2</sup>O<sup>®</sup>) 面板級封裝，應用於行動裝置、穿戴式裝置及其他消費性產品等多樣化的終端產品。
- B. 利用覆晶封裝結合重佈線路技術 (Chip Last Integration Package, CLIP<sup>®</sup>) 整合系統晶片 (SoC) 與動態隨機存取記憶體 (DRAM)，加上層數簡化的封裝基板 (Substrate) 形成 Fan-out on Substrate 封裝技術。
- C. 利用 (Chips Integration Embedded Fan-out Solution, CHIEFS<sup>®</sup>) 重佈線路之細線寬能力，使 BT 基板 (Substrate) 尺寸與層數得以減小，形成具尺寸與成本競爭優勢的 Chip First Fan-out on Substrate 封裝架構。
- D. 以扇外型面板級封裝 (Fan-Out Panel Level Package, FOPLP) 之晶片嵌入式製程技術 (Pillars in Fan-Out, PiFO<sup>®</sup>) 整合光源晶片與其控制晶片，以應用於娛樂、醫療、教育等領域的 AR/VR 裝置。
- E. 以晶片嵌入式製程技術 (Pillars in Fan-Out, PiFO<sup>®</sup>) 提供智慧型手機應用處理器 (Application Processor, AP) 高效能且更輕薄短小的 PoP (Package on Package) 封裝需求。
- F. 結合扇外型封裝與矽穿孔晶圓級封裝 (TSV-WLCSP) 之 Chip Middle FOPoP 結構，提供穿戴裝置應用需求。
- G. 實現超細線寬與間距重佈線製程 (RDL) 之 FOPLP 技術開發與驗證，運用在高速運算處理晶片。
- H. 晶圓重組技術之開發，將兩種或以上不同功能之晶片整合在一晶圓上與矽穿孔晶圓級封裝 (TSV-WLCSP) 達到小尺寸多晶片模組的優勢，符合消費性電子產品之輕薄短小與高傳輸速率低功耗的需求。
- I. 以矽穿孔 (TSV) 與高精度的晶片堆疊製程所製作的高密度的高頻記憶體 (High Bandwidth Memory, HBM)。
- J. 成功開發應用於行動裝置、醫療、監控及車用領域等應用市場的矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝 (TSV CIS CSP) 技術。
- K. 成功開發大尺寸 (85mm x 85mm) 多晶片模組封裝 FCBGA (SoC + chiplets)，應用於 AI 伺服器。
- L. 成功開發嵌入式 H/S FCCSP，用於微控制器與電視晶片封裝。
- M. 成功開發 FCLGA，用於電源晶片在 AI, HPC, 汽車的應用。
- N. 成功開發 5G AP、Modem、RF 相關應用之 FCCSP 產品。
- O. 成功開發 TV Chip 及 RF 相關 FBGA、HS-FBGA 產品。
- P. 成功開發 WiFi 相關 Hybrid (DB, WB+FC) 產品。
- Q. 成功開發 H/S FCBGA，應用於汽車上的 SOC 與 MCU。
- R. 成功開發封裝體堆疊 (Package on Package) 應用銅核心錫球等新製程與材料。
- S. 成功開發 CIS 於基板上的系統級封裝。

- T. 成功開發車用相關晶片FCBGA產品。
  - U. 成功開發高速傳輸控制晶片(PCIE) FCCSP產品。
  - V. 成功開發光傳輸網路控制晶片(OTN) FCBGA產品。
  - W. 成功開發高散熱金屬導電膠應用於大尺寸 FCBGA 與FCLGA。
  - X. 成功開發封裝體堆疊(Package on Package)應用銅核心錫球等新製程與材料。
  - Y. 成功開發生產16顆NAND晶片堆疊+2顆Interface Chip 可滿足大容量SSD產品。
  - Z. 成功開發 8xDRAM+8xNAND+Controller uMCP Hybrid (WB+FC)產品，可滿足高速大容量行動通訊產品。
  - AA. 成功開發天線封裝(Antenna in Package, AiP)技術及射頻(Radio Frequency, RF)實驗室的建置，可協助客戶加速在5G高頻封裝產品上的開發與驗證。
  - BB. 成功開發Via middle TSV DRAM FCCSP 取代傳統 W/B BGA for Data center 應用。
  - CC. 成功開發Via middle TSV 技術 for Optical Engine 之 CPO 應用。
- (2) 測試產品方面的成果：
- A. UFS3.0 Automotive Product 測試服務與硬體開發。
  - B. 高速 3D-NAND (1.6Gbps) 測試服務與硬體開發。
  - C. Micro Shield Storage Memory 測試服務與硬體開發。
  - D. uLED 測試服務。
  - E. uLED 晶圓 BI 測試服務。
  - F. T2000 EPP tester 量產導入。
  - G. 系統級 IC BI 測試解決方案與硬體開發。
  - H. 防沾黏記憶體測試治具開發。
  - I. 大尺寸封裝之測試服務與硬體開發。
  - J. 大尺寸封裝之測試機台開發。
  - K. UFS 4.0 汽車產品應用測試服務與硬體開發。
  - L. AR / VR 相關應用之測試服務與硬體開發。
  - M. High pin count O/S 測試機開發。

#### (四)長、短期業務發展計劃

茲就本公司有關經營、生產、行銷、研發等策略領域之短期及長期發展計劃之內容說明如下：

##### 1.短期發展計劃

###### (1) 積極開發新製程及技術

技術領先始終是本公司著重的經營方向之一。隨著 AI 興起及半導體應用的多元性，以及不同產品對封裝技術的差異化需求，本公司將持續新製程及新技術之開發，以期滿足客戶對先進封裝解決方案的需求。例如，透過 TSV 製程，應用於 HBM 產品，可支援高速高頻寬的記憶體模組的推進；同時面板級扇外型封裝技術 (Panel Level Fan Out)可廣泛應用於 HPC/ AR / AI / IoT/ 智慧駕駛等領域，進一步實現異質整合封裝 (Heterogeneous Integration)，有助於半導體晶片高速，高頻寬的需求達成，並實現 ASIC 對於大尺寸封裝的需求。

(2) 持續擴充製程範疇，深化客戶服務，優化生產

本公司將持續擴展製程能力與範圍，藉由彈性且快速的產能調整能力，提供客戶更具競爭力的生產支援與整體解決方案，進一步強化客戶黏著度與服務深度。

(3) 持續提供整合性服務 (Turn-Key Service)

由於上游晶圓廠基於成本考量，逐漸將 IC 之封裝及測試業務外移至專業封測廠。本公司積極進行產品組合的優化，以及先進封裝測試技術的研發和量產，成為國內少數能同時提供先進技術的封裝及測試一元化服務的領導廠商。未來將持續提供高技術的整合性服務，強化本公司在客戶供應鏈內的價值與競爭力。

## 2. 中長期發展計劃

(1) 強化與客戶之間的長期合作關係

本公司將持續與上下游廠商的緊密合作，順應產業分工的發展趨勢，扮演客戶值得信賴的夥伴關係。透過穩定的品質、彈性的服務與持續精進的封裝技術，與客戶建立長期互信基礎，攜手共同成長。

(2) 注重與供應商之間的長期合作關係

供應商是本公司生產能力的重要延伸，尤其是半導體設備、材料等領域，更是力成多年來得以持續成長茁壯的關鍵。未來，本公司將持續以互利、互信及共榮為基礎，深化與供應商之合作夥伴關係，建構穩健且具韌性的供應鏈體系。

(3) 推動數位化與智慧化轉型

在既有的 AI/Big Data 基礎上本公司將持續推動數位轉型。導入 RPA(流程機器人)來處理大量重複執行的作業，以節省人力、提高效率。同時運用 BI(商業智慧)工具，即時掌握營運資訊與趨勢變化。透過 EDA(工程資料分析)系統，快速進行專案監控與問題分析提升決策品質。

藉由持續強化數位化與智慧化能力，本公司將進一步提升產品良率、優化製造流程，並精進整體生產效率與競爭性。

(4) 持續開發下世代所需的封裝測試技術

力成科技將持續聚焦於下世代封裝與測試技術之研發，並依據市場趨勢與客戶需求，強化技術創新與專利佈局，以維持競爭優勢。除持續提升既有製程效率與產品品質外，亦將同步推動成本優化。

自 2006 年成立封測研發中心後，本公司已累積包括 Stacked Die、Thin wafer 等技術門檻，近年更積極布局面板級扇外型封裝(FOPLP, Fan-out Panel Level Packaging)、矽穿孔(TSV, Through Si Via)、CPO 等先進封裝技術，奠定長期成長基礎。

(5) 持續提升高階產品與先進封裝測試營收比重

本公司將持續優化產品組合，積極提升高附加價值產品及高階封裝與測試之營收占比。並擴大主要客戶的合作規模，以強化產業競爭地位，分散營運風險，提升整體獲利能力。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要產品為提供 IC 封裝及測試服務，銷售地區包含國內外市場，2025 年度內銷比重約 41.01%；外銷比重為 58.99%，以日本及美洲地區為主。

單位：新台幣仟元

銷售地 \ 年度	2024 年度	%	2025 年度	%
內銷	14,072,499	19.19	30,729,287	41.01
外銷	59,242,543	80.81	44,200,033	58.99
日本	22,691,850		20,693,320	
新加坡	18,360,461		2,763,950	
美洲	13,269,647		13,445,864	
歐洲	1,718,756		3,236,847	
中國大陸及港澳	1,571,006		2,420,191	
其他	1,630,823		1,639,861	
合計	73,315,042	100.00	74,929,320	100.00

#### 2.市場佔有率

半導體封測產業在 2025 年第二季開始，隨著庫存去化、新興應用需求增加，半導體市場預計將重回成長軌道，封測產業也將受惠於此趨勢。持續精進各項產品技術與生產製造能力，以期景氣持續好轉時能加速成長提升市場佔有率，是公司穩健經營的策略方針。期望 2026 年，力成科技在全球專業封測代工大廠中的市場佔有率能持續上升，公司一本穩健經營，持續成長的策略，踏著穩健的步伐成長。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

展望 2026 年，依據國際數據資訊公司(IDC)預測，2026 年全球半導體市場整體市場預計成長超過 11%，而封裝測試產業預計成長 11%。就長期而言，半導體產業的持續成長方向依然不變。

#### 4.競爭利基

力成科技長年以來，以優異的生產良率與品質、用心的服務及創新的技術，與世界一級客戶建立了既深且長的密切合作關係，本公司具備之競爭利基如下：

##### (1)堅強的策略聯盟/走向全球化：

IC 封裝及測試業與上游晶圓製造廠之互動程度高，因此封裝及測試之獲利因素在於穩定之客戶訂單來源，而 IC 製造廠，鑑於其產品技術、產品品質及生產程序之保密性，亦會選擇與 IC 封裝及測試業之長期合作，因而形成策略聯盟，並與之有長期穩定之合作關係，有利於未來公司之長期發展。

##### (2)整合性的全面服務：

本公司同時提供從晶圓針測(CP)、封裝到最終測試(FT)的一站式服務，以降低產品來回運送之成本與風險，以符合客戶需求，提高公司競爭利基。

##### (3)FOPLP 技術領先者：

力成擁有全球最成熟的面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel Level Packaging)生產線。相較於晶圓級封裝(FOWLP)，其具備更大的封裝面積與更低的成本，是 AI 晶片邁向平價化的關鍵路徑。

##### (4)領先業界的研發與製程能力：

本公司致力於創新技術研發，並對生產製程改善不遺餘力，至今已取得國內外數百件專利，奠定厚實的技术研發基礎與能量。

(5) 自動化及高精密度機台引進：

因應積體電路 IC 產品朝車用及 AI 晶片發展，為提昇為客戶服務品質，持續與廠商合作開發先進自動化及高精密度設備，並且導入自動化光學檢驗及量測設備，以符合客戶及市場需求。

(6) 網路自動化客戶服務系統：

本公司利用網際網路系統資訊傳遞及系統持續的改善，客戶可以隨時掌握產品問題及目前進度，瞭解產品狀況，有助於產品之改善及快速解決問題，提高對客戶之附加價值。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

【產業環境】

① 台灣半導體產業的競爭優勢

台灣半導體產業擁有完整的半導體產業結構，從上游的 IC 設計、晶圓製造至下游的封裝測試，垂直整合的產業鏈符合產業趨勢需求，造就台灣半導體產業在國際市場之競爭地位。IC 產業的榮景隨著全球電子、資訊、通信、消費性電子、光電工業、人工智慧以及物聯網蓬勃發展，將使 IC 封裝、測試業持續穩定發展。

② IDM 大廠委外趨勢有利於封測市場

因先進製程須高額資本支出，使得全球 IDM 廠陸續擴大晶圓代工與封測委外業務於生產成本較低的亞洲地區，因此，具有 IC 產業完整與動態的垂直分工體系的台灣，成為國際 IDM 與 IC 設計公司委外代工的首選，台灣封測廠亦獲益於 IDM 委外訂單。

【公司利基】

① 穩健的策略聯盟及經營團隊—

力成科技的主要股東與經營團隊，長年來穩定用心經營，形塑公司穩健踏實的企業文化，此有助於公司知名度之建立及訂單來源之穩定。另外，本公司之經營團隊皆具備半導體領域之完整資歷，能洞悉市場趨勢，帶領公司力抗不景氣，調整作法，擬定與時俱進的公司策略。

② 持續的研發及創新一

因應市場的快速變遷，力成建構了完整的封裝、測試與模組產品的研發團隊，全面致力技術深耕，並透過技術合作引進先進技術。

③ 整合性的全面服務—

力成科技可完整提供半導體後段封測所需的各式生產技術，從傳統的導線架封裝，到最先進的矽穿孔或面板級扇外型封裝。全面性的技術服務，讓力成得以在世界的封測產業，持續成長。

(2) 不利因素及因應措施：

① IC 產業隨景氣波動

因應對策：

A. 產品多角化佈局

除了持續維持並強化在記憶體 IC 封裝測試技術的領導地位外，也積極打入邏輯 IC 的封測市場，藉由銅柱凸塊(Copper Pillar Bump, CPB)，金屬線路鐳墊重分配製程(Re-distribution, RDL)，晶圓級封裝(Wafer Level CSP)，覆晶封裝，面板級扇外型封裝，系統級組裝等新製程技術，得以快速進軍邏輯 IC 領域。公司藉由多角化的產品降低景氣循環的風險，提供客戶更多元化之封測服務。

B. 強化與客戶的合作模式

與現有客戶建立長期策略聯盟夥伴關係，並積極開發新客戶，使產能得到充分而穩定的利用。

### C.擴大市場服務範圍

積極進軍日本與歐美市場，並切入 AI、自駕車、電動車、5G、工業、等應用，擴大客戶群與產品應用的領域。

### ②原物料庫存增加

#### 因應對策：

#### A.去化庫存

對應終端市場產品需求之變化，持續與客戶溝通並加速過期原物料之處置、積極與供應商協調針對原物料在外訂單的處置以達到庫存有效管控，並加速庫存去化。

#### B.降低生產成本

持續進行原物料之詢、議、比價以及改變產品結構、改善良率、提出可替代材料之解決方案，並持續改良製程能力，降低成本上漲之影響。

#### C.強調附加價值

持續站在客戶立場，提供品質好、交期短、快速應變客戶需求的服務。致力研發新的封裝測試技術，使客戶在市場上推出具有時效性及競爭優勢之產品。

#### D.與供應商建立長期合作

本公司積極與設備及材料供應商建立長期穩固的合作關係，進而達到雙贏的目標。

### ③基層勞工短缺

#### 因應對策：

A.提高員工薪酬與福利以吸引人才加入本公司，持續強化員工關懷與人才適性發展措施，讓同仁的工作與生活得到平衡，達到留才之目的以穩定人力。

B.引進與開發自動化機器設備與系統，提升員工生產力，降低對人力需求。

C.積極走入校園，擴大產學合作，建立學用接軌，培養新生代人才。

D.呼應勞動部所提出移工中階技術人才方案，培訓藍領移工技術升級，晉升為中階技術人才，以穩定生產人力，因應就業人口老化及半導體人才不足困境。

### ④半導體後段競爭加劇

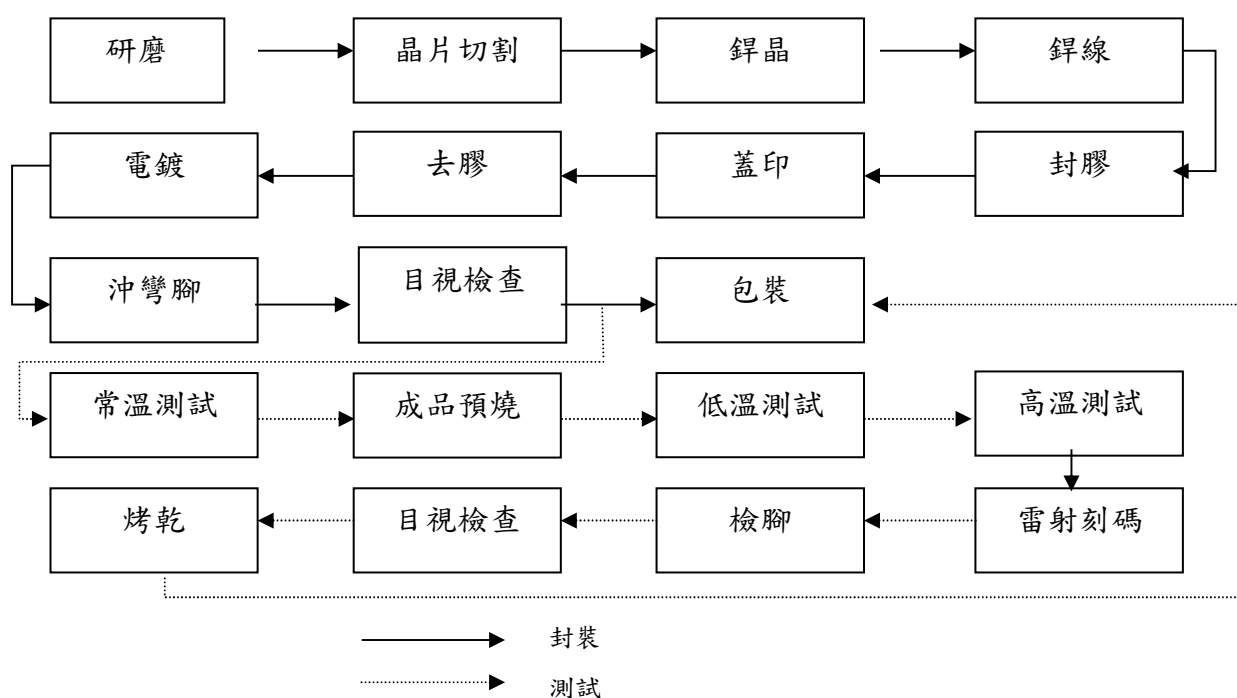
在日新月異的先進科技發展中，半導體技術擔任了非常重要的角色。在半導體供應鏈中，過去大家的注意力，比較集中在晶圓製造的領域。在後摩爾時代來臨下，以先進製程所生產的半導體晶圓的效能，需要先進的後段封裝技術配合，方能達成。面臨半導體晶圓廠與基板廠紛紛進軍先進封裝領域，本公司將繼續強化技術研發，審慎進行新技術與新產能的投資，與客戶和供應商建構穩固的合作關係，並強化由晶圓測試到成品出貨的一元化服務，將繼續在半導體後段領域，建構雄厚的競爭力。

## (二)主要產品之重要用途及產製過程

### 1.產品用途：

主要產品或服務項目	重要用途或功能
積體電路(IC)封裝(Assembly)	將積體電路(IC)由晶圓產品經由切割、黏合、接線、封膠、切腳、成型等製程完成單顆成品。
環境分類測試(Final Test)	依客戶所指定之測試條件，將產品(IC)置於不同的環境如常溫、高溫或低溫中測試並分類，確保客戶所提供的產品符合其所要求的品質及穩定性。
成品預燒(Burn-In)	運用預燒(Burn-In)製程，讓產品(IC)處於極端的環境中運作，加速產品的老化並予以篩選，以確保產品的可靠性。
雷射刻碼(Laser Mark)	於產品(IC)封裝上刻印廠商名稱及產品類別。

## 2. 產製過程：



### (三) 主要原料之供應狀況

本公司主要是為客戶提供之 IC 加工，其中封裝作業須使用主要原料之供應狀況如下：

主要原料	主要供應商
導線架(LEAD FRAME)	Shinko Electric、長華電材、NICHIDEN SEIMITU KOGYO.
基板(Substrate)	景碩、Shinko Electric、SIMMTECH、Samsung Electro-Mechanics Co、禮鼎、恆勁、GTS
黏晶膠(Die attach Film)	台灣力森諾科、台灣日東、琳得科先進、Henkel Korea.
金線(GOLD WIRE)	Nippon、Tanaka
樹脂(COMPOUND)	晁揚、台灣力森諾科、新加坡京瓷亞太、長華電材

### (四) 最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

#### 1. 本公司主要供應商名單：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	甲	2,525,578	11.24	無	甲	2,916,568	10.46	無
	其他	19,935,465	88.76		其他	24,966,377	89.54	
	進貨淨額	22,461,043	100.00		進貨淨額	27,882,945	100.00	

增減變動原因：無顯著變動。

2.本公司主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	甲	15,208,796	20.74	無	甲	15,791,669	21.08	無
2	乙	16,111,879	21.98	關係人	乙	14,896,326	19.88	關係人
3	丙	8,921,762	12.17	無	丙	7,526,344	10.04	無
	其他	33,072,605	45.11		其他	36,714,981	49.00	
	銷貨淨額	73,315,042	100.00		銷貨淨額	74,929,320	100.00	

增減變動原因：無顯著變動。

三、從業員工資訊

最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率一覽表：

年 度		113 年度	114 年度	115 年度截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	管理職人員	606	609	603
	技術職人員	2,915	3,186	3,171
	行政職人員	425	434	435
	作業人員	7,412	8,506	8,460
	合 計	11,358	12,735	12,669
平均年歲		37.32	36.76	36.83
平均服務年資		8.01	7.46	7.57
學 歷 分 布 比 率 %	博 士	0.04	0.05	0.05
	碩 士	8.19	8.05	8.03
	大 (學) 專	73.11	75.80	75.94
	高 中	18.08	15.45	15.36
	高 中 以 下	0.58	0.65	0.62

#### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因違反環境法規所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及相關處分內容：

114 年無環保相關處分。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

1. 114 年力成科技營運管理支出為新台幣 195,650 仟元，防治設備支出為新台幣 191,295 仟元，環保類支出總計為新台幣 386,945 仟元。

力成科技環保類支出金額統計：

項 目	單位：新台幣 仟元	
	114 年度	115 年度
營運管理支出	195,650	195,649
防治設備支出	191,295	46,229
支出金額合計	386,945	241,878

註：1.營運管理支出包含廢棄物清運、污水或污泥處理、環境檢測、空污防制費及碳費等經常性費用。

2.防治設備支出包含空污防制設備、廢水處理設施、廢棄物貯存設施等維護保養及設置工程費。

2. 環境維持因應措施，請參閱本年報第 41~43 頁說明二。

#### 五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練及其實施情形

力成科技重視人員的待遇與福利，依據各類獎金發放規範，提供合乎適用法律的員工福利，於每年度結算後之盈餘，扣除相關稅捐、公積及股息後，以固定比例撥予員工酬勞。

人才是支持公司不斷成長的最重要資產，也是企業永續經營的核心關鍵，我們致力於提供員工優質的工作條件，包含具有優渥、競爭力的薪酬福利及落實女男同工同酬、機會平等之目標，來吸引及留任各方優秀人才，以回饋同仁與公司共同創造佳績的辛勞與貢獻。期望能創造讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，使員工安心工作，發揮工作潛能，一同成長。

1.保險方面：

除法定勞、健保外，本公司員工均享有免費的團體保險，保障內容涵蓋壽險、意外險、醫療險及癌症險等，員工無須負擔任何費用。秉持關懷員工及眷屬的理念，除員工本人外，其配偶與子女亦享有免費團體保險保障。

此外，為進一步將關懷延伸至家庭長輩，114 年特別推出「員工父母及配偶父母自費團保優惠方案」，讓員工可透過優惠條件為雙方父母加強保障，全面守護家庭安全與幸福。

2.健康與安全方面：

(1)廠區內備有保健室、哺乳室及醫師駐廠，透過專業醫療人員及健康管理，進行健康促進與管理員工的健康，公司也設有新進員工體檢補助及優於法規的定期員工免費健康檢查，以追蹤員工健康狀況。

(2)針對健康異常之高風險族群進行風險管控及復工評估，且不定期公佈健康資訊、進行職災防範宣導與安排健康講座。

- (3)對於員工因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，預防發生對象為自覺有異常工作負荷主動通報之同仁，實施健康風險評估、過勞風險評估及佛明罕心血管疾病等評估，駐廠醫師依據綜合評估結果，進行諮詢及紀錄以維護同仁健康。
- (4)力成科技於 93 年通過 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統認證，為達預防職傷事故並維護安全和健康之工作場所目標，我們訂定「環境安全衛生政策」，以維護員工的安全和健康。

#### 環境安全衛生政策

- 將環境與安全衛生政策傳達予員工、客戶及相關團體。
- 符合環境保護及安全衛生相關法令規章及客戶之要求。
- 工作者及其代表諮商及參與防止傷害、疾病、事故預防及損失控制。
- 順應國際環境保護趨勢及組織處境，積極推動節能減廢活動。
- 持續檢討與改進，提高安全衛生及環境管理目標及整體績效。

#### 3.員工協助方面：

員工的健康是企業最大的財富！健康快樂的員工能為公司創造更高效益的績效。力成科技持續推動與提供多元的健康促進方案與關懷機制，並取得「健康職場認證健康促進標章」，實踐對每位員工身心健康的重視，營造優質的健康工作環境。力成科技致力於提供優於法令的健康檢查、健檢異常追蹤與管理，以及擁心理諮商與員工協助方案等措施，讓力成員工在工作與生活間達到身心健康。

#### 4.家庭日/大型活動/休閒活動方面：

福委會規劃家庭日及其他大型活動，依據活動屬性邀請同仁與眷屬一起前來同樂、放鬆身心靈。

- (1) 大型活動：睽違五年，我們在 114 年 3 月 21 日於新竹縣體育館舉辦公司年度晚會，晚會必備經典活動，包含重磅主持人與歌手演出、喜從天降獎金摸彩活動、熱力四射員工表演、模範員工與專利頒獎等。每一位力成同仁都是一道光，透過這場盛宴匯聚成一道星芒，讓我們力聚未來，攜手迎接榮景的到來，We are ready！
- (2) 家庭日：114 年下半年舉辦 1 場次，吸引近 5,000 名同仁及眷屬熱情參與，一起在假日時光與同事、親友共度快樂時光，留下難忘的回憶。
- (3) 休閒活動：
  - A. 健康紓壓課程：我們於廠內韻律教室定期舉辦健康紓壓課程，共開設 4 個梯次：瑜珈 8 堂課共 141 人參與、有氧舞蹈 7 堂課共 114 人參與，隨著動感的音樂一起舞動，不僅燃燒了熱量，也釋放了工作壓力！
  - B. 娛樂券：我們以電子福利點數的方式發放每人 2,000 元點數，同仁可自行決定兌換店家與使用時機，只要手機在手，即可進行娛樂相關費用折扣、購買樂園門票或是享受一頓美食饗宴。除此之外，我們也持續與知名旅行社簽訂特約合作，同仁可使用較優惠的方案安排自己的休閒活動。

#### 5. 社團方面：

社團是一個可以讓擁有相同志趣的同仁們透過興趣聯繫感情以及在工作之餘放鬆、休息的管道之一；我們持續支持同仁自主辦理及參與各式社團。力成台灣截至 114 年有 11 個由同仁自主創立的社團，共計 366 位社員。每年各社團除了有例行性的社團活動，也會舉辦全公司性的活動，提供社員與非社員、同仁與非同仁交流與合作的機會。114 年社團嘉年華總共有 7 個社團為同仁精心規劃精采的實體活動：喵星人社、羽球社、慢跑社、保齡球社、親子探索社、禪學社和壘球社。從七至八月接連熱力登場，無論是動態還是靜態的活動都能看到力成人熱情參與的身影！本次社團嘉年華吸引近 678 位同仁及眷屬參加，不僅展現了力成人的團結與創意，也充分體現了公司對同仁及其眷屬的關懷與重視。

#### 6. 休假方面：

本公司比照勞基法規定給予每月例假及年度休假，並定期提供統計報表供主管瞭解關懷同仁休假狀況，以協助同仁達成工作與生活之均衡。

#### 7. 生日婚喪及其他福利項目：

- (1) 每月發予壽星 1,000 元等值祝賀禮(114 年起從原 520 元提升至 1,000 元)，並針對同仁婚喪喜慶及住院、重大災害等，提供 1,000 至 10,000 元不等的福利補助金。
- (2) 每年勞動節、端午節各提供 1,000 元等值的現金。
- (3) 每年中秋節提供 1,000 元現金及 1,000 元等值祝賀禮，發放金額與形式依年度公告為主。
- (4) 每年針對年資滿 3、5、10、20、25 年之同仁，給予獎勵禮品一份。

#### 8. 生育補助及相關服務：

針對員工本人或配偶生育，提供每胎 2,000 元的補助金，並提供勞保生育給付的相關申請服務。同時我們也關心員工與其家庭的互動，透過福委會與員工居住區域之優良幼兒園、托兒機構簽訂特約優惠合約做為托兒措施，提供員工於安排子女學前教育或安親的照料時，有多元的機構可選擇。

#### 9. 食宿方面：

- (1) 本公司設有餐廳，提供自助餐，用餐皆有公司補助，同仁僅須支付少許餐費即能享有豐盛之餐點。107 年成立「伙食管理委員會」，透過定期的會議召開討論公司膳食議題，更健全了餐廳及伙食的管控。
- (2) 為使遠道員工就近解決住的問題，公司備有員工宿舍，提供舒適之生活環境。

#### 10. 人才發展：

秉持著「以終為始」宗旨，透過年度訓練需求調查，本公司從經營目標出發，擴散自各部門，逐步展開育才賦能計畫，建構出四大訓練藍圖，包含：「人才職能發展」、「PTI 稽核系統」、「法令政策培訓」、「技能學習移轉」，滿足員工多元培訓需求；此外，本公司為了滿足員工隨時隨時學習的需求，亦邀請各單位資深、優秀同仁擔任內部講師，將品質基礎課程、軟實力課程、單位 OJT 等學習資源線上化，並將這些數位課程放於數位學習平台中，讓同仁能根據自身工作需求自主學習！同時，本公司於各廠區建置圖書區，定期採購優質書籍，包含：產業趨勢、工作技巧、經營管理等主題，滿足同仁閱讀的需求。藉由多元的培訓與學習方式，不斷激發同仁在工作崗位上的潛力，協助員工伴隨公司一同成長！

## (二)退休制度與其實施情形

### 1.退休申請制度：

力成科技遵照「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，退休申請適用規定如下：

退休類別	退休要件
A.自請退休	A、服務本公司十五年以上，年滿五十五歲者。 B、服務本公司二十五年以上者。 C、服務本公司十年以上，年滿六十歲者。
B.強制退休	A、年滿六十五歲者。 B、身心障礙不堪勝任工作者，所謂身心障礙係指經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者為標準。

### 2.退休金提撥與實施

設立勞工退休準備金監督委員會，依選擇舊制和選擇新制但保有舊制年資人員按每月薪資總額提撥 2% 提列退休準備金至法定帳戶，並於每年初透過專業的精算顧問進行退休準備金精算評估確保足額，截至 114 年底舊制退休準備金帳戶金額約為 3.72 億元，可滿足勞工符合退休條件時請領退休金。選擇退休新制人員，依法每月提撥薪資 6% 存入勞保局勞工個人帳戶。114 年度會計帳列合計提撥之新、舊制退休金費用及員工提撥合計總額為 449,365,655 元，以期同仁皆能於退休後享有安心的保障。

## (三)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

建置全方位溝通管道：

力成科技為強化勞資關係並保障員工權益，每季定期召開勞資會議及區域性福委會，討論勞資相關議題。員工代表在會議中積極發表意見，幫助同仁表達訴求，經由雙方充分溝通協商後達成共識，進而提升員工的向心力與認同感。此外，公司設有多樣化的溝通管道，作為勞資雙方的橋樑，及時回應員工建議，並持續檢視與完善相關規範及制度，以回應員工需求並維護其福祉。

為促進良好勞資關係和友善職場氛圍，力成科技制定《員工溝通管道作業規範》、《執行職務遭受不法侵害預防計畫辦法》和《性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範》等內部辦法，提供多元、雙向、開放且暢通的反應機制，解決員工疑慮。反應者得選擇具名或匿名提出，並通過公正、迅速且保密的處理流程，保障反應者的隱私與權益。公司設有專門的溝通管道窗口和性騷擾處理窗口，各項反應均能獲得妥善處理，並明確禁止對反應者或協助調查人員之任何報復行為。

為確保多元溝通管道機制能有效傳達至全體員工，公司每年定期辦理《多元溝通管道宣導》、《性騷防治宣導》、《職場不法侵害宣導》和《管理最前線 e 報主題文章宣導》等活動，持續深化員工對反應管道的認識與運用，共同營造安全、友善且和諧的職場環境。



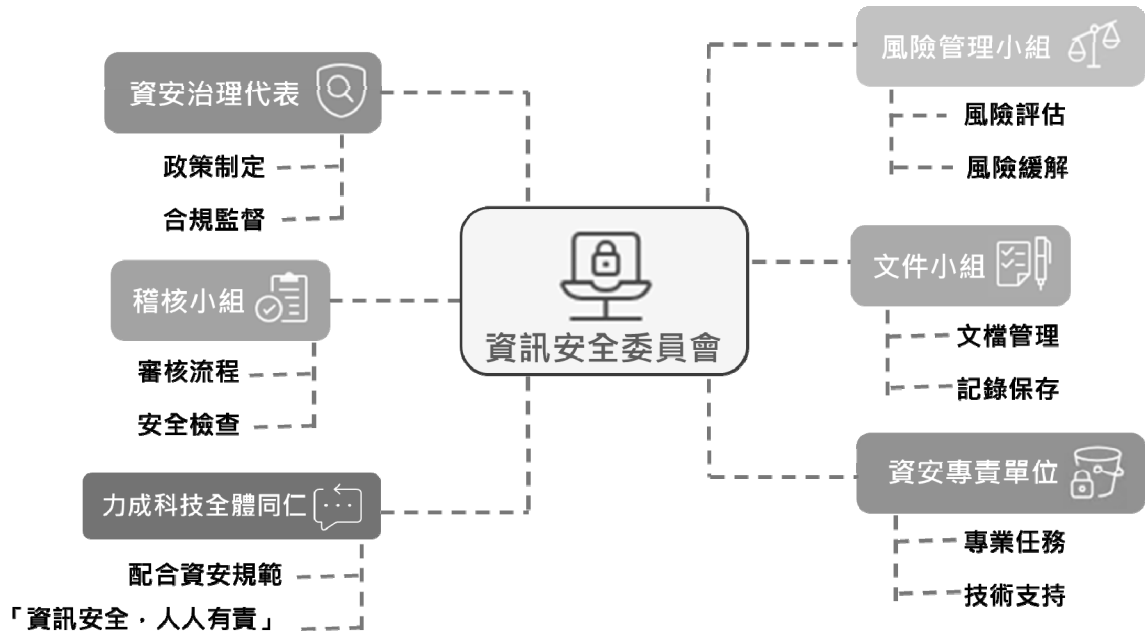
(四)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

幣別：新台幣

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
114/09/10	114 年府勞資字 1143935110 號	性別平等工作法 第 13 條第 2 項	員工性騷事件，不服公司調查結果，向勞工處申訴，勞工處依違反性平法處以罰鍰。	罰鍰 20,000 元
115/01/19	115 年府勞資字 1153900240 號	勞基法 第 32 條第 2 項	延長工作時間超過法令規定。	罰鍰 50,000 元

## 六、資通安全管理

### (一)資通安全風險管理架構



為體現力成對資訊安全治理的最高承諾，我們於 2016 年正式成立「資訊安全委員會」（Information Security Committee），作為統籌全公司資安戰略與管理體系維運的核心任務組織。該委員會直隸於高層管理體系，負責貫徹資訊安全管理系統（ISMS）的建置、執行與持續改善，並定期向董事會報告資安治理績效、全球威脅趨勢及風險應對概況，確保資安決策與企業營運目標高度一致。本公司秉持「預防勝於治療」的原則，不僅每三年持續通過 ISO/IEC 27001 國際資訊安全管理認證，更於 2025 年完成 ISO/IEC 27001:2022 轉版認證，確保管理機制與時俱進。我們透過嚴謹的管理審查、多層次的內部稽核與動態風險評鑑機制，將資安防護落實於具體行動中。藉由系統化的矯正與預防措施，我們持續強化資安防禦韌性，將資訊安全從技術合規提升至企業文化層面，為全球半導體供應鏈提供最穩固的信賴基石。

### (二)資通安全政策

本公司致力於保護公司業務與資訊系統相關之資訊資產，遵循相關法令，以確保公司和客戶的機密資訊免於遭受竄改、揭露、破壞或遺失等風險。

#### 資訊安全風險管理與持續改善架構

為此，我們依據 ISO/IEC 27001：2013 指導規範之「規劃(Plan)－執行(Do)－檢查(Check)－行動(Act)」模式，建立了完善的資訊安全管理系統，有效落實資安管理。

此資訊安全管理系統包含以下重要內容：

- **管理組織職掌：** 明確界定資安管理相關人員的職責與權限，確保資安管理工作得以有效推動和執行。
- **文件紀錄管理：** 建立嚴謹的文件紀錄控管制度，確保所有資安相關資訊的完整性、機密性及可用性，以利追蹤與查核。
- **各項資安管制措施之原則：** 針對資訊資產的機密性、完整性及可用性，制定一系列具體的資安管制措施，有效降低潛在的資安風險。

- **多方合作和降低風險：**我們積極參與資安情資分享組織，包括科學園區資安資訊分享與分析中心（S-ISAC）、臺灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）等，即時掌握最新的資安預警、威脅與弱點資訊。同時，我們也與外部資安廠商及專家緊密合作，持續追蹤最新的資安資訊、技術與趨勢，並將最新的防禦和管理方法應用於實務，提升快速反應和復原能力，有效抵禦新型態的資安威脅，確保資訊服務的韌性，將營運衝擊降至最低。透過上述政策的實施，本公司能夠有效地管理資訊安全風險，全面保護資訊資產的機密性、完整性及可用性，最終目標是確保公司業務的正常運作與永續發展。

### (三)具體管理方案與投入資源

I. 本公司致力於建立堅實的資訊安全防護網，以預防、偵測並降低資安攻擊帶來的潛在損害：

為了構築堅實的資訊安全防護網，力成採取「主動防禦、動態治理」的策略，將資安防護落實於以下八大核心維度，確保公司、客戶及合作夥伴的資訊資產獲得最謹慎的守護：

1. 網路安全控管：強化網路隔離與分段管理。利用新世代防火牆、入侵偵測與預防系統（IDPS）及加密傳輸技術（如 SSLVPN、TLS），即時抵禦外部滲透與惡意流量，確保全球運籌網絡的傳輸安全。
2. 資產與資料管理與保護：依據資料敏感度進行分類分級管理。針對核心智慧財產（IP）落實靜態與傳輸中加密，並透過完善的存取控制機制與異地備份方案，落實 ISO 27001:2022 對於資料掩碼與洩漏防護的要求，維護資訊機密性與完整性。
3. 電腦安全保護：強化端點設備（PC、伺服器、行動裝置）的深度防禦，配置端點偵測與回應（EDR）系統，結合 AI 行為分析以偵測未知威脅，並實施設備合規檢核與自動化更新管理，阻斷惡意軟體入侵路徑。
4. 人員資安管理：資安意識是防禦的最前線。我們從人員入職、在職至離職，皆落實嚴謹的背景審查與保密規範；並定期辦理「社交工程演練」與場景化資安教育訓練，建立以人為核心的數位安全文化。
5. 資安評鑑與風險管理：利用第三方平台建立動態風險評鑑體系，定期執行內外部稽核與弱點掃描。透過滲透測試模擬真實攻擊樣態，主動找出防禦破口，確保所有資安風險皆被識別、評估並獲得有效緩解。
6. 應用程式安全：在系統開發與維運過程中參考安全開發生命週期，落實漏洞弱點修補機制，確保所有應用程式（包括生產管理系統）具備抗禦攻擊的體質。
7. 資安事件回應與管理：配合資安事件監控中心（SOC），確保事件發生時能迅速偵測、通報並遏止，透過定期的資安總體演練，確保在突發資安事件時，關鍵生產流程能快速恢復，將損害降至最低。
8. 供應鏈安全：針對供應商、承攬商落實嚴格的供應商管理政策，我們監控供應鏈中所有軟硬體資產的完整性，確保合作夥伴具備對等的防護水準，消除供應鏈中的資安風險死角。

## II. 投入資通安全管理的資源與成效

本公司持續投入資源於資訊安全相關領域，在資通安全推動的主要成效如下：  
資訊安全保護與執行狀況



### (四) 資安事件處理與通報

力成科技股份有限公司於民國 114 年度，通過資安相關稽核無重大缺失，亦無違反資訊安全、造成客戶資訊洩漏及罰款等重大資安事件發生。此外，亦未發生不論是由第三人或主管機關因為本公司違反客戶個人資料保護或客戶資料遺失而向公司投訴，並且導致司法行動之投訴案件。

(五) 最近年度及截至 115 年 3 月 31 日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響(例如：營運或商譽的影響)及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
封測加工承攬合約	A 公司	108.06~	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	F 公司	108.12~	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	I 公司	108.12~	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	S 公司	111.3~	封測服務 權利義務規範	保密條款
廠房買賣合約	環德電子	114.4	廠房取得及價金支 付相關規範	保密條款
廠房買賣合約	友達光電	114.11	廠房取得及價金支 付相關規範	保密條款
銀行 借 款 合 約	中國信託商業銀行	114.07~117.07	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資 產與負債及淨值
	兆豐國際商業銀行	114.08~117.08	中期信用貸款	無
		110.10~115.10	中期信用貸款	無
	元大銀行	114.10~118.10	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資 產與負債及淨值
	玉山銀行	110.07~117.07	機器設備貸款	無
		114.05~117.05	中期信用貸款	
	華南銀行	114.12~117.12	中期信用貸款	無
		110.09~117.08		
	第一銀行	114.11~119.11	中期信用貸款	無
		110.12~117.12	中期信用貸款	
	台灣銀行	110.08~120.08	建造廠辦大樓	無
		110.08~117.08	機器設備貸款	
		114.06~116.06	中期信用貸款	
	合作金庫	110.12~117.12	機器設備貸款	無
	彰化銀行	114.05~119.05	中期信用貸款	無
110.12~117.12		機器設備貸款	無	
土地銀行	111.02~117.12	中期信用貸款	無	
	114.06~117.06	中期信用貸款	無	
星辰銀行	114.12~117.12	中期信用貸款	無	

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	114 年度	113 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		\$ 46,364,934	\$ 46,986,384	\$ (621,450)	(1.32)
投 資		2,547,266	2,379,539	167,727	7.05
不動產、廠房及設備		70,411,788	56,588,276	13,823,512	24.43
無形資產		1,121,483	1,104,434	17,049	1.54
其他資產		2,717,921	2,132,258	585,663	27.47
資產總額		123,163,392	109,190,891	13,972,501	12.80
流動負債		23,776,211	18,356,037	5,420,174	29.53
非流動負債		28,112,677	19,142,303	8,970,374	46.86
負債總額		51,888,888	37,498,340	14,390,548	38.38
股 本		7,591,466	7,591,466	0	0
資本公積		462,395	319,869	142,526	44.56
保留盈餘		49,961,089	49,756,143	204,946	0.41
其他權益		(801,332)	(372,090)	(429,242)	(115.36)
庫藏股票		(922,841)	(533,313)	(389,528)	73.04
母公司業主之權益		56,290,777	56,762,075	(471,298)	(0.83)
非控制權益		14,983,727	14,930,476	53,251	0.36
股東權益總額		71,274,504	71,692,551	(418,047)	(0.58)

重大變動項目分析說明如下：

1. 不動產、廠房及設備增加：主要係購置新廠房所致。
2. 其他資產增加：主要係使用權資產及投資性不動產增加所致。
3. 流動負債增加：主要係應付購料款及一年內到期長期借款增加所致。
4. 非流動負債增加：主要係長期借款增加所致。
5. 資本公積增加：主要係 114 年度發放予子公司股利調整資本公積所致。
6. 其他權益減少：主要係 114 年度國外營運機構財務報表換算兌換利益所致。
7. 庫藏股票增加：主要係子公司購入母公司之股票視為庫藏股票。

影響重大者應說明未來因應計畫：無此情形。

註：上列財務資料來源為依 IFRSs 編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

## 二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增 (減) 金額	變 動 比 例 ( % )	變 動 分 析
營業收入淨額	\$ 74,929,320	\$ 73,315,042	\$ 1,614,278	2.20	
營業成本	62,200,129	59,323,602	2,876,527	4.85	
營業毛利	12,729,191	13,991,440	(1,262,249)	(9.02)	
營業費用	4,597,352	4,609,174	(11,822)	(0.26)	
營業淨利	8,131,839	9,382,266	(1,250,427)	(13.33)	
營業外收入及支出	660,313	1,295,020	(634,707)	(49.01)	1
稅前淨利(損)	8,792,152	10,677,286	(1,885,134)	(17.66)	
所得稅費用	1,571,610	2,177,879	(606,269)	(27.84)	2
本期淨利	7,220,542	8,499,407	(1,278,865)	(15.05)	
增減變動分析：					
1.營業外收入及支出減少：主要係外幣兌換淨損失所致。					
2.所得稅費用減少：主要係稅前淨利減少所致。					

註：上列財務資料來源為依 IFRSs 編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

(二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請參照壹、致股東報告書。

## 三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額	全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量	全 年 來 自 投 資 活 動 淨 現 金 流 量	全 年 來 自 籌 資 活 動 淨 現 金 流 量	匯 率 變 動 對 現 金 及 約 當 現 金 之 影 響	現 金 剩 餘 數
22,238,335	16,697,873	(26,023,284)	4,197,348	(735,154)	16,375,118
114 年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：營業活動現金淨流入量主要係 114 年度獲利流入及折舊增加。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係 114 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。					
(3)籌資活動：籌資活動現金淨流入量主要係 114 年度舉借銀行長期借款之現金流入。					

(二)流動性不足之改善計畫：

114 年度現金流量無流動性不足之情形，故不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額	預計全年 來自營業 活動淨現 金流量	預計全年來 自投資及籌 資活動淨現 金流量	現 金 剩 餘 數 額	現 金 不 足 額	
				之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	理 財 計 劃
16,375,118	21,000,000	(22,000,000)	15,375,118	—	—
1. 115 年度現金流量變動情形分析 (1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 115 年度預計獲利加計折舊等。 (2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係預計 115 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。 (3)籌資活動：籌資活動現金流出量主要係預計 115 年度支付股東股利及償還銀行借款之現金流出。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 114 年度重大資本支出主要為取得不動產、廠房及設備，資金來源係以自有資金及銀行借款支付。由於本公司所處半導體產業之產品及技術世代交替迅速，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能，以配合產品市場的變化及客戶的需求，以維持公司之競爭力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

本公司轉投資政策主要係為配合公司深耕本業，並以強化與主要客戶間之策略聯盟關係及延伸相關產業之營業觸角為方向，期以投資收益增進股東權益。本公司 114 年度轉投資之營運概況請詳陸、特別記載事項之關係企業相關資料內容。

本公司於 98 年度在投審會核准對大陸投資美金 5,100 萬仟元額度內，透過 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 間接投資力成科技(蘇州)有限公司(以下簡稱力成蘇州)，正式跨足大陸地區的封測領域。當時力成蘇州在當地政府登記之投資總額為美金 2 億 1,600 萬元、註冊實收資本金為美金 7,200 萬元，並於 109 年 4 月第八屆第 17 次董事會通過增加對力成蘇州之投資美金 2,800 萬元，於 110 年其註冊實收資本金已由美金 7,200 萬元增加至美金 1 億元。歷經超過十年的經營，近年來美中貿易戰衝突加劇，為全球半導體產業帶來嚴重影響，本公司基於整體營運布局戰略考量，且為有效運用集團資源，於 112 年 6 月 27 日經第十屆第 2 次董事會決議通過處分本集團持有力成蘇州之 70% 股權。本次處分股權交易為本公司貢獻約 3.5 元每股盈餘，已於 112 年度全數認列。

本公司與主要客戶美光科技股份有限公司共同合作，於 103 年 12 月共同簽訂半導體封裝投資合約，透過第三地子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 於中國西安設立子公司力成半導體(西安)有限公司(以下簡稱力成西安)。本公司投資金額合計為美金 7,000 萬元，力成公司對力成西安之持股為 36%，Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 對該子公司之持股則為 64%。力成西安與美光西安於 105 年 1 月 21 日共同簽訂半導體封裝服務合約，因合約期滿並收到美光通知行使其購買權，本公司於 112 年 6 月第十屆第 2 次董事會通過處分力成西安之資產，並於 113 年 6 月 28 日完成資產移轉，並轉型為控股公司。經力成西安之董事會於 113 年 7 月通過辦理現金減資案，並於 113 年 9 月完成變更登記，本公司已於 113 年 11 月收到其減資匯回股本金額美金 6,000 萬元。

日本子公司力成科技秋田株式會社(Powertech Technology Akita Inc.) 於106年8月購自美光日本，因其承諾及自行開發之當地客戶訂單之營收，已無法支持其營運，基於長期營運規劃考量，於109年8月第九屆第2次董事會決議通過停止其營運，授權董事長或其指定之人處理後續作業，已於113年9月完成合法清算程序。

新加坡子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. (下稱 PTI-SG) 於103年7月購自 Nepes Corp. 主要從事 bumping 業務，因已開發客戶之營收，無法支持其營運，且於長期營運規劃考量，於109年8月第九屆第2次董事會決議通過停止其生產製造業務，並轉型為力成半導體(西安)有限公司及力成科技(蘇州)有限公司之控股公司。經 PTI-SG 之董事會於111年7月決議通過辦理現金減資案，並於111年8月完成變更登記，本公司已於111年9月收到其減資匯回股本金額美金1,600萬元。

未來一年投資計畫將視整體產業狀況與公司事業發展之需求，在鞏固策略聯盟合作關係與延伸相關產業營業觸角的方向下，經審慎評估後提報董事會核議。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

#### 1.利率變動之影響及因應措施

本公司所處半導體封裝測試業屬資本密集產業，機器設備的投資金額較大，資金來源除自有資金外，以銀行借款為主，故本公司損益受到利率變動之影響。對此風險本公司除定期評估銀行借款利率與市場平均利率之水準外，並適時向往來銀行洽商取得較優惠之借款利率。

#### 2.匯率變動之影響及因應措施

##### (1)匯率變動之影響

本公司114年度外銷比重約為58.99%，此為外幣收入之主要來源，幣別則以美元為主。而本公司部分機器設備及原物料亦從國外進口，大部份以美元或日幣計價，因此，不論收入或支出均受匯率波動之影響。本公司114年度匯兌損失為82,462仟元。

##### (2)因應匯率變動之具體措施：

- 進貨與收入產生相互沖抵之結果，使匯率之變動產生自然避險之效果。
- 財務人員蒐集有關匯率變化之訊息，參酌往來銀行銀根鬆緊狀況、匯率走勢分析及市場外匯需求狀況，以作為因應匯率變動之參考。
- 依據未來外幣需求情況下，適時買入外幣，以確定成本並降低匯率變動所造成之影響。
- 運用銀行額度適當時機將外幣貸款轉換為新臺幣之借款。
- 運用遠期外匯之衍生性商品交易，規避外幣計算之資產或負債及預期交易因匯率變動產生之風險。

#### 3.通貨膨脹情形：

本公司114年度損益並無明顯受通貨膨脹之影響，未來將視變動情形因應調整。

### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿之投資交易。
2. 本公司及子公司已依據證期局相關法令及規定，訂定以健全財務及營運危機處

理的內部管理辦法及作業程序，包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」，所有交易均依相關規定辦理，未來仍將嚴格遵守程序規範執行。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司自成立以來即致力於封裝測試人才的培訓，於 87 年即成立研發部門，持續進行封裝測試新製程、新技術之研發及引進；並於 95 年成立研發技術中心，未來將配合半導體記憶體主件朝多功能、高速化、高信賴度及高密度化方向發展及配合客戶新產品之開發情形，積極發展及引進新技術。未來研發計畫請詳肆、營運概況之一、(一)、4.計劃開發之新商品(服務)之說明。本公司預計 115 年度投入之研發費用將與 114 年度水準相當。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，而最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司所處半導體產業，產品及技術之世代交替迅速，為配合產品市場的變化及客戶的需求，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能。為降低產能過度擴充之風險、有效運用資金掌握產品發展趨勢，本公司與主要客戶建立策略聯盟之合作關係，以共同提升先進技術之能力。另外，利用轉投資相關企業，佈建完整的產品線，藉以分散產業變化帶來的風險，並加強成本控制、現金管理來維持公司的競爭力，以控制對公司財務業務的影響。

本公司已建立網路與電腦相關之資安防護措施，亦針對資訊安全風險管理訂定相關規定與流程：

1. 不同之資產其面臨之風險也不盡相同，針對鑑別資產價值或計算方法調整適合單位特性之方式進行。
2. 基本資訊安全需求為資料之機密性、完整性與可用性，並透過持續檢視和評估，以確保相關規定與流程之適當性及有效性。
3. 鑑於近年網路攻擊手法日益多元且繁雜，本公司持續強化資安管理制度，以降低資安事件發生之風險，基於風險分散與財務穩健原則，已於 114 年持續購買資安保險，總保障額度為 500 萬美元，以因應可能之資安事故。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。本公司企業形象良好，近年並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 114 年及截至年報刊印日止，尚無進行併購之情形。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

隨著公司先進封裝業務規模持續成長及中長期營運需求增加，並考量現有竹科廠區辦公及營運空間之配置使用情形，本公司已於 114 年 11 月第十屆第 15 次董事會決議，於新竹科學園區購買合適供營業用之廠房設施，以因應未來擴充與業務發展需求，並於 114 年 12 月完成過戶。

全球 AI、雲端服務供應商（CSP）擴張資料中心及高效能運算（HPC）對晶片性能的要求不斷提高，推動先進封裝產能擴張，此次擴廠預計滿足先進封裝強進需求，支持中長期營運發展。

全球政經環境及貿易政策變動可能影響半導體供應鏈運作與市場需求，本公司長期深耕多元客戶與市場布局，並持續關注相關政策動向，以降低單一市場或區域變動之影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於所處之產業特性，上游記憶體 IC 之市場集中度高，使得下游封測產業出現銷貨及進貨較為集中之現象，為分散此風險，本公司積極開發新客戶，與原有客戶建立友好的策略聯盟合作關係，並持續積極跨足非記憶體 IC 之封裝測試業務，目前在 DRAM、NAND FLASH 之記憶體及邏輯 IC 之封測代工呈現約略各占 1/2 之態勢。進貨方面，則積極尋找替代料及新合格供應商，以期使公司穩健成長。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

1.本公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

2.董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

---

一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

力成科技股份有限公司



董事長：蔡 篤 恭



